

WENN SIE IHRE KLIMAANLAGE EINSCHALTEN,  
**REGELT** EIN ELMOS-CHIP DIE TEMPERATUR.

WENN SIE UM EINE KURVE FAHREN,  
**MISST** EIN ELMOS-CHIP DEN LENKWINKEL.

WENN SIE AUF DAS GASPEDAL TRETEN,  
**STEUERT** EIN ELMOS-CHIP DIE STABILITÄT.

Wir entwickeln und produzieren kundenspezifische Halbleiterchips. Diese werden zum Großteil in der Automobilindustrie, aber auch in der Konsum- und Haushaltsbranche eingesetzt. Sie werden in enger Zusammenarbeit mit den Kunden direkt auf deren spezifische Bedürfnisse abgestimmt. Diese integrieren unsere Halbleiter in ihre Systeme. Unsere Produkte befinden sich in den Modellen von nahezu allen Automobilherstellern.

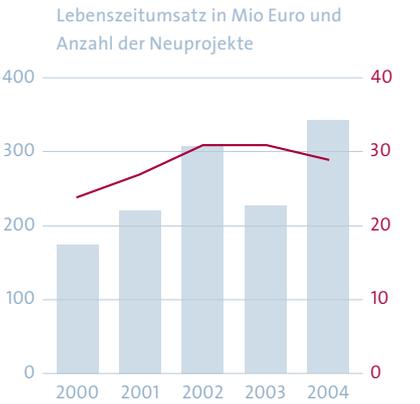
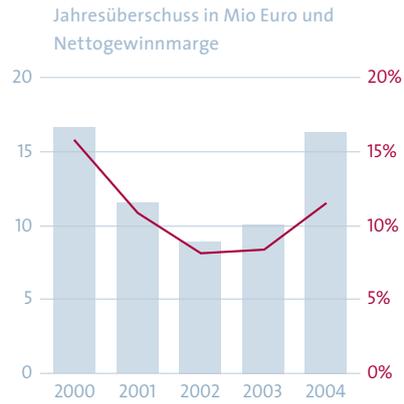
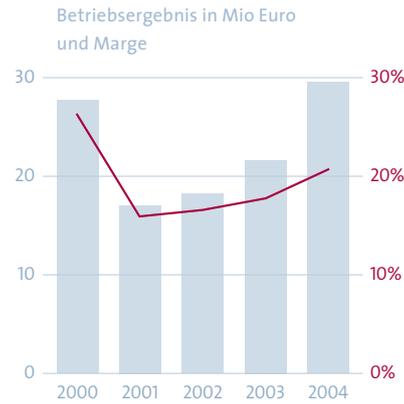
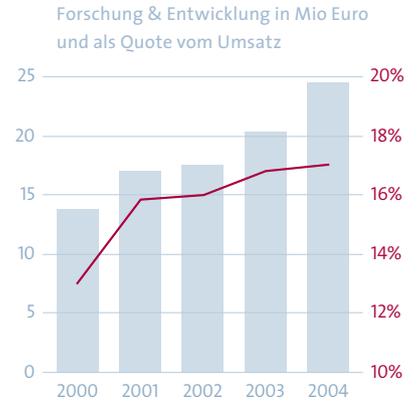
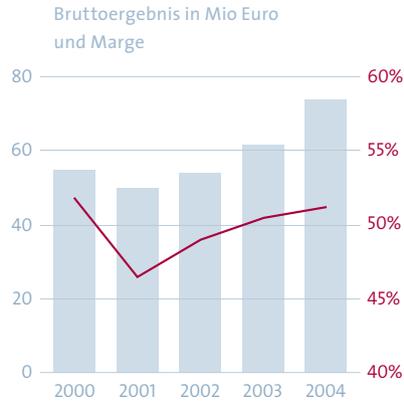
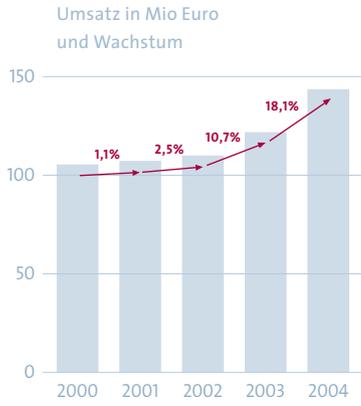
## Fünffjahresübersicht ELMOS-Konzern nach US-GAAP

in Millionen Euro, soweit nicht anders angegeben	2000	2001	2002	2003	2004
Umsatz	105,8	107,0	109,7	121,4	143,3
Bruttoergebnis	54,9	49,8	53,8	61,4	73,6
Forschung & Entwicklung	13,8	17,0	17,5	20,4	24,4
Betriebsergebnis	27,7	17,0	18,3	21,6	29,6
EBIT	28,1	18,8	19,3	21,1	28,7
EBITDA	39,1	32,8	34,2	35,7	41,4
Ergebnis vor Steuern	29,4	17,3	15,7	17,3	25,3
Jahresüberschuss	16,6	11,6	8,9	10,0	16,3
Ergebnis je Aktie in Euro	0,86	0,60	0,46	0,52	0,85
Eigenkapital	120,0	113,1	112,4	124,7	136,2
Bilanzsumme	188,5	208,0	208,5	205,3	219,8
Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	30,2	20,9	26,0	6,5	34,9
Investitionen in das Anlagevermögen	- 24,0	- 46,5	- 34,1	- 25,3	- 33,5
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	- 9,6	- 77,7	- 29,3	3,4	- 31,2
Dividende je Aktie in Euro	0,91	0,00	0,00	0,13	0,21*
Mitarbeiter im Jahresmittel	514	624	830	874	928

\* Vorschlag für die Hauptversammlung im April 2005

## Kursdaten

	2000	2001	2002	2003	2004
Aktienkurs am 31. Dezember (Xetra) in Euro	26,60	14,05	8,01	12,50	11,80
Jahreshoch (Xetra) in Euro	63,75	33,99	17,50	14,25	14,55
Datum	14. Feb.	19. Jan.	3. April	3. Dez.	4. Okt.
Jahrestief (Xetra) in Euro	22,14	8,80	3,91	4,30	10,99
Datum	20. Dez.	15. Okt.	7. Okt.	31. März	22. März
Anzahl der ausstehenden Aktien am 31. Dezember in Mio Stück	19,3	19,3	19,3	19,3	19,3
Marktkapitalisierung am 31. Dezember (Xetra) in Mio Euro	513	271	155	241	228



### Aktienkurs und Handelsvolumen 2004



# ► Chronik 2004

## 1. QUARTAL



### KO-INTEGRIERTER DRUCKSENSOR

Der ko-integrierte Drucksensor vereint als eines der ersten Produkte einen Halbleiterschaltkreis und Sensor im kundenspezifischen Gehäuse. Reifen-druck-Kontrollsysteme in Autos oder Sensoren in medizinischen Geräten können damit noch genauer messen und benötigen weniger Platz.

### QUALITÄTSAUSZEICHNUNG

Der Weltmarktführer für automobiler Komponenten Delphi verleiht uns im Februar den „Zulieferer des Jahres“-Preis. Damit honoriert Delphi die hohe Qualität unserer Produkte und die enge Zusammenarbeit.

► mehr auf Seite 45

### NÄCHSTE AIRBAG-GENERATION

Der Automobil-Zulieferer Autoliv baut seine Airbags mit unserer neuesten Generation von Airbag-Zünd-ICs. Eine konsequente Weiterentwicklung der langjährigen Partnerschaft.

► mehr auf Seite 53

## 2. QUARTAL

### DIVIDENDE

Rund 300 Aktionäre nehmen im April an der Hauptversammlung im Goldsaal der Westfalenhallen in Dortmund teil. Es gibt gute Nachrichten für unsere Aktionäre: Die Hauptversammlung beschließt nach zweijähriger Pause wieder eine Dividende. Pro Aktie werden 0,13 Euro ausgeschüttet.

► mehr auf Seite 22

### QUARTALS-REKORDUMSATZ

Im Mai geben wir bekannt, dass das Geschäftsjahr 2004 erfolgreich startet. Das erste Quartal wird mit einem Rekordumsatz von 35,0 Millionen Euro und einem Überschuss von 3,6 Millionen Euro abgeschlossen. Mit der Bruttomarge von 50,7 Prozent haben wir unsere eigenen Ziele klar übertroffen.



### UMWELTZERTIFIZIERUNG

Der TÜV Rheinland bestätigt im Juni die Zertifizierung für unser Umweltmanagement-System ohne Abweichungen. Das Zeugnis dokumentiert, dass wir Umweltschutz und Arbeitssicherheit genauso ernst nehmen wie die Qualität und Wirtschaftlichkeit unserer Produkte. Der erstmals erschienene Umweltbericht für 2003 informiert anschaulich über alle wichtigen Fakten rund um Umweltbelange.

► mehr auf Seite 45

### 3. QUARTAL

#### ZUSÄTZLICHE AZUBIS

Der Auftakt zu unserem 20-jährigen Jubiläum: Wir stellen 20 zusätzliche Azubis ein. Damit ermöglichen wir allein im Jahr 2004 insgesamt 35 jungen Menschen einen Einstieg in das Berufsleben; quer durch alle Bereiche – vom Mikrotechnologen bis zur Industriekauffrau.

► mehr auf Seite 43

#### EINSTIEG IN TELEKOMMUNIKATION

Ein neuer Markt: Wir gewinnen ein großes Telekommunikations-Unternehmen als Kunden. Das Unternehmen sichert sich mehrere Produkte nach unserem patentierten HALIOS®-Prinzip. Die in der Telekommunikation gewonnenen Erfahrungen werden nachfolgend in unserem Kerngeschäft, der Automobilelektronik, erfolgreich eingesetzt.

#### JUBILÄUM

Im September feiern wir unseren 20. Geburtstag. Dazu haben wir zum Workshop „Zukunft der automobilen Halbleiter- und Sensortechnologie“ unsere Kunden eingeladen. Vertreter von Audi, BMW, Hella, Kostal, SiemensVDO, Volkswagen und weitere stellen ihre Perspektiven vor und deuten uns den Weg für neue Produkte.

► mehr auf Seite 46



### 4. QUARTAL

#### NEIGUNGSWINKELSENSOR

Unser Neigungswinkelsensor feiert im Oktober Premiere. Die Kombination von Schaltkreis und Sensor erkennt kleinste Veränderungen der Lage. Ein Einsatzbeispiel ist der Diebstahlschutz. Wird das Auto bewegt oder angehoben, schlägt der Chip Alarm.



#### MESSE-AUFTRITTE

Auf den wichtigsten Messen in der ganzen Welt präsentieren wir unser Wissen und unsere Produkte. So sind wir beispielsweise auf der bedeutendsten amerikanischen Automobilelektronik-Messe, der Convergence in Detroit, im Oktober und einen Monat später auf der electronica in München vertreten. Dort konnten wir langjährige und zukünftige Kunden von unserem Produkt-Portfolio überzeugen.

#### CAPITAL MARKETS DAY

Zahlen und Fakten auf den Tisch sowie einen Blick in die Zukunft werfen wir an unserem Capital Markets Day. Über 40 Analysten und Investoren informieren sich im November aus erster Hand über Strategie, Geschäftsmodell und künftige Projekte.

► mehr auf Seite 22

# ► Inhaltsverzeichnis

---

## VORSTAND

Brief an unsere  
Aktionäre  
► 06

Vorstand  
► 08

## UNTERNEHMEN ELMOS

Unternehmensprofil  
► 12

Produkte  
und Anwendungen  
► 13

Standorte  
► 14

Perspektive  
► 14

## ELMOS-AKTIE

Allgemeine Entwicklung  
an den Börsen  
► 18

Basisinformationen  
zur Aktie  
► 20

Aktionärsstruktur  
► 21

Dividende  
► 22

Investor Relations  
► 22

Hauptversammlung  
► 23

## CORPORATE GOVERNANCE

Bericht des  
Aufsichtsrats  
► 26

Entsprechens-  
erklärung  
► 30

Aufsichtsrat  
► 31

## KONZERNLAGEBERICHT

Geschäft und  
Rahmenbedingungen  
► 34

Zukunft der  
Automobilelektronik  
► 46

Ertrags-, Finanz-  
und Vermögenslage  
► 52

Nachtragsbericht  
► 62

Risikobericht  
► 63

Prognosebericht  
► 68

## KONZERNABSCHLUSS

Jahresabschluss  
► 72

Konzernanhang  
► 77

Bestätigungsvermerk  
► 102

## KONZERNSTRUKTUR

Organe des  
Unternehmens  
► 104

Ausgewählte  
Beteiligungen  
► 106

Organisationsstruktur  
► 107

## GLOSSAR

Glossar  
► 108

Mehrjahresüberblick  
► Umschlag vorn

Impressum  
► 112

Finanzkalender  
und Kontakt  
► Umschlag hinten

## VORSTAND

*Sehr geehrte Damen und Herren,*

das Jahr 2004 war in verschiedener Hinsicht wegweisend für uns.

Wir haben 29 neue Projekte von Kunden gewonnen, innovative Produkte vorgestellt und das Geschäftsjahr mit einem Rekordergebnis abgeschlossen.

Mit 143,3 Millionen Euro kletterte der Umsatz um 18,1 Prozent. Das Bruttoergebnis entwickelte sich positiv: plus 19,8 Prozent auf 73,6 Millionen Euro. Und schließlich hat der Jahresüberschuss überproportional stark zugelegt: Auf ein Resultat von 16,3 Millionen Euro, was einem Anstieg von 62,8 Prozent entspricht. Mit unserem deutlich positiven operativen Cash Flow im Jahr 2004 haben wir bewiesen, dass wir nachhaltig Cash erwirtschaften und die für unser starkes Wachstum notwendigen Investitionen finanzieren können.

Auf die neu gewonnenen Aufträge, das Ergebnis und den Cash Flow können wir stolz sein. Dafür gilt unser höchster Dank unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Allerdings sind wir uns bewusst, dass wir dieses Ergebnis und den operativen Cash Flow benötigen, um unsere geplanten Investitionen finanzieren zu können. Beispielsweise für den Ausbau unserer Fertigung. Dabei ist unser Augenmerk immer auf die Weiterführung des ertragreichen Wachstums gerichtet.

Bei unseren Wachstumsplänen beobachten wir interessiert die Marktumstände: 2004 wurde von Experten als ein Jahr des neuen Höhepunktes der Halbleiterindustrie gewertet. Der Markt ist nach Angaben der Semiconductor Industry Association weltweit um 28 Prozent auf 213 Milliarden US-Dollar gestiegen. Doch ebenso schnell wie der Aufschwung gefeiert wurde, soll 2005 wieder der Abschwung eingeläutet werden. So gehen Marktexperten von einer Stagnation des weltweiten Halbleitermarktes in 2005 aus.

Diesem können und müssen wir für unseren Markt widersprechen.

Für ELMOS erwarten wir Wachstumsraten von mindestens 15 Prozent auch in den kommenden Jahren. Unsere Auftragsbücher sind gut gefüllt. Aufgrund unserer Nische für kundenspezifische Halbleiterchips für die Automobilindustrie können wir relativ weit im voraus planen. Unserer Prognose liegen daher konkrete Zahlen zugrunde.

Zusammen mit den zahlreichen neu gewonnenen Projekten, die die Basis für unsere Zukunft bilden, ergibt sich ein sehr gutes Bild für 2005.

Unser Aktienkurs hat diese positiven Entwicklungen im vergangenen Jahr leider nicht honoriert. Auf Jahressicht gesehen fiel der Kurs der ELMOS-Aktie um rund fünf Prozent. Dies ist für Sie als Aktionäre und für uns als Gesellschaft eine enttäuschende Bilanz. Wir sind jedoch weiterhin davon überzeugt, dass unsere Strategie eines ertragreichen Wachstums die einzig richtige Option ist. Dies hat sich auch darin gezeigt, dass wir nach zwei Jahren Pause in 2004 wieder eine Dividende ausschütten konnten. In diesem Jahr werden wir der Hauptversammlung im April 2005 eine Dividende von 0,21 Euro je Aktie vorschlagen.

Neben diesen wirtschaftlichen Ereignissen war der Höhepunkt 2004 für uns die Feier des 20-jährigen Bestehens von ELMOS. Zusammen mit Kunden, Gästen aus Politik und Wirtschaft sowie den Mitarbeitern haben wir in die Vergangenheit und insbesondere in die Zukunft geschaut. Dazu haben wir zu einem hochkarätigen Workshop eingeladen, der uns noch näheren Zugang zu unseren Kunden gebracht hat. Die Referenten von Audi, BMW, ContiTeves, der Fraunhofer Gesellschaft, Hella, Kostal, Siemens VDO, VW und ZF-Lenksysteme haben die Zukunft der automobilen Halbleiter- und Sensortechnologie aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Insgesamt entstand aus den einzelnen Mosaiksteinen ein Gesamtbild, das das Auto von morgen zeigt – und die Herausforderungen und Chancen für ELMOS. Diesem Thema haben wir im Geschäftsbericht 2004 ab Seite 46 ein eigenes Kapitel gewidmet, in dem wir die Trends und Entwicklungen der Automobilelektronik vorstellen. Hieraus leiten wir weiterhin gute Perspektiven für eine positive Unternehmensentwicklung ab.

Unsere Strategie für 2005 ist daher eindeutig:

- ▶ Wir wollen weiterhin deutlich wachsen und dabei immer die Kosten im Blick behalten.
- ▶ Wir wollen weiterhin unser Kerngeschäft stärken und dabei neue Kunden gewinnen und Märkte erschließen.
- ▶ Wir wollen weiterhin mehr als nur ein Partner für unsere Kunden sein und die Zukunft der automobilen Elektronik aktiv mitgestalten.

Mit freundlichen Grüßen



Knut Hinrichs, Vorstandsvorsitzender

## ► Vorstand



**Knut Hinrichs, *Vorsitzender***

Diplom-Kaufmann | Glückstadt

Knut Hinrichs studierte Betriebswirtschaft an der Universität Mannheim. Von 1977 bis 1979 war er Geschäftsführer einer Gesellschaft für industrielle Sensorelektronik. Danach arbeitete er als Unternehmensberater und später als selbständiger Handelsunternehmer für hybride elektronische Baugruppen. Seit 1987 war er Geschäftsführer, seit 1999 Mitglied des Vorstands und seit 2001 Vorsitzender der ELMOS Semiconductor AG.

† Am 1. März 2005 ist unser Vorstandsvorsitzender Knut Hinrichs nach schwerer Krankheit verstorben. Wir danken ihm für seine stets aufopfernde und inspirierende Arbeit. Fast 20 Jahre lang hat er die Geschichte des Unternehmens entscheidend geprägt. Sein Beitrag zur Entwicklung des Unternehmens kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Einen Menschen wie ihn vergisst man nicht. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.



**Dr. rer. nat. Klaus Weyer**

Diplom-Physiker | Schwerte

Dr. Klaus Weyer ist einer der Gründer des Unternehmens ELMOS. Er studierte Physik in Köln und promovierte anschließend an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Danach war er als Unternehmensberater im Bereich der Mikroelektronik für kleine und mittlere Firmen tätig. Seit 1984 ist er Geschäftsführer und seit 1999 Vorstand für Technologie der Aktiengesellschaft.



### Dr. rer. nat. Peter Thoma

Diplom-Physiker | Unterschleißheim

Dr. Peter Thoma studierte Physik an der Technischen Universität München und promovierte im Jahr 1978. Im Anschluss daran leitete er eine Abteilung für Technologie bei Kienzle. Von 1983 bis 2000 war er für die BMW AG tätig. Zunächst baute er dort eine Abteilung zur Entwicklung elektronischer Steuergeräte für den Kfz-Einsatz auf und leitete anschließend den Bereich Entwicklung Elektrik/Elektronik. Im Oktober 2000 wechselte er als Vorstand für Vertrieb und Entwicklung zu ELMOS.



### Reinhard Senf

Diplom-Ingenieur | Iserlohn

Reinhard Senf erwarb 1974 seinen Dipl. Ing. Physik und Technik elektronischer Bauelemente an der TU Ilmenau. Von 1974 bis 1991 arbeitete er als Produktionsingenieur und später als Geschäftsführer im VEB Funkwerk/Mikroelektronik in Erfurt. Seit 1992 ist er bei ELMOS, zunächst als Assistent der Geschäftsführung, seit 1993 als Bereichsleiter Qualitätswesen und ab 1999 als Bereichsleiter Backend. 2001 übernahm er den Bereich Produktion im Vorstand.

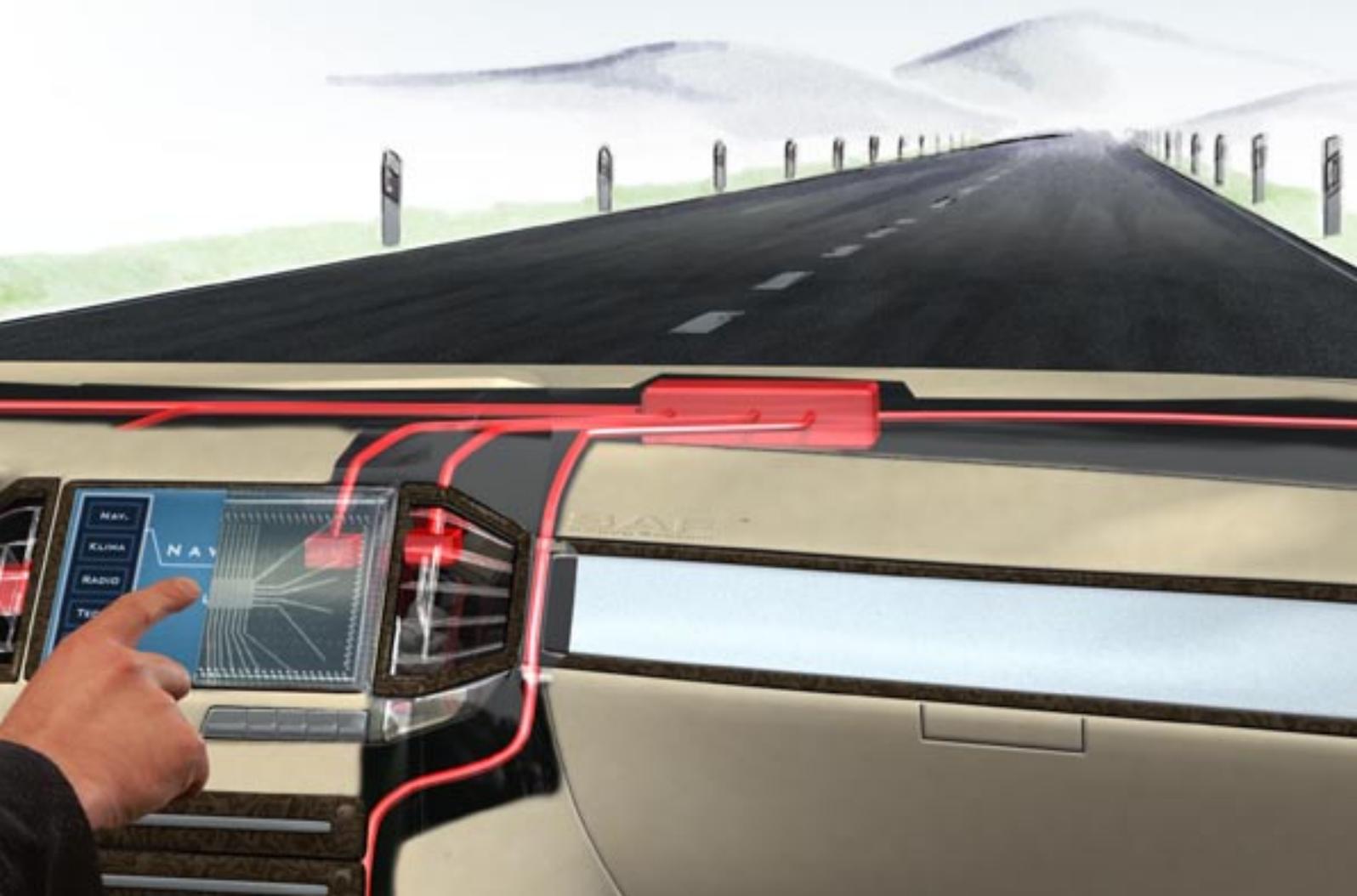
# ELMOS IST TEIL DER ZUKUNFT IHRES AUTOS

Das Auto von morgen wird sicherer,  
umweltfreundlicher und komfortabler sein:



- ▶ Unsere Chips vernetzen die Systeme intelligent miteinander.
- ▶ Unsere Chips assistieren Ihnen beim Fahren.
- ▶ Unsere Chips verbinden Elektronik mit Mechanik.

Wir gestalten die Zukunft aktiv mit.



- Unternehmensprofil
- Produkte und Anwendungen
  - Standorte
  - Perspektive

## UNTERNEHMEN ELMOS

### ▸ Unternehmensprofil

---

Haben Sie ein Auto? Oder ein Bügeleisen, eine Waschmaschine oder vielleicht eine Personenwaage? Dann haben Sie höchstwahrscheinlich einen Chip von uns. Sie sehen uns zwar nicht, aber unsere Produkte sind da.

Unsere Ideen auf 10mm<sup>2</sup>

Wir entwickeln und produzieren diese Halbleiterchips. Von der ersten Idee bis zum fertigen Chip, der meist nur 10 bis 15mm<sup>2</sup> klein ist. Über 90 Prozent dieser Chips wird in der Automobilbranche eingesetzt. Aber auch in Konsum- und Haushaltsartikeln erfüllen unsere Bauteile ihren Zweck.

Hauptkunden für unsere integrierten Schaltungen (ICs) sind Automobilzulieferer wie Autoliv, Behr, Bosch, Delphi, Helbako, Kostal, Lear, Siemens-VDO, Valeo und andere. Diese verbauen unsere Chips in ihre Systeme. Daher befinden sich unsere ICs in nahezu allen Modellen der namhaften Hersteller – von Audi, BMW, Citroën, Daimler Chrysler, Ford, Opel, Peugeot über Porsche, Renault, Rover, Toyota, Volvo bis Volkswagen.

Wir profitieren dabei vom zunehmenden Einsatz von Elektronik im Kraftfahrzeug. Dazu zählen Sicherheitsfunktionen wie Airbags, Anti-Blockier-Systeme (ABS), Über-schlagserkennung und Reifendruckkontrolle, Komfortsysteme wie Klimaanlage, elektrische Fensterheber mit Einklemmschutz, Regensensoren, Einparkhilfe und Kurvenlicht oder auch Systeme zur Verbesserung der Fahrstabilität (elektronisches Stabilitätsprogramm, ESP) und optimierte Regler für die Lichtmaschine.

Kurz gesagt: Der rasante Zuwachs an Elektronik im Auto und Haushalt ist unser Gewinn. Heute und insbesondere morgen.

## ► Produkte und Anwendungen

---

### Das Gehirn Ihres Autos

Unsere Chips übernehmen im Auto Mess-, Regel- und Steuerungsfunktionen in den Bereichen Sicherheit, Komfort und Motormanagement. In Oberklasse-Modellen sind über 100 unserer Chips die Vordenker und Lenker für komplexe elektronische Funktionen. Aber auch in Mittel- und Kompaktklassefahrzeugen finden unsere Chips Einsatz. Beispiele: Airbags und elektrische Fensterheber gehören heute in fast jedem Auto zur Serienausstattung. Ziel für uns und unsere Kunden ist dabei, Ihnen das Autofahren noch sicherer, angenehmer und umweltfreundlicher zu machen.

In Haushalts- und Konsumartikeln stellen unsere Chips zum Beispiel Ihr Bügeleisen automatisch ab, bevor das Hemd anfängt zu brennen. Oder in Waschmaschinen messen unsere Chips, wieviel Wasser in der Trommel ist. Auch hier ist das Ziel für uns und unsere Kunden, Ihnen den Umgang mit alltäglichen Haushalts- und Konsumartikeln so sicher, angenehm und umweltfreundlich wie möglich zu gestalten.

Kunden erhalten von uns maßgeschneiderte Lösungen. Wir entwickeln unsere Chips in enger Zusammenarbeit mit ihnen, immer nach ihren Wünschen und Bedürfnissen. Dadurch wird das Know-how unserer Kunden geschützt, sie erhalten ihren individuellen Chip und damit den oft entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Denn durch Integration erreichen wir das, was man sonst mit vielen Einzelteilen umsetzen muss.

Dies wird durch unsere jahrelange Erfahrung mit Elektronik im Automobil möglich. Wir haben bislang über 300 Projekte erfolgreich in Zusammenarbeit mit unseren Kunden zur Serienreife gebracht. Bei jedem Projekt kann sich der Kunde sicher sein, dass seine Systemkosten reduziert werden, die Qualität verbessert und wir über die gesamte Lebenszeit seines Produktes unsere Chips liefern. Solch lange Lieferzeiten sind in der schnelllebigen Halbleiterindustrie durchaus nicht bei jedem Hersteller üblich. Einige Produkte liefern wir schon seit mehr als zehn Jahren und werden sie auch bis zum Ende der Dekade produzieren. Wir können durch unsere eigene Halbleiterfertigung über Jahre ein bewährtes und unverändertes Produkt anbieten – und stehen nicht wie die großen Halbleiterfabriken unter dem Zwang, schnell neue Technologien einführen zu müssen.

Zudem profitiert der Kunde vom Einsatz spezieller Technologien, wie unserer selbst entwickelten Hochvolt-CMOS-Technologie. Und unsere Chips funktionieren auch, wenn Ihr Auto im Winter vereist ist oder stundenlang im Sommer in der Sonne parkte. Denn unsere Chips halten Temperaturen von minus 40 Grad bis plus 175 Grad stand. Dies zeigt: Wir legen höchsten Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit. Denn nichts ist ärgerlicher als ein Auto, das stehen bleibt oder Probleme verursacht.

## ► Standorte

---

### Nah am Kunden

Wir betreuen und beraten unseren Kunden von seiner ersten Idee über die Entwicklung und erste Testprodukte bis hin zum fertigen Chip. Dies erfordert regen Austausch, viele Gespräche und schnelle Hilfe bei Problemen. Darauf haben wir uns eingerichtet: Unsere Chip-Fertigung ist zentralisiert an unserem Hauptsitz in Dortmund. Auf circa 2.500 Quadratmetern werden täglich über 350 150mm-Wafer in die Fertigung eingesteuert. Zudem produziert unser Spezialist für Sensorsysteme, SMI in Milpitas, Kalifornien, in seinem eigenen Reinraum auf einer Fläche von rund 1.200 Quadratmetern. Die Aufbau- und Verbindungstechnik für unsere Chips übernimmt ELMOS Advanced Packaging (ehemals eurasem) mit Sitz in Nijmegen in den Niederlanden.

Unsere Entwicklungszentren und Vertriebsbüros sind in direkter Nähe zu unseren Kunden, beispielsweise in München, Stuttgart, Paris oder Detroit. Zudem entwickeln unsere Tochterunternehmen MECHALESS in Karlsruhe, Gärtner Electronic Design (GED) in Frankfurt an der Oder und unsere Kooperationspartner MAZ Brandenburg in Berlin, DMOS in Dresden und attoSENSOR in Penzberg Halbleiterchips und Sensor-Applikationen.

Wir sind immer nah am Kunden. Räumlich und zeitlich.

## ► Perspektive

---

### Wo geht es hin?

In den vergangenen 20 Jahren revolutionierte die Elektronik den Automobilbau. Fortschritte beim Komfort, bei der Sicherheit und im Umweltschutz sind hauptsächlich durch den Einsatz von elektronischen Komponenten möglich geworden. Doch welche elektronischen Fortschritte werden das Auto von morgen auszeichnen? Oder anders gefragt: Wie werden wir morgen in unserem Auto fahren?

Wir haben unser 20-jähriges Firmen-Jubiläum genutzt, um nicht nur zurück, sondern insbesondere nach vorn zu blicken. Dazu haben wir die Macher und Denker eingeladen, mit denen wir zusammen das Auto von morgen entwickeln. Mit Experten von führenden Automobilherstellern und -zulieferern haben wir die Zukunft der automobilen Halbleiter- und Sensortechnologie diskutiert.

Die Elektronik im Auto von morgen wird die einzelnen Komponenten intelligent vernetzen, Ihnen beim Fahren assistieren sowie mechanische und elektronische Applikationen sinnvoll miteinander verschmelzen.

Im Einzelnen bedeutet dies:

ELMOS vernetzt Ihr Auto  
effektiv

- ▶ Immer mehr Funktionen fordern immer mehr Verbindungen zwischen Sensoren, Steuergeräten und Aktuatoren. Die einzelnen Systeme für Komfort, Sicherheit und Information werden miteinander vernetzt und standardisiert. Dadurch werden die Autos leichter und umweltfreundlicher. Wir sind ein Teil davon, weil unsere Chips mehrere Bauteile in einem platz- und kostensparenden Halbleiter verbinden. Die Folge: Schnittstellen fallen weg, Standards werden etabliert und Probleme mit der Elektronik nehmen ab.

ELMOS assistiert Ihnen  
beim Fahren

- ▶ Die Fahrerassistenzsysteme sind die nächste Stufe auf dem Weg, Ihnen das Fahren sicherer und einfacher zu gestalten. Während in der Vergangenheit das Bestreben vornehmlich darin lag, die Unfallfolgen zu lindern, ist nun das Hauptaugenmerk auf die Verhinderung des Unfalls gerichtet. Aber auch der Komfortbereich wird weiter verbessert: Regensensoren, Abstandsmesser und Fahrspurerkennungssysteme helfen Ihnen, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist: den Verkehr. Unsere Chips können durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit einen wichtigen Beitrag dazu leisten.

ELMOS verbindet Elektronik  
mit Mechanik

- ▶ Zudem wird die Elektronik rein mechanische Bauteile an sinnvollen Stellen ergänzen oder ersetzen. Die Verbindung dieser Elemente eröffnet vollkommen neue Möglichkeiten für die Senkung des Kraftstoffverbrauchs und die Erhöhung der Sicherheit. Hierzu zählen unter anderem die elektrische Lenkhilfe, die elektrische Wasserpumpe, die elektrische Bremse und der elektrische Ventiltrieb. Diese Produkte sind kleiner, leichter und leistungsfähiger und erbringen nur jeweils die Leistung, die aktuell benötigt wird.

ELMOS ist Teil der Zukunft Ihres Autos. Wir gestalten die Zukunft aktiv.

Wenn Sie mehr zur elektronischen Zukunft des Autos erfahren möchten oder an technischen Details interessiert sind, können Sie ab Seite 46 mehr darüber lesen.

# ELMOS **VERNETZT** IHR AUTO EFFEKTIV

An heißen Tagen

muss die Klimaanlage Höchstleistungen erbringen.





# ELMOS **VERNETZT** IHR AUTO EFFEKTIV

An heißen Tagen

kommuniziert das Klimaanlage-System permanent mit Wärmesensoren und Steuergeräten.

Die Informationen fließen über Datenleitungen, die Ihr gesamtes Auto vernetzen.

- 1 Der Klimaklappensteller steuert, wo die Luft herausströmen soll (LIN-Vernetzung).
- 2 Die BUS-System-Steuerung verbindet die einzelnen Vernetzungssysteme untereinander.
- 3 Der Lichteinfallsensor erkennt, wo die Sonne strahlt und daher mehr Kühlung nötig ist (LIN-Vernetzung).



# ELMOS **VERNETZT** IHR AUTO EFFEKTIV

Alle Sicherheits- und Komfortsysteme sind in Ihrem Auto mit- und untereinander verbunden. Um die Kommunikation auch bei der wachsenden Anzahl an Systemen sicherzustellen, vereinfachen unsere Chips den Datenfluss. Das Ziel: Mehr Funktionen, weniger Kabelstränge, weniger Gewicht, weniger Verbrauch. Unsere Chips sind dafür die Grundlage.

- 1 Der Klimaklappensteller steuert, wo die Luft herausströmen soll (LIN-Vernetzung).
- 2 Die BUS-System-Steuerung verbindet die einzelnen Vernetzungssysteme untereinander.
- 3 Der Lichteinfallsensor erkennt, wo die Sonne strahlt und daher mehr Kühlung nötig ist (LIN-Vernetzung).
- 4 Der Drosselklappensteller ändert je nach Bedarf die Stärke des Luftstroms zum Motor (CAN-Vernetzung).
- 5 Die Anzeigentafelsteuerung gibt die Informationen (Geschwindigkeit, Ölstand usw.) an das Cockpit weiter (CAN-Vernetzung).
- 6 Die Scheibenwischer können je nach Bedarf gesteuert werden (CAN-Vernetzung).
- 7 Der Aufprall-Sensor ermittelt beim Unfall frühzeitig den Zeitpunkt und die Stärke des Aufschlags (FlexRay-Vernetzung).
- 8 Die Seiten-Airbags schützen den Fahrer bei einem Aufprall von der Seite (FlexRay-Vernetzung).
- 9 Der intelligente Gurtstraffer hält den Fahrer in einer möglichst sicheren Position bei einem Aufprall (FlexRay-Vernetzung).
- 10 Der Airbag schützt den Fahrer bei einem Unfall vor Verletzungen (FlexRay-Vernetzung).
- 11 Die Spiegelverstellung ermöglicht das komfortable Verstellen beider Außenspiegel (LIN-Vernetzung).
- 12 Die elektrischen Fensterheber bewirken das bequeme Öffnen und Schließen der Fenster (LIN-Vernetzung).
- 13 Die Zentralverriegelung sichert alle Türen des Autos auf Knopfdruck (LIN-Vernetzung).



3

4

7

6

5

1

2

1

11

1

10

12

13

8

9

- ▶ Allgemeine Entwicklung an den Börsen
- Basisinformationen zur Aktie
- Aktionärsstruktur
- Dividende
- Investor Relations
- Hauptversammlung

ELMOS-AKTIE

Gute Ergebnisse,  
enttäuschender Kursverlauf

## ▶ Allgemeine Entwicklung an den Börsen

Die ELMOS-Aktie konnte im vergangenen Jahr 2004 die überdurchschnittliche Aufwärtsbewegung des Vorjahres nicht fortsetzen. Obwohl die Halbleiterumsatzerlöse branchenweit starkes Wachstum zeigten, und auch ELMOS sich operativ deutlich stärker als im Vorjahr entwickelt hat, vollzogen die Halbleiteraktien diese Entwicklung im Allgemeinen nicht nach. Investoren haben vielmehr antizipiert, dass sich das Wachstum des Halbleitermarkts im Jahr 2005 stärker abschwächen wird als zunächst erwartet, was sich im negativen Trend der Halbleiterwerte ab Mitte 2004 gezeigt hat.

Und obwohl die Geschäftsentwicklung von ELMOS deutlich weniger vom allgemeinen Trend der Halbleitermärkte abhängig ist, als vielmehr von der Entwicklung des Elektronikanteils im Automobil, ist die ELMOS-Kursentwicklung scheinbar unablässig von der Entwicklung der typischen Halbleiteraktien.

Relative Kursentwicklung 2004



ELMOS-Aktie verlor 5,6  
Prozent und beendete das  
Jahr mit 11,80 Euro

Der Kurs der ELMOS-Aktie bewegte sich im Jahr 2004 zumeist innerhalb eines Korridors von 11,00 Euro bis 14,50 Euro. Der Aktienkurs der ELMOS schloss am Jahresende mit 11,80 Euro leicht unter dem Niveau am Jahresanfang (12,50 Euro). Während die ELMOS-Aktie sich in der ersten Jahreshälfte in etwa parallel zum TecDAX entwickelte, konnte sie sich Anfang August von der TecDAX-Entwicklung nach oben ablösen und erreichte ihren Höchststand am 4. Oktober 2004 mit 14,55 Euro.

Ab etwa Mitte des Jahres gerieten die Technologie- und insbesondere die Halbleitertitel in einen Abwärtssog, dem sich ELMOS zunächst entziehen konnte. Zum Jahresende wurde die ELMOS-Aktie von dieser Entwicklung eingeholt. Die Jahresperformance der ELMOS-Aktie ist vergleichbar mit dem TecDAX (minus vier Prozent), jedoch deutlich besser als die des Halbleiter-Aktienindex Philadelphia Semiconductor Index (SOX, minus 15 Prozent).

Obwohl die langfristige Entwicklung der ELMOS-Aktie seit dem Börsengang nicht zufriedenstellend ist, ist sie deutlich besser als die Entwicklung des TecDAX und die der meisten weltweiten Technologie-Indizes.

#### Langfristige Entwicklung der ELMOS-Aktie

Zeitraum bis zum 31. Dezember 2004	Seit IPO (11. Okt. 1999)	Seit 1. Jan. 2003	Seit 1. Jan. 2004
ELMOS (Xetra)	- 46,4%	47,3%	- 5,6%
<b>Branchenindizes</b>			
TecDAX	- 86,5%	44,9%	- 3,9%
Philadelphia Semiconductor Index (SOX)	- 18,0%	49,8%	- 14,7%
DJ Stoxx Semiconductor	- 60,0%	4,2%	- 27,7%
DJ Stoxx Technology	- 54,3%	31,9%	- 1,6%
Prime Technology	- 30,4%	26,4%	- 22,2%
Prime Automobile	- 13,0%	31,5%	- 1,5%
<b>Allgemeine Marktindizes</b>			
DAX	- 21,4%	47,1%	7,3%
DJ Stoxx 50	- 26,5%	15,3%	4,3%

Aktie wurde in der zweiten Jahreshälfte weniger gehandelt

Das Handelsvolumen der ELMOS-Aktie im Xetra-Handel und am Frankfurter Parkett betrug im Jahresdurchschnitt rund 50.000 Aktien täglich. Damit ist das Handelsvolumen gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, liegt aber weiterhin deutlich oberhalb der Jahre zuvor. Während in der ersten Jahreshälfte 2004 noch durchschnittlich über 70.000 Aktien gehandelt wurden, wechselten im zweiten Halbjahr 2004 nur noch rund 30.000 Aktien täglich die Besitzer. Der größte Teil des Volumens, rund Dreiviertel wurde unverändert auf Xetra gehandelt.

- ▶ Allgemeine Entwicklung an den Börsen
- ▶ Basisinformationen zur Aktie
- ▶ Aktionärsstruktur
  - Dividende
  - Investor Relations
  - Hauptversammlung

### ELMOS-Aktienkennzahlen

	2004	2003
Ausstehende Aktien in Stück	19.300.000	19.300.000
Höchstkurs (Xetra)	14,55 Euro 4. Oktober	14,25 Euro 3. Dezember
Tiefstkurs (Xetra)	10,99 Euro 22. März	4,30 Euro 31. März
Jahresendkurs (Xetra)	11,80 Euro	12,50 Euro
Jahresperformance (ohne Dividende)	- 5,6%	+56,1%
Marktkapitalisierung am 31. Dezember	227,7 Mio Euro	241,3 Mio Euro
Marktwert / Buchwert* am 31. Dezember	1,7	1,9
Durchschnittlich gehandelte Aktien pro Tag (Xetra und Parkett Frankfurt)	50,4 Tausend	88,5 Tausend
Davon auf Xetra in Prozent	75,3%	67,7%
Ergebnis je Aktie	0,85 Euro	0,52 Euro
Dividende je Aktie	0,21 Euro**	0,13 Euro
Dividendenrendite zum 31. Dezember	1,8%	1,0%
Ausschüttungssumme	4,1 Mio Euro	2,5 Mio Euro

\* Bilanzielles Eigenkapital | \*\* Vorschlag für die Hauptversammlung im April 2005

Die Marktkapitalisierung von ELMOS betrug zum Jahresende 227,7 Millionen Euro basierend auf 19,3 Millionen ausstehenden Aktien. Die Anzahl der ausstehenden Aktien hat sich seit dem Börsengang nicht verändert. Damit ist der Rückgang der Marktkapitalisierung im Vergleich zum Vorjahr vollständig auf den gesunkenen Aktienkurs zurückzuführen. Die Anzahl der ausstehenden Aktien kann sich erstmalig im laufenden Geschäftsjahr 2005 durch die Schaffung von neuen Aktien aus dem Aktienoptionsprogramm ändern. Von der im Sommer 2005 erstmalig ausübbarer Tranche stehen per Jahresende 2004 rund 280.000 Optionen aus.

## ▶ Basisinformationen zur Aktie

Die ELMOS-Aktie ist eine Namensaktie ohne Nennwert (Stückaktie). Sie wird an allen deutschen Wertpapierbörsen gehandelt und ist außerdem im XETRA-Handel vertreten.

#### Stammdaten

ISIN	DE0005677108
WKN	567710
Börsenkürzel	ELG
Reuters	ELGG
Prime Branche	Technology
Industry Group	Semiconductors

ELMOS ist Bestandteil des Technologie-Index TecDAX. Der TecDAX ist der Index für die 30 größten deutschen und ausländischen Unternehmen der Technologie-Branche unterhalb des DAX im Prime Standard-Segment. Seit Januar 2005 ist die ELMOS Aktie zudem Bestandteil des German Entrepreneurial Index (GEX), des neuen Indikators für die Wertentwicklung mittelständischer Unternehmen. Mit diesem Index

## Aufnahme in den GEX

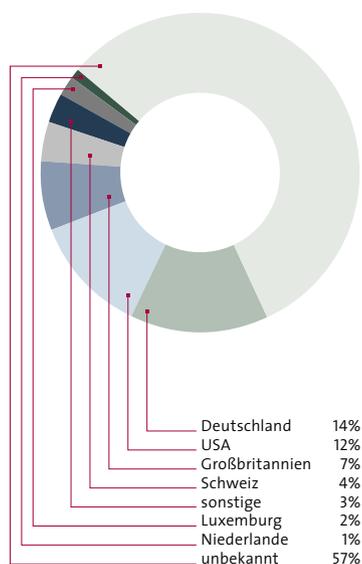
hat die Deutsche Börse erstmals das Kriterium des gründer- oder eigentümergeführten Unternehmens als indexrelevant definiert. Wesentliche Punkte für die Aufnahme in den GEX sind Eigentümerdominanz, das heißt Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder oder deren Familien besitzen zwischen 25 und 75 Prozent der Stimmrechte, Börsengang vor maximal zehn Jahren und Listing im Prime Standard. Im GEX sind rund 120 Unternehmen vertreten, ELMOS mit einem Gewicht von rund einem Prozent. Darüber hinaus ist ELMOS in weiteren Indizes vertreten.

### Angaben zum Wertpapier

Art der Aktien	Nennwertlose Inhaber-Stammaktien
Marktsegment	Prime Standard, Geregelter Markt
Grundkapital	19.300.000 Euro
Grundkapital, Stück	19.300.000
Börsengang	11. Oktober 1999
Designated Sponsors	Deutsche Bank, HSBC Trinkaus & Burkhardt, WestLB
Indexzugehörigkeit	TecDAX, GEX (ab Jan. 2005), MidCap, CDAX, PrimeAll, Prime Technology, HDAX, TechAllShare

## ► Aktionärsstruktur

Aktionärsstruktur des Streubesitzes



Quelle: IR Channel | Thomson Financial

Das Stammkapital der ELMOS Semiconductor AG umfasst unverändert 19.300.000 Aktien ohne Nennwert. Von diesen Aktien werden 57,7 Prozent (rund 11,1 Millionen Aktien) von der ELMOS Finanzholding GmbH (EFH) gehalten, die die stabile Aktionärsbasis der ELMOS darstellt. Gesellschafter der EFH sind Knut Hinrichs, Dr. Klaus Weyer und Prof. Dr. Günter Zimmer. Die verbleibenden 42,3 Prozent der Aktien (8,2 Millionen Aktien) befinden sich im Streubesitz. Sie sind im Besitz einer breiten Basis von institutionellen und privaten Investoren im In- und Ausland.

Deutsche Aktionäre halten etwa 14 Prozent der Aktien des Streubesitzes, Investoren im englischsprachigen Raum rund 19 Prozent. Das sonstige Kontinentaleuropa ist mit rund neun Prozent der Aktien des Streubesitzes vertreten. Damit zeigt die regionale Struktur der Aktionäre des Streubesitzes im Vergleich zum vergangenen Jahr eine Verschiebung von Großbritannien nach Deutschland. Die Struktur der restlichen Regionen hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert.

Abgesehen von der EFH hält kein Aktionär mehr als fünf Prozent des Grundkapitals von ELMOS; die zehn größten Aktionäre (ohne EFH) besitzen rund 28 Prozent des Streubesitzes.

- Allgemeine Entwicklung an den Börsen
- Basisinformationen zur Aktie
- Aktionärsstruktur
- Dividende
- Investor Relations
- Hauptversammlung

## ► Dividende

Das gute Ergebnis des Geschäftsjahres 2003 ermöglichte es der ELMOS Semiconductor AG, nach zwei Jahren ohne Ausschüttung wieder eine Dividende von 0,13 Euro je Aktie auszuschütten.

Dividendenvorschlag von  
0,21 Euro je Aktie

Aufgrund des Jahresüberschusses 2004 der ELMOS Semiconductor AG von 14,4 Millionen Euro schlugen Vorstand und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2004 der Hauptversammlung im April 2005 die Ausschüttung einer Dividende von 0,21 Euro je Aktie vor. Die Gesamtausschüttung würde damit rund 4,1 Millionen Euro betragen.

## ► Investor Relations

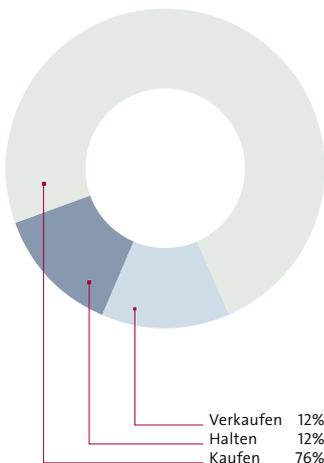
Auch im Jahr 2004 haben das ELMOS Management und das Investor Relations Team eine Vielzahl von Einzelgesprächen mit Investoren geführt. Diese fanden im Rahmen von Roadshows, Unternehmensbesuchen am Standort Dortmund und am Rande von Technologie- und Automobilkonferenzen, auf denen sich ELMOS präsentiert hat, statt. Dabei wurden mehr als 20 Roadshows in ganz Europa – von Großbritannien über Deutschland, Schweiz, Frankreich, den Benelux-Ländern bis hin zu Österreich und Spanien durchgeführt. Natürlich waren wir auch mehrmals in den USA, um unsere Anleger und interessierte Investoren vor Ort zu informieren.

Darüber hinaus führten wir zahlreiche Telefonkonferenzen im Anschluss an die Veröffentlichung von Ergebnissen und auf Wunsch mit einzelnen Aktionären. Zudem registrierten wir bei unseren Kapitalmarkttagen, im Anschluss an die Veröffentlichung der Ganzjahresergebnisse im März sowie im November mit der Möglichkeit zur Produktionsbesichtigung, gesteigertes Interesse von Analysten und Investoren.

Die Aktivitäten werden auch im kommenden Jahr in umfangreichem Maße weitergeführt. Hiermit ermöglichen wir unseren Aktionären und anderen interessierten Kapitalmarktteilnehmern, unsere Geschäftslage angemessen zu bewerten und unsere Perspektiven einzuschätzen. Unser Ziel dabei ist es, frühzeitig und umfassend zu informieren und jederzeit erreichbar zu sein – für private und institutionelle Investoren, für Analysten und interessierte Anleger.

Die ELMOS-Aktie wird derzeit von 17 Analysten bewertet. Zu Beginn 2005 beurteilten 13 Analysten (76 Prozent) die Aktie positiv, zwei (zwölf Prozent) neutral und zwei (zwölf Prozent) negativ.

Analystenmeinungen



BW-Bank
Berenberg Bank
Cheuvreux
Credit Suisse First Boston
Dawnay Day Lockhart
Dresdner Kleinwort Wasserstein
DZ Bank
HSBC Trinkaus & Burkhardt
ING BHF-Bank
JPMorgan
Kepler Equities
LRP Landesbank Rheinland-Pfalz
M.M. Warburg & Co.
Main First Bank
SES Research
Viscardi Securities
WestLB

Im Bestreben nach umfassender und zeitnaher gleicher Information für alle Zielgruppen haben wir auf unserer Website zahlreiche Unternehmensinformationen bereitgestellt. Interessierte Anleger können sich im Internet auf der neu gestalteten Homepage unter [www.elmos.de](http://www.elmos.de) ausführlich über das Unternehmen, seine Produkte und Technologien informieren. Neben Informationen zu Corporate Governance werden dort Finanzberichte (Geschäfts- und Quartalsberichte), ein Finanzkalender zu allen wesentlichen Terminen und Veröffentlichungen, die Satzung der Gesellschaft, Informationen zur Hauptversammlung, Pressemitteilungen und meldepflichtige Wertpapiergeschäfte präsentiert. Das Investor Relations Team verschickt zudem gern Informationen, wie Geschäftsbericht oder Quartalsberichte, per Post.

Investor Relations  
ELMOS Semiconductor AG  
Heinrich-Hertz-Straße 1  
44227 Dortmund, Deutschland

Telefon +49 (0) 231-75 49-0  
Telefax +49 (0) 231-75 49-548  
[invest@elmos.de](mailto:invest@elmos.de)

## ► Hauptversammlung

An der fünften ordentlichen Hauptversammlung am 27. April 2004 nahmen wie in den vergangenen Jahren rund 300 private und institutionelle Investoren teil. Die Veranstaltung fand wiederum im Goldsaal der Westfalenhallen in Dortmund statt. Es waren 12.287.470 Euro oder 63,7 Prozent des Grundkapitals präsent. Die Vorschläge zu den einzelnen Tagesordnungspunkten nahm die Hauptversammlung jeweils mit sehr deutlicher Mehrheit an. Neben den üblichen Tagesordnungspunkten wurde eine bedingte Kapitalerhöhung zur Gewährung von Bezugsrechten im Rahmen des Aktienoptionsplans 2004 und die dadurch bedingte Satzungsänderung sowie die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien beschlossen.

Bei der Hauptversammlung 2004 ist von der Möglichkeit, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen, rege Gebrauch gemacht worden. Aktionäre, die nicht persönlich vor Ort waren, konnten die Hauptversammlung erstmalig live im Internet betrachten. Auch bei der Hauptversammlung am 26. April 2005 haben Aktionäre wieder die Möglichkeit, diese im Internet zu verfolgen. Aktionäre können ihr Stimmrecht selbst ausüben oder entweder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder durch einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen.

# ELMOS **ASSISTIERT** IHNEN BEIM FAHREN



In der Nacht

ist es nötig, das gesamte Bild zu sehen.



# ELMOS **ASSISTIERT** IHNEN BEIM FAHREN



In der Nacht

erleuchtet das Kurvenlicht die Richtung,  
in die Sie fahren.

Diese Hilfe macht das Autofahren sicherer.

- 1 Die Kurvenlicht-Steuerung bewegt die Scheinwerfer synchron in dieselbe Richtung.
- 2 Das Head-Up Display zeigt dem Fahrer auf der Windschutzscheibe alle wichtigen Informationen an.
- 3 Der Lenkwinkel-Sensor ermittelt, wie stark das Lenkrad eingeschlagen wurde.



1

1

2

3

DO IC 1

# ELMOS ASSISTIERT IHNEN BEIM FAHREN

Innovative Fahrerassistenz-Systeme helfen Ihnen in jeder Situation, den Überblick zu behalten. Dazu messen unsere Chips die Geschwindigkeit und den Abstand Ihres Autos. Zukünftig wird durch die Nachtsichtkamera und Fahrspurerkennung das Fahren komfortabler und sicherer. Unsere Chips machen das möglich.

- 1 Die Kurvenlicht-Steuerung bewegt die Scheinwerfer synchron in dieselbe Richtung.
- 2 Das Head-Up Display zeigt dem Fahrer auf der Windschutzscheibe alle wichtigen Informationen an.
- 3 Der Lenkwinkel-Sensor ermittelt, wie stark das Lenkrad eingeschlagen wurde.
- 4 Der Regen-/Tunnelsensor schaltet den Scheibenwischer bzw. die Scheinwerfer automatisch ein.
- 5 Die Insassenerkennung regelt bei einem Aufprall, welcher Airbag ausgelöst wird und erkennt, ob der Fahrer müde ist.
- 6 Die Nachtsichtkamera hilft dem Fahrer, durch Infrarotsicht auch in Dunkelheit seine Umwelt zu erkennen.
- 7 Der Toter-Winkel-Sensor warnt den Fahrer, falls er Gefahr läuft, ein Fahrzeug im toten Winkel zu übersehen.
- 8 Die Fahrspurerkennung warnt den Fahrer, falls er unbeabsichtigt die Fahrspur verlässt, beispielsweise im Sekundenschlaf.
- 9 Das Reifendruckkontrollsystem misst den Reifendruck und warnt den Fahrer bei Unregelmäßigkeiten.
- 10 Die Seitenabstandsmessung kontrolliert auf beiden Seiten, ob ein Mindestabstand unterschritten wird.
- 11 Das Park Distance Control gibt durch akustische Signale Hilfe beim Einparken.



1

1

8

5

2

4

6

5

7

3

7

9

10

11

11

11

11

## CORPORATE GOVERNANCE

*Sehr geehrte Aktionäre,*

der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz und Satzung obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Wir haben uns im abgelaufenen Geschäftsjahr intensiv mit der Lage des Unternehmens befasst, den Vorstand bei der Leitung des Unternehmens beraten und die Geschäftsführung überwacht. Der Vorstand hat uns regelmäßig, zeitnah und umfassend über alle relevanten Fragen der Unternehmensplanung und strategischen Weiterentwicklung, über den Gang der Geschäfte, die Lage des Konzerns einschließlich der Risikolage und des Risikomanagements unterrichtet. In Entscheidungen von grundlegender Bedeutung waren wir eingebunden; die strategische Ausrichtung hat der Vorstand mit uns abgestimmt. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den Plänen und Zielen wurden uns im Einzelnen erläutert. Sämtliche für das Unternehmen bedeutende Geschäftsvorgänge haben wir anhand der Berichte des Vorstands im Aufsichtsrat ausführlich erläutert. Auch außerhalb der Aufsichtsratssitzungen wurde der Vorsitzende des Aufsichtsrats vom Vorstand und im Speziellen vom Vorsitzenden des Vorstands über die wesentlichen Geschäftsvorgänge informiert. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats stand mit ihm regelmäßig in Kontakt und hat mit ihm Strategie, Geschäftsentwicklung und Risikomanagement des Unternehmens beraten.

### TÄTIGKEIT IM GESCHÄFTSJAHR 2004

Der Aufsichtsrat hat sich in fünf Sitzungen am 27. April 2004, am 8. Juli 2004, am 16. September 2004, am 17. Dezember 2004 und am 24. Februar 2005 sowie aufgrund schriftlicher und mündlicher Berichte des Vorstands eingehend über die Entwicklung des am 31. Dezember 2004 abgelaufenen Geschäftsjahres, die Lage der Gesellschaft und aktuelle geschäftspolitische Entscheidungen unterrichten lassen, diese mit dem Vorstand beraten und den Vorstand überwacht. Beschlüsse des Aufsichtsrats wurden im Rahmen der Sitzungen gefasst. Im Rahmen der Sitzungen haben wir uns auch mit der Effizienz der Arbeit des Aufsichtsrats befasst und diese bewertet.

### SCHWERPUNKTE DER BERATUNGEN IM AUFSICHTSRAT

Im Rahmen der Gespräche im Aufsichtsrat standen häufig die Entwicklung der Tochtergesellschaften sowie die Absatz-, Ergebnis- und Liquiditätsentwicklung im Vordergrund. So fand die Sitzung am 8. Juli 2004 bei unserer Tochtergesellschaft SMI in Milpitas statt. Dadurch wurde den Aufsichtsratsmitgliedern die Möglichkeit gegeben, direkten Einblick in die dortigen Gegebenheiten zu nehmen und sich über den Geschäftsverlauf und die strategischen Planungen vom lokalen Management aus erster Hand unterrichten zu lassen. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2004 den

Beschluss des Vorstands über die Ausgabe von bis zu 160.000 Aktienoptionen für Mitarbeiter unterhalb des Vorstands genehmigt. In der gleichen Sitzung wurde vom Aufsichtsrat beschlossen, für die Vorstände insgesamt 40.000 Aktienoptionen zu den gleichen Konditionen wie für die Mitarbeiter (und zusätzlicher Festlegung einer Begrenzung) auszugeben. Weitere Schwerpunkte waren die Pläne zur langfristigen Absicherung der Produktionskapazität sowie das ELMOS-Risikomanagementsystem und die Entsprechung zu den Empfehlungen und Anregungen des Deutschen Corporate Governance Kodex durch die Gesellschaft. Insbesondere wurde darüber hinaus die Jahresplanung für 2005 und die langfristige Geschäftsentwicklung der ELMOS-Gruppe ausführlich mit dem Vorstand behandelt.

#### CORPORATE GOVERNANCE UND ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zum Wohle des Unternehmens eng zusammen und sind der nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswerts verpflichtet. Am 17. Dezember 2004 wurde von der Gesellschaft eine aktualisierte Erklärung gemäß § 161 AktG bezüglich der Erfüllung der Empfehlungen des Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 21. Mai 2003 abgegeben und den Aktionären auf der Website dauerhaft zugänglich gemacht. Sie ist außerdem auf Seite 30 dieses Geschäftsberichts zu finden. Mit dieser Erklärung wurde bekannt gegeben, dass ELMOS lediglich in fünf Punkten von den Empfehlungen abweicht: beim Selbstbehalt der D&O-Versicherung der Organmitglieder, bei der Begrenzung der Vergütung des Vorstands mit Aktienoptionen, bei der Bildung von Aufsichtsratsausschüssen und beim individualisierten Ausweis aller Einkünfte der Mitglieder des Vorstandes und Aufsichtsrates. Im Vergleich zum letzten Jahr ist der Aspekt der Begrenzung der Vergütung des Vorstands für zukünftige Optionsprogramme auf Anregung von Aktionären bei der letzten Hauptversammlung mit aufgenommen worden. Eine solche Begrenzung wurde bereits bei dem im Dezember 2004 beschlossenen Aktienoptionsprogramm berücksichtigt.

#### JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSSPRÜFUNG

In seiner Sitzung am 24. Februar 2005 hat sich der Aufsichtsrat unter Hinzuziehung der Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, mit der Prüfung des Jahres- und Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2004 befasst. Der nach den Regeln des HGB aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2004 und der Lagebericht der ELMOS Semiconductor AG wurden gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom

27. April 2004 und der anschließenden Auftragserteilung durch den Aufsichtsrat von Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Dortmund, als Abschlussprüfer geprüft. Der Abschlussprüfer erteilte einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. Der Konzernabschluss der ELMOS Semiconductor AG wurde nach US-GAAP aufgestellt. Wie es die Befreiungsvorschrift des § 292a HGB vorsieht, wurde auf einen Konzernabschluss nach HGB verzichtet. Entsprechend wurden besondere Erläuterungen gemäß § 292a HGB hinzugefügt. Der Abschlussprüfer versah auch den Konzernabschluss nach US-GAAP und den Konzernlagebericht mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Des Weiteren hat der Abschlussprüfer den Bericht der ELMOS Semiconductor AG über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen gemäß § 312 AktG geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Demnach sind die tatsächlichen Angaben des Berichts richtig, bei den im Bericht aufgeführten Rechtsgeschäften war die Leistung der Gesellschaft nicht unangemessen hoch und bei den im Bericht aufgeführten Maßnahmen sprechen keine Umstände für eine wesentlich andere Beurteilung als die durch den Vorstand. Der Aufsichtsrat stimmt dem Ergebnis der Prüfung zu.

Die Prüfberichte und Abschlussunterlagen wurden dem Aufsichtsrat unmittelbar nach ihrer Aufstellung ausgehändigt. In der Bilanzsitzung am 24. Februar 2005, an welcher auch die Abschlussprüfer teilgenommen haben, wurden die Abschlüsse und Berichte zum 31. Dezember 2004 umfassend behandelt und geprüft. Die Abschlussprüfer berichteten über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfungen und standen für ergänzende Auskünfte zur Verfügung.

Nach eigener Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts hat der Aufsichtsrat dem Ergebnis der Prüfung durch den Abschlussprüfer zugestimmt und in der Sitzung am 24. Februar 2005 den Jahres- und Konzernabschluss gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Der Aufsichtsrat schließt sich dem Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns – der Ausschüttung einer Dividende von 0,21 Euro je Aktie aus dem Bilanzgewinn der ELMOS Semiconductor AG von 40,5 Millionen Euro und Übertragung des Restbetrags auf neue Rechnung – an.

#### BESETZUNG VON AUFSICHTSRAT UND VORSTAND

Während des Geschäftsjahres 2004 gab es keine Veränderung in der Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat.

Die im April 2004 ausgelaufenen Anstellungsverträge der Vorstände Knut Hinrichs und Dr. Klaus Weyer wurden durch den Aufsichtsrat für einen weiteren Zeitraum von fünf Jahren verlängert.

Die Amtsperiode der Aufsichtsratsmitglieder endet mit Ablauf der Hauptversammlung am 26. April 2005. Für die Neuwahl der Mitglieder unterbreitet der Aufsichtsrat einen Wahlvorschlag. Bei der Auswahl der Kandidaten wird darauf geachtet, dass dem Aufsichtsrat jederzeit Mitglieder angehören sollen, die über die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen und hinreichend unabhängig sind.

Dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken wir für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete Arbeit, den hohen Einsatz und erreichten Erfolg.

Dortmund, den 24. Februar 2005



Prof. Dr. Günter Zimmer, Vorsitzender des Aufsichtsrates

† Herr Knut Hinrichs verstarb am 1. März 2005. Wir empfinden seinen plötzlichen Tod als einen großen unersetzlichen Verlust. ELMOS verliert in ihm eine hervorragende Unternehmer- und Managerpersönlichkeit, die das Unternehmen von den ersten Anfängen an zu einem renommierten Halbleiterhersteller entwickelt hat. Mit großer Hingabe und persönlichem Einsatz hat er am Erfolg von ELMOS als seinem Lebenswerk gearbeitet. Wir sind ihm zu außerordentlichem Dank verpflichtet.

## ▸ Entsprechenserklärung

---

Die ELMOS Semiconductor AG hat für 2004 die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung abgegeben und den Aktionären zugänglich gemacht. Vorstand und Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG erklären gemäß § 161 AktG:

„Die ELMOS Semiconductor AG entspricht den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ (kurz: DCGK) in der Fassung vom 21. Mai 2003 mit folgenden Ausnahmen:

- Die derzeit gültige D&O-Versicherung für Aufsichtsrat und Vorstand sieht keinen Selbstbehalt für die Organmitglieder vor (DCGK Nr. 3.8). Vor dem Hintergrund der unklaren Rechtslage hinsichtlich der persönlichen Haftung eines einzelnen Organmitglieds wird eine Anpassung der Versicherung zur Zeit nicht vorgenommen.
- Für bereits ausgegebene Aktienoptionen ist keine Begrenzung („Cap“) bei der Vergütung des Vorstands für Aktienoptionen bei außerordentlichen, nicht vorhersehbaren Entwicklungen möglich (DCGK Nr. 4.2.3). Der Aufsichtsrat wird aber ab dem Jahr 2004 Aktienoptionen an Vorstandsmitglieder nur noch mit einem Cap ausgeben.
- Obgleich die Vergütung der Vorstandsmitglieder sowohl im Internet wie auch im Geschäftsbericht aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung (Aktienoptionen) ausgewiesen werden, erfolgen diese Angaben summiert und nicht individualisiert (DCGK Nr. 4.2.4).
- Abweichend von den Empfehlungen sieht die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der ELMOS Semiconductor AG die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschüssen und eines Prüfungsausschusses erst ab einer Anzahl von mehr als sechs Aufsichtsratsmitgliedern vor (DCGK Nr. 5.3.1 und 5.3.2).
- Auch die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben einer festen eine erfolgsorientierte Vergütung. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird, aufgegliedert nach ihren Bestandteilen, sowohl im Internet wie auch im Geschäftsbericht aufgeführt, jedoch nicht individualisiert. Die von der ELMOS Semiconductor AG an die Mitglieder des Aufsichtsrats gezahlten Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere für Beratungs- und Vermittlungsleistungen, werden nicht individualisiert im Anhang zum Konzernabschluss angegeben (DCGK Nr. 5.4.5).“

Dortmund, im Dezember 2004

Der Vorstand

Der Aufsichtsrat

## ► Aufsichtsrat

---



von links nach rechts:

**Herbert Sporea**

Kaufmann | Altwittenbek

**Prof. Dr. Günter Zimmer, Vorsitzender**

Institutsleiter FhG | Duisburg

**Dr. Burkhard Dreher, stellv. Vorsitzender**

Diplom-Volkswirt | Dortmund

**Dr. Roland Mecklinger**

Diplom-Ingenieur | Steinfeld-Hausen

**Dr. Wolfgang Heinke**

Diplom-Physiker | Reutlingen

nicht abgebildet:

**Dr. Karl-Thomas Neumann**

Diplom-Ingenieur | Meine

# ELMOS **VERBINDET** ELEKTRONIK MIT MECHANIK

Auf nasser Fahrbahn  
gibt Stabilität Ihnen Sicherheit.





# ELMOS **VERBINDET** ELEKTRONIK MIT MECHANIK

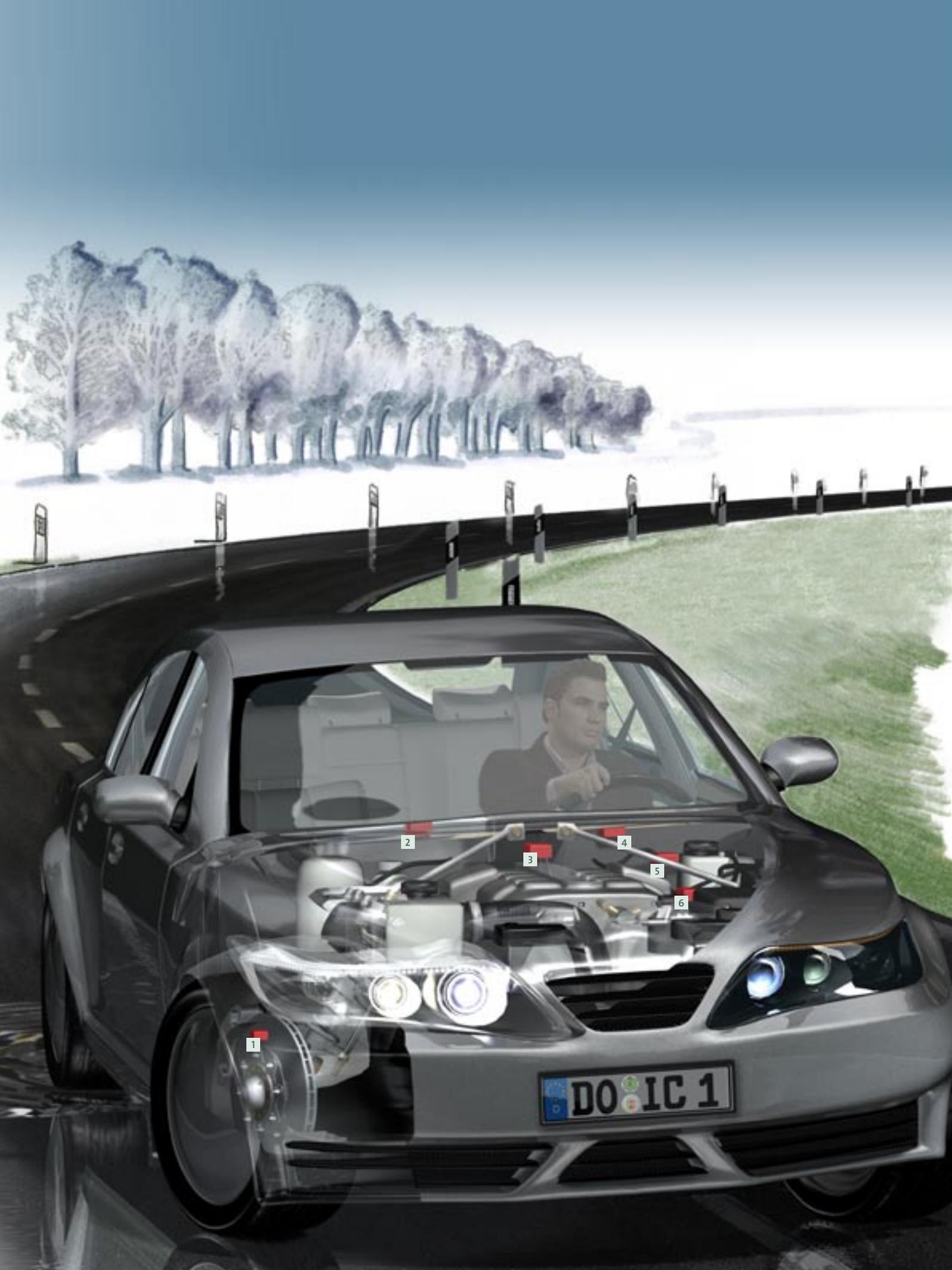
Auf nasser Fahrbahn

korrigiert das Elektronische Stabilitätsprogramm (ESP)  
eine Schleuderneigung Ihres Autos.

Dazu arbeiten Bauteile, die Elektronik und Mechanik verbinden,  
in Sekundenbruchteilen.

- 1 Der ABS/ESP-Sensor misst die Radumdrehung und übermittelt die Daten an die ABS/ESP-Steuerung.
- 2 Der Gier- und Neigungswinkelsensor erkennt, ob das Fahrzeug eine unregelmäßige Lage einnimmt.
- 3 Die Motorsteuerung regelt und misst alle wichtigen Funktionen des Motors, um eine optimale Leistung zu erhalten.
- 4 Der Lenkwinkel-Sensor ermittelt, wie stark das Lenkrad eingeschlagen wurde.
- 5 Die ABS/ESP-Steuerung wertet die Daten des Sensors aus und gleicht irreguläre Bewegungen aus.
- 6 Der Bremskraft-Verstärker erhöht die Leistung des Tritts auf das Bremspedal.





1

2

3

4

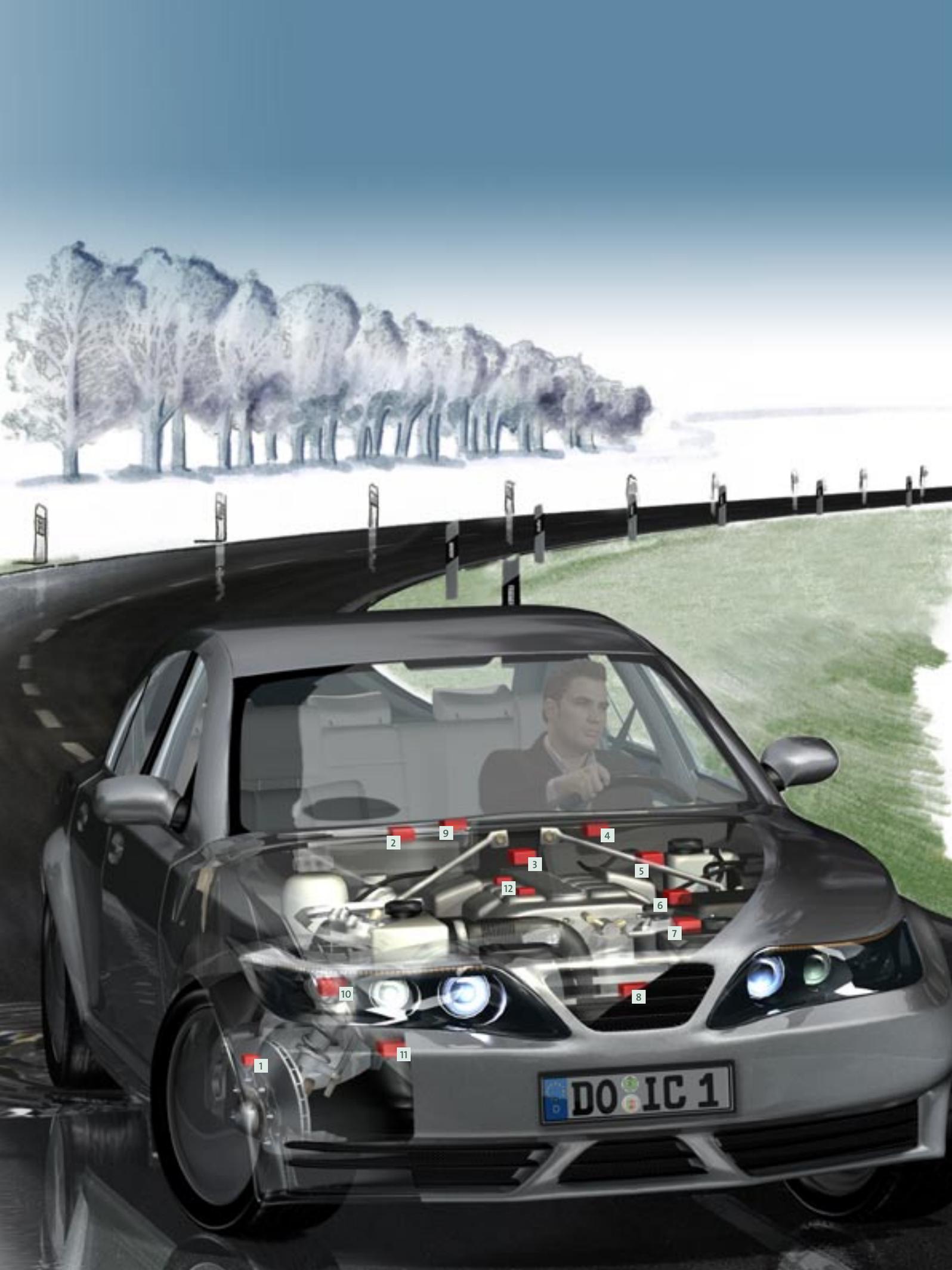
5

6

# ELMOS VERBINDET ELEKTRONIK MIT MECHANIK

Wo früher rein mechanische Systeme arbeiteten, sind heute und morgen kombinierte elektronisch-mechanische Lösungen zu finden: Kühlventilator, Lenkhilfe, Servobremse, Wasserpumpe und Ventiltrieb. Vorteile: Kombinierte Lösungen sparen Energie durch bedarfsgerechten Einsatz, erhöhen die Sicherheit durch schnellere Reaktion, verbessern die Effizienz durch zylinderindividuelle Regelung und sind preiswerter als konventionelle Bauelemente.

- 1 Der ABS/ESP-Sensor misst die Radumdrehung und übermittelt die Daten an die ABS/ESP-Steuerung.
- 2 Der Gier- und Neigungswinkelsensor erkennt, ob das Fahrzeug eine unregelmäßige Lage einnimmt.
- 3 Die Motorsteuerung regelt und misst alle wichtigen Funktionen des Motors, um eine optimale Leistung zu erhalten.
- 4 Der Lenkwinkel-Sensor ermittelt, wie stark das Lenkrad eingeschlagen wurde.
- 5 Die ABS/ESP-Steuerung wertet die Daten des Sensors aus und gleicht irreguläre Bewegungen aus.
- 6 Der Bremskraft-Verstärker erhöht die Leistung des Tritts auf das Bremspedal.
- 7 Die Servo-Lenkung verstärkt die Lenkkraft des Fahrers.
- 8 Die elektrische Wasserpumpe regelt nach Bedarf die Kühlung des Motors.
- 9 Der Querbeschleunigungssensor erkennt, wenn das Fahrzeug anfängt zu schleudern.
- 10 Die aktive Dämpfung passt sich den Straßenverhältnissen und dem Fahrstil an.
- 11 Der Starter-Generator vereint den Anlasser und die Lichtmaschine für eine platz- und energiesparende „stop-and-go“-Lösung.
- 12 Der elektrische Ventiltrieb optimiert die Verbrennung im einzelnen Zylinder.



1

10

2

11

9

12

3

6

8

5

7

4

DO IC 1

## KONZERNLAGEBERICHT DER ELMOS SEMICONDUCTOR AG FÜR 2004

### ► Geschäft und Rahmenbedingungen

Führende Marktposition  
für Automobilelektronik  
erarbeitet

#### GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND STRATEGIE

ELMOS entwickelt, produziert und vertreibt hochintegrierte zumeist anwendungsspezifische, mikroelektronische Schaltkreise, vornehmlich für die Automobilindustrie. Auch im Jahr 2004 entfielen rund 90 Prozent vom Umsatz auf dieses Marktsegment.

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat ELMOS sich eine führende Marktposition als Halbleiterhersteller im europäischen Markt für Automobilelektronik erarbeitet. In einer Erhebung von Gartner Dataquest wird das Unternehmen als die weltweite Nummer drei im Segment der ASICs (Application Specific Integrated Circuits) für den Automobilmarkt aufgeführt.

Position	Unternehmen	2003 (Mio USD)	Wachstum 2002-2003	Marktanteil
1	ST Microelectronics	317	31%	26%
2	NEC Electronics	155	28%	13%
3	ELMOS Semiconductor	117	38%	10%
4	AMI Semiconductor	103	23%	9%
5	Philips	101	4%	8%
	Sonstige	409	7%	34%
	<b>Gesamt</b>	<b>1.202</b>	<b>19%</b>	<b>100%</b>

Quelle: Gartner Dataquest 2004

ELMOS-ASICs werden von nahezu allen europäischen Fahrzeugherstellern eingesetzt. Stetig wachsende Anforderungen an die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der Umweltverträglichkeit eines Kraftfahrzeugs und insbesondere an Sicherheit und Komfort der Fahrzeuginsassen führen zu immer mehr Elektronik im Auto. Halbleiterbausteine von ELMOS sind ideal geeignet, solche Systeme kompakt, zuverlässig und kostengünstig aufzubauen.

Seit Firmengründung bedient ELMOS geschützte Nischenmärkte mit eigenem Know-how. Es ist die Strategie, zum einen durch eine konsequent an den Marktbedürfnissen optimierte Fertigungstechnologie und zum anderen durch die kundenspezifische Produktentwicklung zu überzeugen. So entwickelt ELMOS Produkte in der Regel im Kundenauftrag für eine spezielle Anwendung und produziert diese exklusiv für diesen Kunden. ELMOS ist bestrebt, als kompetenter Partner der Kunden mit maßgeschneiderten, integrierten Schaltungen ein profitables Geschäft zu betreiben und die eigenen Marktanteile zu erhöhen.

- Geschäft und Rahmenbedingungen
- Zukunft der Automobilelektronik
- Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
- Nachtragsbericht
- Risikobericht
- Prognosebericht

Neben den kundenspezifischen Schaltkreisen, die etwa 80 Prozent der Produkte umfassen, verfügt ELMOS zudem über ein Portfolio von vermarktungsfähigen, anwendungsspezifischen Standardprodukten (ASSPs) sowie von mikromechanischen Sensoren aus der Produktion der Tochtergesellschaft Silicon Microstructures Inc. (SMI) in den USA. Darüber hinaus unterstützt die produzierende Tochterfirma ELMOS Advanced Packaging B.V. (vormals eurasem) in den Niederlanden das Technologie- und Produktportfolio.

ELMOS produziert alle ASICs selbst. Hierzu wird in Dortmund eine eigene Produktionsstätte für Halbleiterbauelemente (Wafer-Fab) betrieben. Sowohl durch die automobil-gerechte Hochvolt-CMOS Technologie als auch durch die systemgerechte Integration von analogen und digitalen Funktionen mit On-Chip Treiberleistungen unterscheidet sich ELMOS von den meisten Wettbewerbern.

ASIC<sup>plus</sup> kombiniert die Fähigkeiten der ELMOS-Gruppe

Unter dem Slogan „ASIC<sup>plus</sup> – more than a chip!“ entwickelt und vermarktet ELMOS anwendungsspezifische, mechatronische Module. Diese Module kombinieren die Fähigkeiten der drei produzierenden Unternehmen der ELMOS-Gruppe und bestehen aus signalverarbeitenden Halbleiterbauelementen, mikromechanischen Sensoren und funktionalem Gehäuse. Damit kann das Unternehmen kostengünstige Systemlösungen für Kunden realisieren.

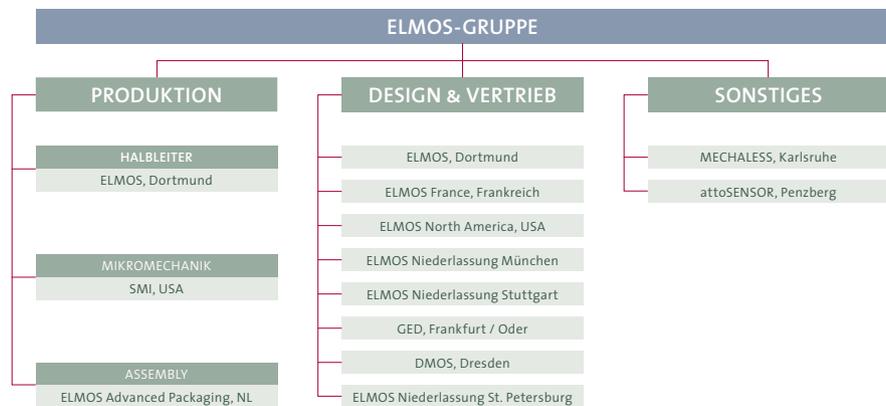
Neben dem automobilen Markt ist ELMOS außerdem im Industrie- und Konsumbereich tätig und liefert kundenspezifische Schaltkreise für Anwendungen in Haushaltsgeräten, Fotoapparaten, Installations- und Gebäudetechnik und Maschinensteuerungen. Diese Märkte haben im vergangenen Jahr rund zehn Prozent des Umsatzes ausgemacht.

#### ORGANISATIONSSTRUKTUR

Das Geschäftsmodell orientiert sich an den Anforderungen der Automobilindustrie sowie an den Bedürfnissen der Kunden nach Innovation, Qualität, Flexibilität und Liefertreue. Die daraus resultierende enge Kunden-Lieferantenbeziehung spiegelt sich in der verteilten Struktur der ELMOS-Gruppe wider. Diverse Niederlassungen, Tochter- und Partnerfirmen an mehreren Standorten in Deutschland, Europa und weltweit dienen der Vertriebs- und Applikationsunterstützung beim Kunden vor Ort. Dies umfasst unter anderem die Niederlassungen in München und Stuttgart, die Toch-

tergesellschaften ELMOS France, MECHALESS und GED sowie die Kooperationspartner attoSENSOR, DMOS und MAZ. ELMOS France betreut den für das Unternehmen neben Deutschland wichtigsten Regionalmarkt Frankreich und bietet Applikations- und Designunterstützung vor Ort. ELMOS North America bedient den nordamerikanischen Markt von ihrem Sitz in Farmington Hills bei Detroit aus, dem Zentrum der amerikanischen Automobilindustrie.

### Organisationsstruktur im Überblick



SMI mit Sitz in Milpitas, Kalifornien, entwickelt, vertreibt und produziert mikromechanische Bauelemente (MEMS) in einer eigenen Fertigung. SMI zählt zu den Technologieführern im Bereich der hochpräzisen Drucksensoren in Silizium. Die Bauelemente werden bevorzugt in der Sensorik eingesetzt. Neben Drucksensoren entwickelt SMI zudem Sensoren für Beschleunigung und Drehbewegungen, die speziell für die Automobilindustrie geeignet sind. Mit einer eigenen Fertigung in Kalifornien verfügt SMI über stabile Serienfertigungseinrichtungen und -fähigkeiten.

ELMOS Advanced Packaging ist neben SMI die einzige Tochtergesellschaft mit eigener Produktion. ELMOS Advanced Packaging mit Sitz in Nijmegen, Niederlande, ist ein hochspezialisierter Assembler für die Halbleiterindustrie und entwickelt und fertigt Gehäuse für elektronische Halbleiterkomponenten und Sensoren. Neben Gehäusen gemäß JEDEC-Normen gehören insbesondere kunden- und applikationsspezifische Spezialgehäuse, die sich teilweise durch patentiertes Know-how vom Wettbewerb unterscheiden, zum Produktportfolio. Die Fabrik in Nijmegen entspricht dem modernsten Stand der Technik. ELMOS Advanced Packaging hat per Ende 2004 das operative Geschäft von der Firma eurasem übernommen, die in 2004 rund 57 Prozent der Assembly-Leistungen für ELMOS abdeckte. Neben der konzerninternen Assem-

- Geschäft und Rahmenbedingungen
- Zukunft der Automobilelektronik
- Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
- Nachtragsbericht
- Risikobericht
- Prognosebericht

blierung ist die Gesellschaft in der Verarbeitung von Sondergehäusen für Drittkunden tätig.

Innerhalb der MECHALESS werden die Software- und Hardware-Aktivitäten der HALIOS®-Erfinder und die ELMOS-Tätigkeiten im Bereich der optischen Sensorsysteme zusammengeführt, optimiert und gezielt vermarktet. MECHALESS ist im Jahr 2004 erstmalig voll konsolidiert worden, weil weitere zwei Prozent der Anteile ELMOS wirtschaftlich zuzuordnen waren. Im Jahr 2004 wurden zahlreiche Auftragsentwicklungen von MECHALESS durchgeführt. Besonders bemerkenswert ist die erfolgreiche Entwicklung eines optischen Eingabemediums für einen großen Hersteller von Telekommunikationsgeräten und der Einsatz von HALIOS®-Sensoren für die Fahrspurerkennung im Automobil.

attoSENSOR ist ein Ingenieurbüro und entwickelt innovative induktive Sensorsysteme für die Positionsbestimmung unter Verwendung von patentiertem Know-how und ASICs von ELMOS. Die Produkte von attoSENSOR sind hochauflösende Drehgeber für die industrielle Automatisierungstechnik. Die bestehenden Kundenverbindungen konnten im Jahr 2004 weiter ausgebaut und zahlreiche mehrjährige Serienlieferverträge abgeschlossen werden.

Unterscheidung zwischen Halbleiter, Mikromechanik und Assembly

In der Segmentberichterstattung unterscheidet ELMOS zwischen den Bereichen Halbleiter, Mikromechanik und Assembly. Das Segment Mikromechanik besteht aus SMI, Assembly im Wesentlichen aus ELMOS Advanced Packaging. Die weiteren Gesellschaften werden im Segment Halbleiter geführt. Da die gruppeninternen Dienstleistungen von ELMOS Advanced Packaging die externen Aktivitäten deutlich überschreiten, wird ELMOS ab 2005 die Segmentberichterstattung für das Segment Assembly einstellen.

#### Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die ELMOS Finanzholding GmbH (EFH) ist mit einem mittelbaren und unmittelbaren Anteilsbesitz von 57,7 Prozent größter Einzelaktionär der ELMOS Semiconductor AG. Daher hat der Vorstand gemäß § 312 AktG einen Bericht über die Beziehungen zu verbundenen Unternehmen aufgestellt, der mit folgender Erklärung gemäß § 312 Abs. 3 AktG abschließt:

„Wir erklären, dass unsere Gesellschaft nach den Umständen, die uns zum Zeitpunkt bekannt waren, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen und die Maßnahmen getroffen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten hat. Nachteile im Sinne von § 312 AktG haben sich aus den Beziehungen zu verbundenen Unternehmen für uns nicht ergeben.“

## WIRTSCHAFTLICHES UMFELD

Als Hersteller von Halbleitern für die Automobilindustrie ist für ELMOS der Halbleitermarkt aus Produktionssicht, beispielsweise für den Einkauf von Produktionsmaschinen, relevant. Eine mit Abstand höhere Bedeutung für die Geschäftsentwicklung haben aber die Abnehmermärkte, welche hauptsächlich von der Automobilproduktion und dabei im besonderen vom Elektrik-/ Elektronikanteil im Fahrzeug abhängig sind.

### Halbleitermarkt

Die Halbleiterindustrie konnte in 2004 erstmals nach Jahren wieder ein zweistelliges Umsatzwachstum realisieren. Nach dem Krisenjahr 2001 der Halbleiterindustrie mit einem Umsatzrückgang von 32 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2000, wuchs der Gesamtumsatz von rund 166 Milliarden USD in 2003 auf 213 Milliarden USD in 2004 weltweit weiter an. Damit konnte die Branche im vergangenen Jahr mit einem Umsatzanstieg von fast 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr an zurückliegende hohe Wachstumsraten anknüpfen. Speicherchips für Computer und Kamerachips für Mobiltelefone waren die größten Wachstumstreiber in 2004. So übertraf der weltweite Umsatz 2004 sogar noch das hohe Niveau von 2000.

Nach einem guten ersten Halbjahr verflog die Euphorie in der zweiten Jahreshälfte, so dass für den Halbleitermarkt von einer Seitwärtsbewegung in 2005 und erst wieder in 2006 mit einem Aufwärtstrend gerechnet wird.

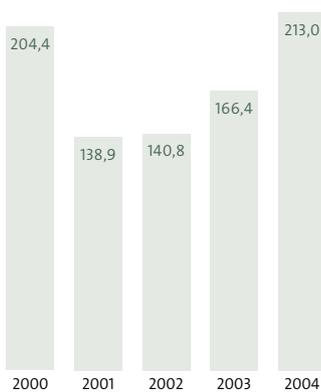
Die Konjunktur des Halbleitermarktes ist für ELMOS insofern von Bedeutung, als dass die Kosten für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die bezogenen Leistungen und die Anschaffungskosten für Investitionsgüter konjunkturbedingt schwanken. Außerdem ist das Bestellverhalten der Kunden stark von der allgemeinen Konjunkturlage abhängig. So gibt es in Boomphasen stets überzogene „Angstbestellungen“ und in Flautezeiten deutliche Zurückhaltung.

### Automobilindustrie und Elektronik im Fahrzeug

Entscheidend für ELMOS ist die Entwicklung des Marktes für Automobilelektronik, der rund 90 Prozent des Umsatzes von ELMOS beeinflusst. Veränderungen im automobilen Halbleitermarkt sind zum einen gekennzeichnet durch die Konjunktur der Automobilindustrie und zum anderen durch den wachsenden Elektronikanteil im Auto.

Für die Automobilindustrie war 2004 ein erfolgreiches Jahr: So konnten die Automobilzulassungen in 2004 einen deutlichen Zuwachs verzeichnen. Im Vergleich zur rückläufig prognostizierten Tendenz ist dies eine positive Überraschung. Ursache dafür war unter anderem ein kräftiger Jahresendspurt, der in Europa zu einem Zuwachs der Auto-Neuzulassungen geführt hat. Für das gesamte Jahr 2004 ergab sich daraus ein

Halbleitermarkt in Milliarden US-Dollar

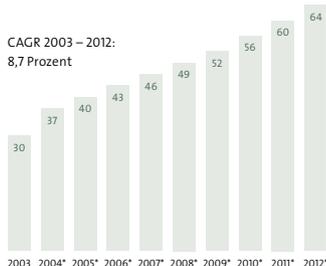


Quelle: Semiconductor Industry Association (SIA)

ELMOS profitiert vom wachsenden Elektronikanteil im Auto

- Geschäft und Rahmenbedingungen
- Zukunft der Automobilelektronik
- Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
- Nachtragsbericht
- Risikobericht
- Prognosebericht

**Elektronikanteil im Auto in Milliarden US-Dollar**



\* Prognose | Quelle: Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie (ZVEI)

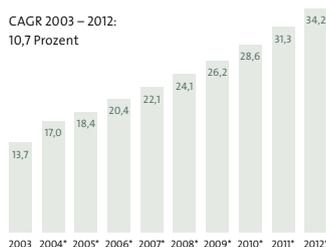
Plus von 2,1 Prozent auf 14,5 Millionen Neuzulassungen; die höchste Zahl seit 2001. Der Autoabsatz in Deutschland stieg im Gesamtjahr 2004 um 0,9 Prozent, der erste Anstieg seit fünf Jahren. In den USA wurden 2004 ein Prozent mehr PKWs verkauft. In Japan wuchs der Markt um sieben Prozent. Damit ergibt sich für den weltweiten Absatz 2004 ein Zuwachs in der Größenordnung von vier Prozent.

Langfristig weist die Automobilproduktion geringe Wachstumsraten auf. Dennoch profitiert der automobiler Halbleitermarkt, in dem die EL MOS-Gruppe tätig ist, vom langfristigen Trend des steigenden Anteils von Elektronik im Fahrzeug. Das Umsatzwachstum der Automobilelektronik wird weniger durch steigende Zulassungszahlen generiert, sondern vielmehr durch die zunehmende Elektronikausstattung. So wird eine jährliche Umsatzsteigerung bis 2012 von durchschnittlich 8,7 Prozent erwartet. Die immer höheren Anforderungen an Sicherheit, Komfort und Umweltverträglichkeit sowie der zunehmende Ersatz mechanischer Funktionen durch Elektronik sind hierfür verantwortlich.

**Automobiler Halbleitermarkt**

Halbleiterchips für die Automobilindustrie – der Markt, in welchem die EL MOS-Gruppe vorrangig tätig ist – stellen einen interessanten Nischenmarkt der globalen Halbleiterindustrie dar. Dieser Spezialmarkt umfasst weltweit einen Anteil von rund acht Prozent vom Gesamtmarkt. Bedingt durch den Einfluss der Automobilproduktion und des zunehmenden Anteils der Elektronik im Fahrzeug weist der automobiler Halbleitermarkt eine deutlich höhere Stabilität auf als der globale Halbleitermarkt, welcher hauptsächlich durch die Entwicklungen bei Speicher- und Kommunikationschips geprägt ist. Spezielle Differenzierungsmerkmale des automobilen Halbleitermarkts sind die für die Halbleiterbranche untypisch langen Produktlebensdauern und die dadurch bedingten langen Lieferzeiträume von teilweise mehr als zehn Jahren, die langfristigen Kunden-Lieferanten-Beziehungen, die sehr hohen Qualitätsanforderungen und die hohe Planungssicherheit.

**Automobiler Halbleitermarkt in Milliarden US-Dollar**



\* Prognose | Quelle: Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie (ZVEI)

Der von EL MOS maßgeblich adressierte Markt ist wiederum nur ein Teil des automobilen Halbleitermarkts, nämlich der der vorwiegend kundenspezifischen Halbleiter. Wegen der vergleichsweise geringen Jahresstückzahlen stehen diese ASICs nicht im Fokus der großen Halbleiterhersteller, welche Auslastung für ihre großen Produktionskapazitäten suchen. Weitere Differenzierungsmerkmale des ASIC-Geschäftes sind sehr enge Lieferbeziehungen des Kunden zu einem einzelnen ASIC-Hersteller, die aus Wunsch des Kunden nach Schutz des eigenen Know-hows entstehen. Der automobiler Halbleitermarkt wird daher vor allem von kleinen bis mittelgroßen Anbietern bedient, mit denen EL MOS im Wettbewerb steht. Dazu zählen vor allem AMI Semiconductor, Bosch (Halbleiterdivision) und Melexis.

Maschinenkapazität  
derzeit bei rund 450  
Waferstarts pro Tag

### PRODUKTION UND KAPAZITÄTEN

Seit 1999 produziert ELMOS ausschließlich auf der 150mm-Wafer-Linie (entspricht 6-Zoll) in Dortmund. Diese wurde in 2004 weiter planmäßig ausgebaut, um für die nächsten Technologie-Generationen und den steigenden Kapazitätsbedarf der Produktion vorbereitet zu sein. Die Produktionsräume und -anlagen am Standort Dortmund sind für Prozesse mit Strukturbreiten bis 0,35 Mikrometer auf den modernsten Stand der Technik ausgelegt. Sie bilden damit eine solide Plattform für die ELMOS-Produktion der nächsten zehn Jahre. Zum Jahresende 2004 lag die Maschinenkapazität bei etwa 450 Waferstarts pro Tag, wovon rund 380 Waferstarts pro Tag genutzt wurden – rund 85 Prozent Auslastung im Vergleich zu rund 70 Prozent in 2003. Insgesamt wurden in 2004 über 120.000 Wafer gefertigt.

In 2004 wurden etwa 150 verschiedene Produkte mit nennenswertem Umsatz parallel produziert, davon sind 21 neu in die Produktionsphase überführt worden. Damit kennzeichneten zahlreiche Produktneuanläufe das Jahr 2004.

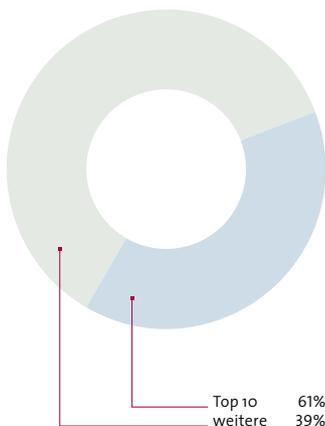
Im Assembly-Segment wurden etwa 63 Millionen Bauteile allein für ELMOS verarbeitet, hinzu kamen rund fünf Millionen Bauteile für Drittkunden. ELMOS Advanced Packaging deckte im Gesamtjahr 2004 rund 57 Prozent der Assembly-Leistungen für ELMOS ab.

ELMOS' umsatzstärkstes Produkt in 2004 war ein Airbag-Zünd-IC und machte 6,1 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Die zehn umsatzstärksten Produkte summierten sich auf 39,3 Prozent des Umsatzes. Dies waren alles ASICs. Fallweise wird ein kundenspezifisches Produkt an mehrere Kunden geliefert. Diese zunächst widersprüchlich erscheinende Aussage resultiert daraus, dass ELMOS – insbesondere mit BMW – Produkte entwickelt. Diese werden über mehrere Zulieferer in verschiedenen BMW-Modellen verwendet. ASSPs werden ebenfalls an mehrere Kunden verkauft.

### Zukünftige Kapazitäten

Als selbst produzierendes Unternehmen ist für ELMOS die Bereitstellung der zukünftig benötigten Produktionskapazitäten von entscheidender Bedeutung. Gerade da die Investitionen in die Produktion den wesentlichen Teil des gesamten Investitionsbudgets ausmachen, ist eine sorgfältige und langfristige Planung notwendig. Die Kapazität der bestehenden Produktionslinie in Dortmund kann nach wie vor durch Rekrutierung weiterer Mitarbeiter und durch weitere Investitionen in Maschinen und Ausbau von Räumen erweitert werden. Durch im Jahr 2004 eingeleitete Maßnahmen können weitere Nebenflächen der Produktion mittelfristig zugeführt werden, wodurch sich die Kapazität auf bis zu 600 Waferstarts pro Tag ausbauen lässt. Dies übertrifft die früheren Annahmen von maximal 500 Waferstarts pro Tag. Damit könnte genügend Fertigungskapazität für das geplante Wachstum in den kommenden zwei bis drei Jahren dargestellt werden.

Umsatz nach Produkten



Bestehende Produktions-  
linie in Dortmund  
kann erweitert werden

- Geschäft und Rahmenbedingungen
- Zukunft der Automobilelektronik
- Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
- Nachtragsbericht
- Risikobericht
- Prognosebericht

### Kooperation mit dem IMS sichert weitere Kapazitäten

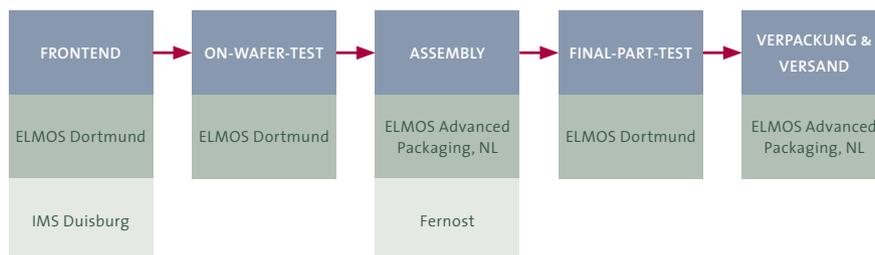
Zur weiteren Absicherung der Produktionskapazitäten betreibt ELMOS seit Ende 2003 ein Kooperationsvorhaben mit dem Fraunhofer-Institut für mikroelektronische Schaltungen und Systeme (IMS) in Duisburg mit dem Ziel, mit der Fraunhofer Gesellschaft einen Vertrag über die Nutzung und den Betrieb der Fertigungslinie des Institutes abzuschließen. Das IMS verfügt über eine 200mm-Wafer-Linie (entspricht 8-Zoll) für Forschungszwecke. Hier kann aus heutiger Sicht für ELMOS eine Kapazität von bis zu 200 Waferstarts pro Tag aufgebaut werden. Im Jahr 2004 wurde planmäßig mit dem Prozesstransfer begonnen und erste Versuchschargen in Duisburg gefertigt. In 2005 sollen die ersten Produkte auf der 200mm-Linie qualifiziert werden, so dass in 2006 die ersten Serienfertigungen starten können.

Da die Fertigung auf den größeren 200mm-Wafern Kostenvorteile bringt, sollen zunächst die IMS-Kapazitäten ausgelastet werden. Nachfolgend sollen die Kapazitäten in Dortmund auf Basis von 150mm oder eventuell sogar von 200mm-Wafern erweitert werden.

Unabhängig davon ist bereits im Jahr 2005 eine Erweiterung der Kapazität des Testbereichs (Backend) in Dortmund notwendig. Der ursprüngliche Plan sah hier die schrittweise Verlagerung von Testkapazität zur niederländischen Tochter ELMOS Advanced Packaging vor. Die Errichtung eines Backend-Reinraums geeigneter Größe entweder in den Niederlanden oder in Dortmund ist jedoch notwendig. Die Entscheidung fiel für den Ausbau in Dortmund, da dies den Vorteil bietet, dass der komplette Testbetrieb unter einheitlicher Leitung an einem Standort durchgeführt wird.

ELMOS Advanced Packaging in den Niederlanden übernimmt allerdings zusätzlich zum Assembly die bislang in Dortmund verrichteten Produktionsschritte Verpackung und Logistik. Damit wird die Wertschöpfungskette zukünftig wie in folgender Grafik aussehen:

Produktionsschritte eines ELMOS ASICs



### Langfristiges Investitionsbudget

Der gesamte Investitionsbedarf für die langfristige Bereitstellung von Produktionskapazitäten wurde zusammen mit den Anforderungen der übrigen Unternehmen der ELMOS-Gruppe in einem mehrjährigen Investitionsbudget zusammengefasst. Dieser Rahmenplan sieht in den kommenden Jahren Investitionen in Höhe von jeweils rund 30 Millionen Euro vor.

ELMOS handelt aus einer geschützten Position

### FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Die nicht automobilen Märkte dienen der ELMOS-Gruppe sowohl in der Vergangenheit wie auch heute als Innovationstreiber. Hohe Anforderungen der Automobilindustrie an Qualität und Zuverlässigkeit der ICs sowie lange Entwicklungszeiten bis zur Serienproduktion erschweren rasche Weiterentwicklungen von Halbleitertechnologien. Die anderen schnelllebigeren Märkte mit kurzfristigen Produktlebenszyklen und anders gearteten Anforderungen an Geschwindigkeit und Speichergröße führen dazu, dass dort mit großem Aufwand neueste Technologien in kürzester Zeit und schneller Abfolge etabliert werden. Die Technologien für diese innovationstreibenden Märkte werden erst mit deutlichem zeitlichen Verzug auch im automobilen Halbleitermarkt eingesetzt. Sowohl im Automobil- wie auch im Konsum- und Industriebereich agiert ELMOS stets aus geschützter Position, entweder technologiebedingt oder aufgrund speziellen Anwendungs-Know-hows.

Die Aktivitäten zur Entwicklung neuer Prozesstechnologien mit kleineren Strukturgrößen und Flash-Option sowie die Weiterentwicklung der Silicon-On-Insulator-Technologie (SOI) machen einen Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung aus. Die Forschung und Entwicklung (F&E) der Technologen und Prozessingenieure konzentrierte sich im Jahr 2004 auf die Produktionseinführung der 0,5 Mikrometer Hochvolt-Prozesstechnologie, die Weiterentwicklung der Flash-Option und die Strukturverkleinerung (Shrink) bei der SOI-Technologie. Parallel dazu wurden mehrere Projekte zur Optimierung von Baugröße und Eigenschaften wichtiger Hochvoltbauelemente durchgeführt, die für typische ELMOS-Anwendungen von Bedeutung sind. Außerdem wurde mit der Vorentwicklung der 0,35 Mikrometer Prozesstechnologie begonnen. Damit verfolgt ELMOS konsequent die Strategie, durch eigene Prozesstechnologien innovative und wettbewerbsüberlegene Lösungen anbieten zu können.

Neben den Entwicklungen neuer Prozesse entfällt der mit Abstand größere Teil der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung auf die Entwicklung neuer Produkte. Wie schon in der Vergangenheit haben im Jahr 2004 die Kunden weiterhin Druck dahingehend ausgeübt, dass der Lieferant die Kosten für Forschung und Entwicklung eines ASICs übernimmt. Dies bedeutet, dass ein Großteil der Produktentwicklungskosten vom ASIC-Lieferanten, das heißt ELMOS, vorfinanziert werden muss und sich erst über die Serienstückfertigung amortisieren kann. Darüber hinaus haben die

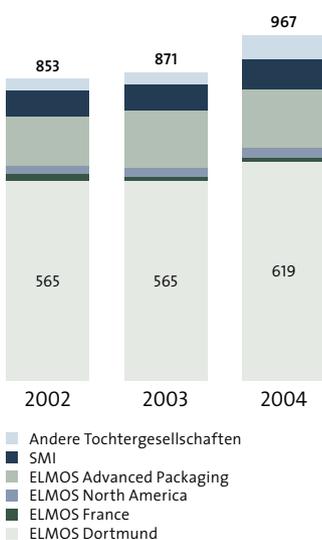
- Geschäft und Rahmenbedingungen
- Zukunft der Automobilelektronik
- Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
- Nachtragsbericht
- Risikobericht
- Prognosebericht

Automobilhersteller weiterhin forciert, dass ihre Zulieferer Verantwortung für Systeme übernehmen, welche diese ihrerseits an die Zulieferer der zweiten Reihe weitergeben. Diese Aufgaben werden somit zunehmend von ELMOS übernommen. In Folge davon stiegen die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Millionen Euro auf eine Quote von rund 17,0 Prozent vom Gesamtumsatz an.

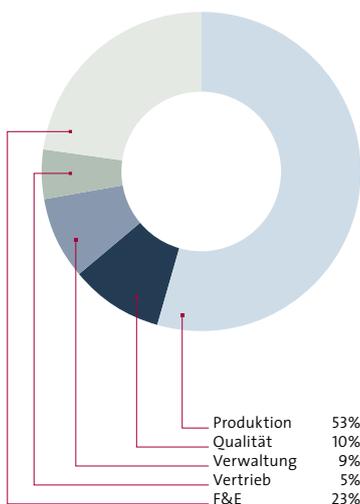
**MITARBEITER**

Als Technologieunternehmen profitiert ELMOS in besonderem Maße vom Know-how der Mitarbeiter. Deren Motivation, Wissen und Flexibilität sind die Voraussetzung für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Besonders in der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren sind die Mitarbeiter das entscheidende Kriterium für das Wachstum und die Innovationskraft. Am Standort Dortmund in Nordrhein-Westfalen, im bevölkerungsreichsten Bundesland, kann ELMOS auf eine große Zahl von gut ausgebildeten Jungingenieuren zugreifen, denn im näheren Umkreis befinden sich mehr als fünfzig Universitäten und Hochschulen. Als einziger Halbleiterhersteller der Region hat ELMOS eine Ausnahmestellung. Daher ist auch in Zeiten mit rückläufigen Studentenzahlen in den Ingenieurwissenschaften der Nachwuchs gesichert. Schon seit der Gründung kooperiert ELMOS eng mit den umliegenden Universitäten, Hochschulen und Instituten, wobei viele Mitarbeiter als studentische Hilfskräfte bei ELMOS begonnen haben und heute Führungsaufgaben wahrnehmen. Die meisten sind daher schon viele Jahre bei ELMOS.

Mitarbeiterentwicklung (Jahresende)



Mitarbeiter nach Funktionen



Trotz eines strikten Sparkurses gehörte ELMOS auch im Jahr 2004 zu den wenigen Unternehmen, die neue Arbeitsplätze geschaffen haben. ELMOS beschäftigte im Geschäftsjahr 2004 konzernweit im Mittel insgesamt 928 Mitarbeiter gegenüber 874 Mitarbeitern in 2003. Die Neueinstellungen entfielen vor allem auf die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie Vertrieb und waren beeinflusst durch die erstmalige Konsolidierung von MECHALESS. Zum Jahresende wurden 967 Mitarbeiter (2003: 871 Mitarbeiter) beschäftigt, davon 619 am Standort Dortmund. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter im ELMOS-Konzern liegt bei 35 Jahren. Die Fluktuation im Jahr 2004 beträgt 3,2 Prozent.

Im Jahr 2004 hat ELMOS anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums und in Anbetracht der schwierigen Lage auf dem Ausbildungsmarkt 20 zusätzliche Auszubildende eingestellt, so dass in 2004 insgesamt 35 Auszubildende ihre Ausbildung bei ELMOS begonnen haben. Knapp die Hälfte der neuen Auszubildenden erlernt den Beruf des Mikrotechnologen, welcher Ende der Neunziger Jahre entstanden ist und maßgeblich von ELMOS mitgestaltet wurde. Neben Mikrotechnologen bildet ELMOS Physiklaboranten, Elektroniker für Betriebstechnik, Kaufleute für Bürokommunikation, Fachkräfte für Lagerwirtschaft, Industriekaufleute, Informations- und Telekom-

munikations-Elektroniker, Fachinformatiker, Informatikkaufleute und Elektroinstallateure aus. Ende 2004 waren 57 der Dortmunder Mitarbeiter Auszubildende. Die heutigen Azubis sind die Fachleute von morgen.

Der Vorstand und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Dortmund vertrauensvoll zusammen. Eine Mitarbeitervertretung mit selbst gegebener Satzung vertritt in zahlreichen Ausschüssen die Belange der Mitarbeiter untereinander und im Verhältnis zur Geschäftsleitung. So gibt es Ausschüsse für soziale Fragen, Personalangelegenheiten, Mitarbeiterförderung und Wirtschaft.

#### **Aktienoptionsprogramme**

Eine langfristige Bindung an das Unternehmen und eine Erfolgsbeteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird über jährliche Aktienoptionsprogramme erreicht. Diese Programme sehen die Ausgabe von Aktienoptionen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterhalb des Vorstands und zu identischen Bedingungen an den Vorstand vor. Als zusätzliche Bedingung wurde für die Aktienoptionen der Mitglieder des Vorstands mit dem Aktienoptionsprogramm 2004 eine Begrenzung der Wertsteigerung eingeführt. Für die Vorstandsmitglieder dienen die Aktienoptionen gleichzeitig als variable Vergütungskomponente mit langfristiger Anreizwirkung.

Für das Aktienoptionsprogramm steht durch Beschluss der Hauptversammlung vom 27. April 2004 ein bedingtes Kapital bis zu einem Betrag von 930.000 Euro zur Verfügung. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 17. Dezember 2004 den Beschluss des Vorstands über die Ausgabe von bis zu 160.000 Aktienoptionen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterhalb des Vorstands sowie 40.000 Aktienoptionen für den Vorstand zu einem Ausgabekurs von 13,98 Euro genehmigt. Der Ausgabebetrag pro Option bestimmt sich aus dem Zehn-Tage-Mittel des amtlichen Börsenkurses der ELMOS-Aktie vor dem Beschlusstag und einer Ausübungshürde in Höhe von zehn Prozent. Die Optionen können frühestens nach einer Frist von zwei Jahren ausgeübt werden und haben danach eine Laufzeit von drei Jahren. Die Ausübung kann nur in bestimmten zeitlichen Fenstern erfolgen.

Von Seiten der Belegschaft und des Vorstands wurden 295.722 Aktienoptionen aus dem Optionsprogramm des Jahres 2003 im Jahr 2004 gezeichnet. Zum 31. Dezember 2004 standen insgesamt 803.210 Aktienoptionen aus den Programmen der Jahre 1999 bis 2003 aus. Bisher wurden keine Optionen ausgeübt.

#### **QUALITÄTSWESEN**

Konsequente Umsetzung  
der Null-Fehler-Strategie

Im Rahmen von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen setzt ELMOS konsequent seine Null-Fehler-Strategie um und erzielt damit ein hervorragendes automobilgerechtes Qualitätsniveau. Regelmäßige Prüfungen der eingesetzten Werkzeuge, die

- Geschäft und Rahmenbedingungen
- Zukunft der Automobilelektronik
- Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
- Nachtragsbericht
- Risikobericht
- Prognosebericht

Betreuung der Serienprodukte von der Entwicklung bis zur Fertigung, ständige Analysen und statistische Verfahren ermöglichen das hohe Qualitätsniveau. Interne Labore prüfen nicht nur mögliche Fehlermechanismen der Halbleiterfertigung, sondern auch sensor- und gehäusespezifische Merkmale.

ELMOS betreibt seit Mitte der Neunziger Jahre ein Qualitätsmanagementsystem, das alljährlich gemäß den Anforderungen der DIN ISO 9001 und der Normen QS 9000 und VDA 6.1 auditiert wird. Diese Normen wurden inzwischen in der ISO/TS 16949: 2002, die weltweite Gültigkeit hat, zusammengefasst. ELMOS Dortmund, ELMOS North America, ELMOS France und GED wurden in 2004 gemäß der neuen Norm auditiert und zertifiziert.

Wie bereits im letzten Geschäftsbericht erwähnt, hat ELMOS im Februar 2004 für die exzellente Produktqualität den begehrten „Delphi Electronic Europe Supplier of the Year 2003“ Preis gewonnen.

#### UMWELT- UND ARBEITSSCHUTZ

Arbeitssicherheit und Umweltschutz sind neben der Qualität der Produkte und der Wirtschaftlichkeit als gleichrangige Unternehmensziele festgelegt. Zu den Grundsätzen der Umweltpolitik bei ELMOS zählen Rechtskonformität, Minimierung von Umweltbelastungen, Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiter, Umweltschutz-Management, kontinuierliche Verbesserung und Kommunikation.



Das Umweltmanagement gemäß DIN EN ISO 14001 wurde am Standort Dortmund erstmals im Jahr 2003 (durch den TÜV Rheinland) zertifiziert. 2004 erfolgte die Bestätigung anhand eines Überwachungsaudits ohne Abweichungen.

Die Bereiche Arbeits- und Umweltschutz sind direkt dem Vorstand unterstellt. Die ISO 14001 verankert den Umweltschutz systematisch und dauerhaft im Management. ELMOS legt beim Umweltmanagement besonderen Wert auf eine effektive Prävention sowie eine effiziente Ausnutzung von Ressourcen.

ELMOS hat in 2004 den Umweltbericht für das Geschäftsjahr 2003 vorgelegt. Er informiert ausführlich über die umweltrelevanten Tätigkeiten, die davon ausgehenden Umweltauswirkungen sowie über die Organisation der Arbeitssicherheit. Beispielsweise konnte der produktbezogene Wasserverbrauch um mehr als 15 Prozent gegenüber 2002 gesenkt werden. Auch der relative Strom- und Erdgasverbrauch wurde 2003 im Vergleich zum Vorjahr reduziert.

## ► Zukunft der Automobilelektronik

Seit vielen Jahren zeichnet sich der Markt für automobile Halbleiter durch ein stabiles Wachstum und positive Zukunftsaussichten aus. Denn die Durchdringung mit Elektronik hat in Europa ein sehr hohes Niveau bei allen Fahrzeugherstellern erreicht und macht international rasante Fortschritte. Doch werden zunehmend kritische Stimmen laut, die die Probleme mit dem vermeintlichen Zuviel an Elektronik im Auto beklagen. Als Indiz dafür ziehen sie häufig die Zahl der Rückrufaktionen heran, die in 2004 einen traurigen Höhepunkt erreichten. Wird dies zu einem Abflachen der Wachstumskurve und damit eventuell zu einem Problem bei ELMOS führen?

Anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums hat ELMOS zu einem Workshop eingeladen, bei dem Experten der Firmen Audi, BMW, ContiTeves, Hella, Kostal, Siemens VDO, Volkswagen und ZF-Lenkssysteme über die Zukunft der automobilen Halbleiter- und Sensortechnologie aus verschiedenen Perspektiven referiert haben. Insgesamt entstand aus den einzelnen Mosaiksteinen ein Gesamtbild, dass das Auto von morgen zeigt – und die Herausforderungen und Chancen für ELMOS.

### Programm des 20-jährigen Firmenjubiläums



**KUNDENORIENTIERUNG | LIENTIER | QUALITÄT | ZUKUNFT | WACHSTUM | VORSPRUNG | INNOVATION**

<b>WORKSHOP</b> Im Fahrzeugforum 16. September 2004 14:00 - 17:30 Uhr WDO ELMOS Seminare AG Hirschstr. 10 40227 Düsseldorf	<b>9:00 - 9:30 Uhr</b> Herr Dr. Thomas LUDWIG ERMAG/ELMOS <b>9:30 - 10:15 Uhr</b> Herr Dr. Hermann JIP Hella und Ford der Halbleiter im Automobil <b>10:15 - 10:30 Uhr</b> Pause <b>10:30 - 11:15 Uhr</b> Herr Hans-Joachim Fahrzeugkomponenten von Hella - der zweitgrößte Hersteller <b>11:15 - 11:30 Uhr</b> Herr Dr. Hans-Joachim Wie wir in Deutschland unsere Versorgung der Automobilindustrie haben können. Und wie wir sie... <b>11:30 - 12:30 Uhr</b> Herr Dr. Gerd-Georg Konten- und Sicherheitselektronik bei Bosch/Motors <b>12:30 - 13:30 Uhr</b> Lunch	<b>13:30 - 14:15 Uhr</b> Herr Dr. Gerd-Georg Sensortechnik von VDO/Continental Lars About S. <b>14:15 - 14:30 Uhr</b> Herr Dr. Ralf Systemintegration als Produktentwicklung/Produktionsentwicklung <b>14:30 - 15:30 Uhr</b> Herr Dr. Ralf JIRA - Ein gemeinsames Mittel zur Optimierung der Fertigungsicherheit <b>15:30 - 15:50 Uhr</b> Pause <b>15:50 - 16:30 Uhr</b> Herr Dr. Ralf Die Rolle der Sensortechnik, Technologie und Anwendungen <b>16:30 - 17:15 Uhr</b> Herr Dr. Ralf Arbeit und Fahrwerk im neuesten Fahrzeug <b>17:15 Uhr</b> Abschied	<b>AGENDAVORANSTALTUNG</b> WACHSEN 16. September 2004 10:00 Uhr WDO Deutsche Arbeiterkassenjugend (DAKJ) Friedrich-Hörstel-Platz 1, 23 40109 Düsseldorf	<b>ELMOS WIRD 20</b> 20 Jahre. Ein besonderes Jubiläum. Ein Jubiläum, an dem wir uns erinnern und danken. Ein Jubiläum, an dem wir uns freuen. Ein Jubiläum, an dem wir uns verbinden. 16. September 2004 10:00 Uhr WDO Hirschstr. 10 40227 Düsseldorf	<b>50 Jahre an</b> Die Visionen mit Spiritus, Innovation, Kompetenz und Engagement sind heute ein Teil unseres Erfolgs. Ein Teil unseres Erfolgs, der uns über 50 Jahre hinweg begleitet hat. 16. September 2004 10:00 Uhr WDO Hirschstr. 10 40227 Düsseldorf
---	---	--	---	--	---

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Elektronik als die innovationstreibende Technologie im Automobilbau erwiesen. So konnten die vom Gesetzgeber geforderten immer strengeren Emissionswerte oder die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs nur mit Hilfe der Elektronik erreicht werden und die zahllosen Verbesserungen in Bezug auf Komfort und Sicherheit wurden erst durch elektronische Systeme möglich gemacht. Hersteller – wie zum Beispiel BMW –, die diesen Trend frühzeitig erkannten und die Elektronik gezielt als differenzierendes Merkmal einsetzten, haben sich überdurchschnittlich entwickelt.

Die von diesen Vorreitern gesetzten Trends haben inzwischen die gesamte Branche erfasst und sich vielfach als Standard durchgesetzt. Angesichts der Fülle von elektronischen Komponenten und Systemen in modernen Autos und der auch öfter damit verbundenen Probleme stellt sich daher die Frage, ob nicht schon eine Marktsättigung eingetreten ist und die Elektronik eventuell sogar wieder auf dem Rückzug ist. Dies kann mit hoher Sicherheit verneint werden, da gerade in den letzten fünf Jahren die kombinierten Lösungen – bei denen Mechanik und Elektrik/Elektronik zusammenarbeiten – den früheren rein mechanischen Lösungen den Rang abgelaufen haben. Solche kombinierten Systeme sind die überlegenen und vor allem die billigeren Lösungen, die daher allein aus Kostengründen nicht mehr wegzudenken sind. Selbst die geplanten „Billig-Autos“ werden deshalb über ein Mindestmaß an Elektronik für Motorsteuerung und Sicherheitssysteme verfügen. Allerdings gilt es, Ansätze zu finden, wie mit den gestiegenen Anforderungen an Entwicklung, Produktion und Wartung umgegangen werden kann, wenn zunehmend vertraute mechanische Lösungen gegen immer mehr elektronische Steuergeräte eingetauscht werden.

Die Ausführungen der Experten im Laufe des ELMOS-Workshops haben sich vor allem mit drei Schwerpunkten beschäftigt.

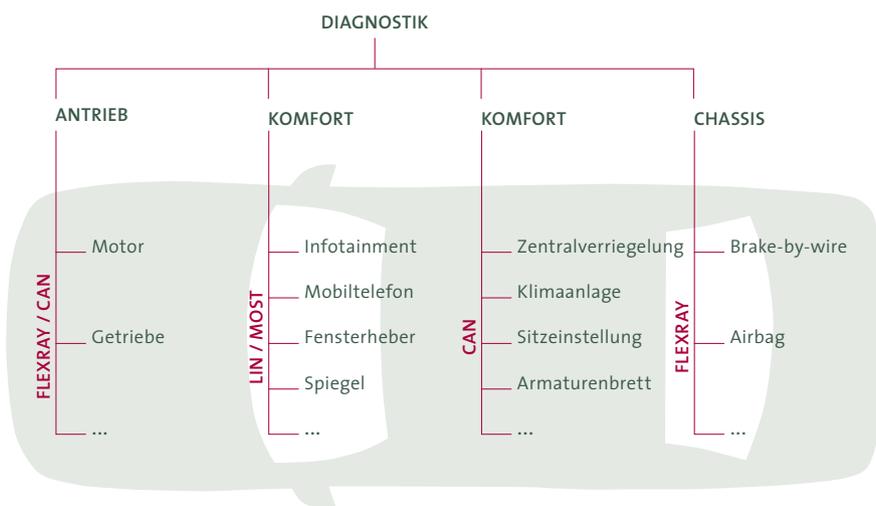
#### VERNETZUNG UND STANDARDISIERUNG

Immer mehr Funktionen fordern immer mehr Verbindungen zwischen Sensoren, Steuergeräten und Aktuatoren im Auto. Systeme für Komfort, Sicherheit und Informationstechnik werden mit angepassten, sogenannten BUS-Systemen vernetzt und effizienter gemacht. Diese Vernetzung im Automobil hat seit Mitte der Neunziger Jahre deutlich an Bedeutung gewonnen und hält nun bei US-Fahrzeugen Einzug. In Europa werden die Vorzüge der Multiplex-Kabelbäume mit deutlich geringerem Gewicht in fast allen Autos genutzt.

Ein Beispiel: Im neuen Golf V von Volkswagen sind mehr als 40 elektronische Steuergeräte eingebaut. Das sind fast genauso viele wie in den Oberklassefahrzeugen Phaeton und Touareg. Zum Vergleich: Das Vorgängermodell Golf IV hatte nur 16 Steuergeräte. Damit hat auch Volkswagen an die bei Premiumherstellern übliche hohe Ausstattung mit Elektronik angeschlossen. Nun gilt es für alle Hersteller, diese Komplexität des Gesamtsystems sicher zu beherrschen. Deshalb setzen sich mehr und mehr Bemühungen um Standardisierung durch. Auf der Software-Seite ist hier die Initiative AUTOSAR zu nennen, die eine Art „open-systems-interface“ definiert und damit die Zusammenarbeit und die Austauschbarkeit von Systemkomponenten sicherstellen soll. Auf der Hardware-Seite setzen sich die etablierten BUS-Systeme als

branchenweit akzeptierte Standards durch. Es sind dies im Karosseriebereich LIN, für mittlere Anforderungen CAN und im sicherheitskritischen Hochgeschwindigkeitsbereich FLEXRAY. Daneben dominiert für die Vernetzung von Infotainment-Komponenten das MOST-Protokoll.

Elektronik-Architektur im modernen Auto



ELMOS lieferte bis heute mehr als 70 Millionen BUS-Interface-ICs

ELMOS ist seit Einführung von BUS-Systemen bei BMW im Jahre 1995 Serienlieferant und hat bis heute mehr als 70 Millionen BUS-Interface-ICs geliefert. Kein anderer ASIC-Hersteller kann auf eine vergleichbare Lieferhistorie zurückblicken.

FAHRERASSISTENZSYSTEME

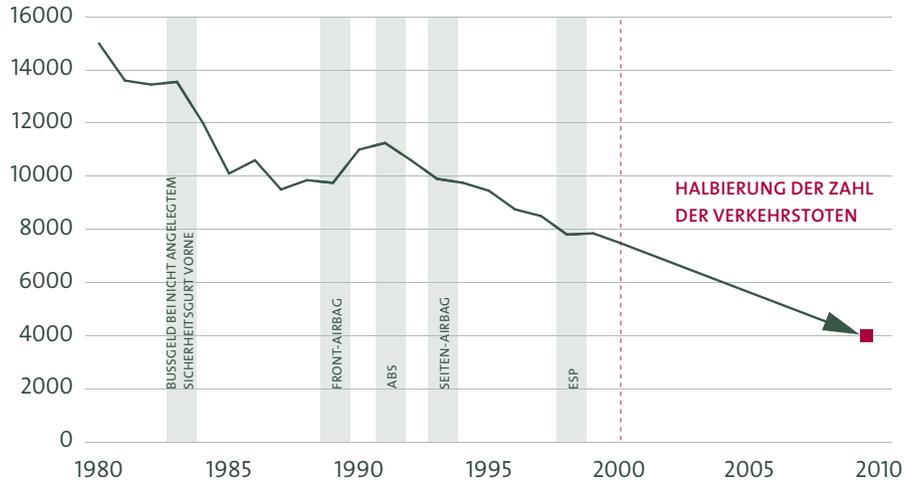
Die Fahrerassistenzsysteme werden künftig ein großes Wachstumsfeld darstellen. Sie sind die nächste Stufe auf dem Weg, das Fahren noch sicherer und einfacher zu machen. Dabei soll die Elektronik die menschlichen Schwächen, wie zu langsame Reaktionszeiten oder Ermüdung, kompensieren und damit dem Menschen das Fahren erleichtern. So kann er sich auf das konzentrieren, was wichtig ist, den stetig zunehmenden Verkehr.

Airbags sind eine der wichtigsten Applikationen für ELMOS

Für ELMOS ist der Airbag eine der wichtigsten Applikationen. Dank des Einsatzes von Sicherheitsgurt und Airbag-Systemen konnte in Europa die Zahl der Verkehrstoten und –verletzten in den vergangenen 20 Jahren trotz enorm gestiegener Verkehrsdichte halbiert werden. Diese Zahl bis zum Jahr 2010 noch einmal zu halbieren, ist das von der Europäischen Union vorgegebene Ziel an die Automobilhersteller.

- Geschäft und Rahmenbedingungen
- Zukunft der Automobilelektronik
- Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage
- Nachtragsbericht
- Risikobericht
- Prognosebericht

### Verkehrsunfälle in Deutschland und Zielsetzung der Europäischen Kommission

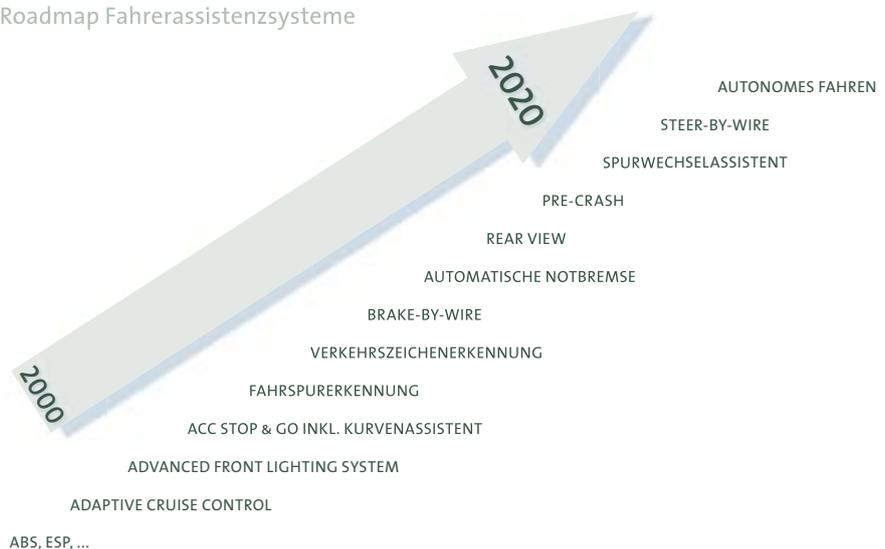


Quelle: Volkswagen | IRTAD

### Neue Systeme integrieren aktive und passive Sicherheit

So tritt jetzt neben den Schutz der Fahrzeuginsassen der Schutz der übrigen Verkehrsteilnehmer – insbesondere der Fußgänger. Besonders aber gilt es, die Entstehung von Unfällen frühzeitig zu erkennen und möglichst zu vermeiden. Dies gelingt mit Hilfe von nach innen und außen gerichteten Sensoren, die das Wohlbefinden und die Reaktionsfähigkeit des Fahrers erkennen, die Sicht bei Nacht und Nebel verbessern, den Abstand zum Fahrbahnrand und anderen Verkehrsteilnehmern bestimmen und gegebenenfalls warnen. Hierzu gehören neuartige Kameras und Radarsensoren, „intelligente“ Lichtanlagen, die geschwindigkeitsabhängig Kurven ausleuchten oder sogar GPS-gesteuert den Straßenverlauf kennen. Die LED-Technologie eröffnet gerade für die Fahrzeugbeleuchtung enorme Verbesserungspotenziale, von denen die bremskraftabhängige Bremsleuchtenhelligkeit nur ein Beispiel ist.

### Roadmap Fahrerassistenzsysteme

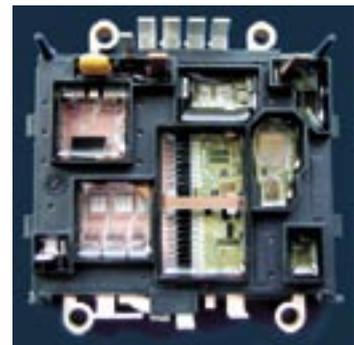


In diese Kategorie gehört auch das Fahrspurerkennungssystem im C4 und C5 von Citroën, das seit Ende 2004 ausgiebig von Citroën in den Medien beworben wird: In dem TV-Werbespot steuert der Fahrer das Auto blind über eine schmale Brücke. Möglich wird dies durch ein optisches Spurerkennungssystem, das auf der ELMOS-HALIOS®-Technologie basiert und aus sechs Sensoren in der vorderen Stoßstange besteht. Es erkennt die Fahrbahnmarkierungen sogar bei geschlossener Schneedecke.

#### MECHANIK KOMBINIERT MIT ELEKTRONIK

Ein weiterer großer Baustein für das Auto von morgen ist die zunehmende Kombination mit und der Ersatz von Mechanik durch Elektronik. Die Kombination dieser Elemente erlaubt vollkommen neue Möglichkeiten für die Senkung des Kraftstoffverbrauchs und die Erhöhung der Sicherheit. Elektrische Systeme können bedarfs-gesteuert an- und abgeschaltet werden und damit Kraftstoff sparen. Dies begann vor Jahren mit dem elektrisch angetriebenen Kühlventilator. Diesem folgte die elektrohydraulische oder voll elektrische Lenkhilfe, die dann Servo-Unterstützung liefert, wenn sie beim Rangieren gebraucht wird und auf der Autobahn abgeschaltet werden kann. Im letzten Jahr wurde bei BMW erstmals eine elektrisch angetriebene Wasserpumpe in Serie eingesetzt. Auch hier waren ELMOS-ASICs die entscheidenden Bauelemente.

#### Elektrische Wasserpumpe/Wasserpumpen-Steuerelektronik in Hybridbauweise



Quelle: Kolbenschmidt Pierburg AG | AB Mikroelektronik GmbH

Intensiv gearbeitet wird an der elektrischen beziehungsweise elektrisch unterstützten Bremse, denn damit können entscheidende Millisekunden bei einer Notbremsung gewonnen und durch den verkürzten Bremsweg Leben gerettet werden. Zusammen mit den schon hoch entwickelten Komponenten zur Fahrstabilisierung (ESP oder DSC) entstehen in den Labors neuartige Systeme, die aktive und passive Sicherheit integrieren. Sensoren und Module von ELMOS spielen hierbei oftmals eine entscheidende Rolle.

Geschäft und Rahmenbedingungen

► Zukunft der Automobilelektronik

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Nachtragsbericht

Risikobericht

Prognosebericht

Elektronische Zündung und elektronische Kraftstoffeinspritzung haben enorme Verbesserungen in Bereichen der Abgasemissionen und des Verbrauchs bei gleichzeitiger Leistungssteigerung gebracht. Dies lässt erahnen, dass mit einem elektrischen Ventiltrieb, der die alte Nockenwelle ersetzt und zylinderindividuell arbeitet, nochmals ein deutlicher Schritt in Richtung umweltfreundlicheres Auto getan werden kann. Hier kann ELMOS mit der Verbindung von Chip und Sensor in einem kundenspezifischen Gehäuse innovative Lösungen für den motornahen Einsatz bieten.

Elektronik ist das  
Mittel der Wahl

#### FAZIT

An zahlreichen sehr konkreten Beispielen und Projekten aus den eigenen Unternehmen konnten die Experten aufzeigen, dass ein Ende des Elektronikwachstums im Automobil noch lange nicht in Sicht ist. Im Gegenteil, die Elektronik ist für die angestrebte Halbierung der Verkehrstoten in den nächsten Jahren das Mittel der Wahl, um die menschlichen Defizite durch innovative Assistenzsysteme auszugleichen. Die ebenfalls angestrebten Verbesserungen im Bereich der Emissionsreduzierung sind nur durch konsequente Weiterentwicklung der Elektronik möglich.

Der hohe Ausrüstungsstand der europäischen Fahrzeuge markiert dabei nur das Niveau, dem sich zunehmend die Fahrzeughersteller in anderen Kontinenten annähern. Es gilt daher zweifelsfrei: Der Elektronikanteil im Automobil wächst auch in Zukunft weiterhin. Der Anteil der Elektrik/Elektronik am Fahrzeugwert wird einen Wert von etwa 35 bis 40 Prozent im Jahr 2010 erreichen. ELMOS ist mit den spezialisierten ASICs für solche Anwendungen in fast allen Wachstumssegmenten herausragend positioniert.

## ► Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

### UMSATZENTWICKLUNG

#### Kennzahlen der ELMOS-Gruppe nach US-GAAP

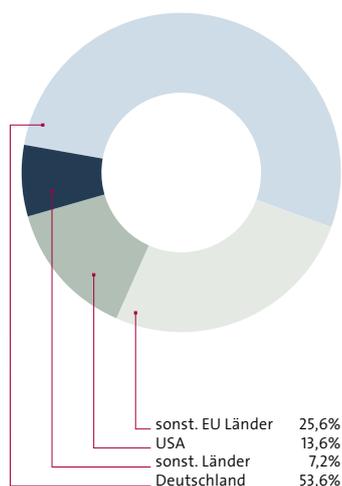
	2003	2004	Veränderung
Umsatz	121,4 Mio Euro	143,3 Mio Euro	18,1%
Auftragseingang / Umsatz (Book-to-bill)	1,12	0,97	
Bruttoergebnis	61,4 Mio Euro	73,6 Mio Euro	19,8%
in Prozent	50,6%	51,3%	
Aufwand für Forschung & Entwicklung	20,4 Mio Euro	24,4 Mio Euro	19,9%
in Prozent	16,8%	17,0%	
Betriebsergebnis	21,6 Mio Euro	29,6 Mio Euro	36,9%
in Prozent	17,8%	20,6%	
EBIT	21,1 Mio Euro	28,7 Mio Euro	36,2%
in Prozent	17,4%	20,0%	
Vorsteuerergebnis*	17,3 Mio Euro	25,3 Mio Euro	46,3%
in Prozent	14,2%	17,6%	
Konzernüberschuss	10,0 Mio Euro	16,3 Mio Euro	62,8%
in Prozent	8,3%	11,4%	
Ergebnis je Aktie (unverwässert)	0,52 Euro	0,85 Euro	62,8%
Dividende je Aktie	0,13 Euro	0,21 Euro**	

\* Ergebnis vor Ertragssteuern, Nettoanteil am Verlust der nicht konsolidierten Tochtergesellschaften und Minderheitsanteilen  
 \*\* Vorschlag für die Hauptversammlung im April 2005

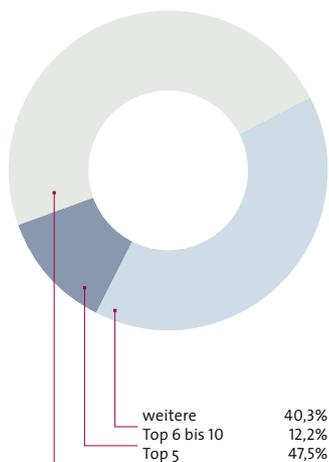
Umsatz um 18 Prozent  
gesteigert

Im Jahr 2004 konnte ELMOS wieder zu den Wachstumsraten der Vergangenheit zurückkehren. Der Umsatz stieg im Jahr 2004 im Vergleich zum Vorjahr um 21,9 Millionen Euro oder 18,1 Prozent auf 143,3 Millionen Euro. Dies ist die höchste Wachstumsrate des Umsatzes seit 2000 und das Resultat der gewonnenen Neuprojekte der vergangenen Jahre.

Umsatz nach Regionen 2004



Umsatz nach Kunden 2004



### Umsatz nach Regionen\*

Die regionale Verteilung der Umsatzerlöse im Gesamtkonzern zeigt einen Deutschland-Anteil von 53,6 Prozent in 2004 und liegt damit in etwa genauso hoch wie im Vorjahr (2003: 55,4 Prozent). Deutschland stellt damit nach wie vor die umsatzstärkste Region für die ELMOS-Gruppe dar. Der Anteil der Sonstigen EU-Länder am Konzernumsatz stieg in 2004 ebenfalls leicht auf 25,6 Prozent (2003: 24,2 Prozent). Der Anteil der Umsatzbeiträge aus den USA blieb trotz Dollarschwäche bei 13,6 Prozent fast konstant (2003: 14,8 Prozent).

### Umsatz nach Kunden

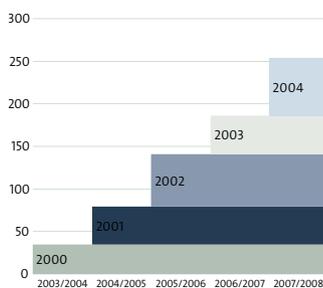
Insgesamt beliefert ELMOS eine Vielzahl von Kunden, in Summe mehr als Hundert. In der Regel handelt es sich hierbei um Automobilzulieferer. In 2004 hat das schwedische Unternehmen Autoliv die französische Firma Valeo als den größten Kunden abgelöst. Autoliv macht rund 15,0 Prozent des Umsatzes aus. Valeo ist mit rund 14,4 Prozent nun die Nummer zwei. Die fünf größten Kunden generieren insgesamt 47,5 Prozent des Umsatzes von ELMOS, die zehn größten 59,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Kundenstruktur nicht wesentlich verändert. Die Konzentration wird dadurch relativiert, dass die Kunden jeweils eine Vielzahl von Produkten von ELMOS beziehen. So liefern das Unternehmen beispielsweise an Autoliv mehr als 20 Produkte für Anwendungen hauptsächlich für Airbagsysteme und an Valeo mehr als 30 Produkte für Anwendungen in der Karosserie-Elektronik sowie für Lichtmaschinenregler. Diese Produkte werden in verschiedenen Fahrzeugmodellen eingesetzt, die unterschiedliche Produktionszeiträume haben und sich somit in der Umsatzgenerierung überlappen.

### Auftragseingang

Nach starken Auftragseingängen in der ersten Jahreshälfte kam es ab August 2004 zu einer deutlichen Abschwächung. Das Bestellverhalten der Kunden von ELMOS ist trotz geringer Korrelation mit dem Halbleitermarkt durch dessen Gesamtsituation gekennzeichnet. Der Marktzyklus mit Überhitzungserscheinungen im ersten Halbjahr und entsprechenden vorsorglichen Bestellungen führte zu einem vorsichtigeren Bestellverhalten in der zweiten Jahreshälfte. Auf Jahresbasis sank das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz im Halbleiterbereich auf einen Wert von 0,97 gegenüber dem Vorjahr mit dem Wert von 1,13.

\* Der Umsatz nach Regionen wird ermittelt durch die Rechnungsadresse der Kunden. Durch Verschiebungen in Unternehmensstrukturen kann es demnach zu unterschiedlich erfassten regionalen Umsatzerlösen kommen, die aber nicht notwendigerweise Aufschluss über eine strukturell veränderte Kundenbasis geben.

Erwarteter Umsatz aus Neuprojekten  
2000-2004 in Millionen Euro



Annahme: Fünf Jahre Produktlebenszeit

Gestiegener Umsatz  
und höhere  
Produktionsauslastung

F&E-Aufwendungen sollen  
proportional zum Umsatz  
steigen

### Neuprojekte (Design Wins)

Die Basis für das langfristige Wachstum der ELMOS-Gruppe wird vor allem durch die Akquisition von Neuprojekten bestimmt. Das nachhaltige Interesse der Kunden an individuellen Lösungen zeigt sich in der hohen Anzahl neu gewonnener Entwicklungsprojekte. So konnten im abgelaufenen Jahr 29 Entwicklungsprojekte (2003: 31 Projekte), auch Design Wins genannt, mit einem geplanten Umsatzvolumen über den Lebenszyklus von rund 340 Millionen Euro (2003: 227 Millionen Euro) akquiriert werden.

Die Mehrzahl dieser Projekte, nämlich 22, sind kundenspezifische Aufträge (ASICs) und werden erst in etwa drei Jahren – nach Produktentwicklung, Qualifikation und Freigabe durch den Kunden – umsatzwirksam. Die restlichen sieben Projekte sind anwendungsspezifische Standardprodukte (ASSPs). Die von ELMOS vermarkteten ASSPs sind in der Regel Derivate oder Verallgemeinerungen von ASICs, die sich stets durch innovative Eigenschaften und geschützte IPs (Geistiges Eigentum) auszeichnen.

### ERTRAGSLAGE

#### Bruttoergebnis

Nach Abzug der Herstellungskosten vom Umsatz erzielte die ELMOS-Gruppe ein Bruttoergebnis von 73,6 Millionen Euro. Der Anstieg lässt sich insbesondere auf den gestiegenen Umsatz sowie die höhere Auslastung in der Produktion zurückführen. Der im Verhältnis zum Umsatz unterproportionale Anstieg der Herstellungskosten führte zu einer gesteigerten Bruttomarge von 51,3 Prozent in 2004 (2003: 50,6 Prozent). Damit hat ELMOS die Zielmarke von 50 Prozent deutlich überschritten. Dank höherer Produktionsauslastung konnte dieses Resultat trotz der Vielzahl an Neuproduktanläufen (21 Produkthanläufe in 2004), die typischerweise in der Anfangsphase geringere Ausbeuten und damit niedrigere Margen erzielen, erreicht werden.

#### Betriebsergebnis

Aufgrund des in Summe unterproportionalen Anstiegs der Aufwendungen konnte das Betriebsergebnis 2004 auf 29,6 Millionen Euro gesteigert werden. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 8,0 Millionen Euro. Die Relation von Betriebsergebnis zu Umsatz betrug 20,6 Prozent im Vergleich zu 17,8 Prozent im Vorjahr.

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen leicht überproportional zum Umsatz auf 24,4 Millionen Euro. Sie machten damit im vergangenen Jahr 17,0 Prozent des Umsatzes im Vergleich zu 16,8 Prozent in 2003 aus. In die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung fließen vor allem die Entwicklung neuer Produkte und Prozesse ein. Da diese den Grundstein für die Zukunft des Unternehmens legen, ist es Ziel von ELMOS, dass Aufwendungen für Forschung und Entwicklung

sich auch in Zukunft in etwa proportional zum Umsatz entwickeln. In Relation zu den zahlreichen Neuprojekten ist bei den Aufwendungen für Forschung und Entwicklung jedoch nur ein moderater Kostenanstieg zu verzeichnen.

Marketing- und Vertriebskosten stiegen auf 7,0 Millionen Euro und machten damit 4,9 Prozent vom Umsatz (2003: 5,5 Prozent) aus. Die Allgemeinen Verwaltungskosten sanken um 1,5 Prozent auf 12,6 Millionen Euro in 2004. Sie machten damit nur noch 8,8 Prozent des Umsatzes im Vergleich zu 10,6 Prozent im Vorjahr aus. Die Reduzierung ist ein Resultat der in 2003 durchgeführten Restrukturierungen.

#### EBIT

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg gegenüber dem Vorjahr um 36,2 Prozent auf 28,7 Millionen Euro. Das im Vergleich zum Betriebsergebnis geringer gestiegene EBIT ist begründet durch die Sonstigen Aufwendungen. Zuweisungen zu Wertberichtigungen von Wertpapieren des Umlaufvermögens, bereinigt um entgegenlaufende Steuereffekte, Betriebsprüfungsauswirkungen sowie die Auflösung von Wertberichtigungen und öffentliche Zuschüsse zu Förderungs- und Entwicklungsaufwendungen haben zu einem summierten Aufwand von 0,8 Millionen Euro (Vorjahr: 0,4 Millionen Euro) geführt.

Ergebnis vor Zinsen und  
 Steuern kletterte um  
 36 Prozent

#### Ergebnis vor Ertragssteuern, Nettoanteil am Verlust der nicht konsolidierten Tochtergesellschaften und Minderheitsanteile (Vorsteuerergebnis)

Im Geschäftsjahr 2004 betragen die Zinsbelastungen 3,4 Millionen Euro und unterschritten damit um 9,7 Prozent die Vorjahreszinsaufwendungen. Dies lag vor allem an den gegenüber den kreditgebenden Banken durchgesetzten Verbesserungen der Zinskonditionen sowie zu einem geringeren Anteil an niedrigen Bankverbindlichkeiten. Das Vorsteuerergebnis erreichte einen Wert von 25,3 Millionen Euro und übertraf damit den Vorjahreswert um 46,3 Prozent.

Konzernüberschuss stieg  
 um 62,8 Prozent

#### Konzernüberschuss und Ergebnis pro Aktie

Die Steuerquote konnte im Geschäftsjahr 2004 auf 34,4 Prozent reduziert werden. Der Konzernüberschuss 2004 stieg überproportional um 62,8 Prozent auf 16,3 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie beträgt 0,85 Euro gegenüber 0,52 Euro in 2003.

#### Vorschlag zur Gewinnverwendung

Die ELMOS Semiconductor AG\* erzielte einen Jahresüberschuss von 14,4 Millionen Euro. Der Gewinnvortrag aus dem Jahr 2003 beträgt 26,1 Millionen Euro. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 26. April 2005 vor, eine Dividende von 0,21 Euro je Aktie auszuschütten. Diese Ausschüttung würde einer Dividendensumme von rund 4,1 Millionen Euro entsprechen.

\* Der Jahresabschluss der ELMOS Semiconductor AG ist mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers versehen. Er wird im Bundesanzeiger veröffentlicht, ist beim Handelsregister hinterlegt und kann als Sonderdruck angefordert werden.

## Umsatz- und Ertragslage in den Segmenten

### Kennzahlen der Segmente

Segment	2003	2004	Veränderung
<b>Umsatz in Mio Euro</b>	<b>121,4</b>	<b>143,3</b>	<b>18,1%</b>
Halbleiter	107,7	130,7	21,3%
Mikromechanik	9,3	9,1	- 2,7%
Assembly	4,4	3,5	- 18,5%
<b>Auftragseingang / Umsatz (Book-to-bill)</b>	<b>1,12</b>	<b>0,97</b>	
Halbleiter	1,13	0,97	
Mikromechanik	1,03	0,94	
Assembly	0,99	0,98	
<b>Bruttoergebnis in Mio Euro</b>	<b>61,4</b>	<b>73,6</b>	<b>19,8%</b>
Halbleiter	58,1	68,9	18,5%
Mikromechanik	3,1	3,7	16,2%
Assembly	0,2	1,0	n.a.
<b>Bruttomarge in Prozent</b>	<b>50,6%</b>	<b>51,3%</b>	
Halbleiter	53,9%	52,7%	
Mikromechanik	33,8%	40,4%	
Assembly	3,5%	29,3%	
<b>Betriebsergebnis in Mio Euro</b>	<b>21,6</b>	<b>29,6</b>	<b>36,9%</b>
Halbleiter	21,2	27,1	27,9%
Mikromechanik	0,3	0,8	n.a.
Assembly	0,1	1,7	n.a.

### Halbleiter

Das Halbleiter-Kerngeschäft des ELMOS-Konzerns wird über die verschiedenen Gesellschaften in Deutschland, Frankreich und den USA abgewickelt. Der Dritturnsatz des Segments Halbleiter konnte um 21,3 Prozent auf 130,7 Millionen Euro zulegen. Damit hat der Halbleiter-Bereich nach wie vor die größte Bedeutung für ELMOS und macht ähnlich wie im Vorjahr wieder rund 90 Prozent des Umsatzes der ELMOS-Gruppe aus. Dies ist insbesondere auf die zunehmende Anzahl an Produkten zurückzuführen. Die Bruttomarge des Halbleiterbereichs erreichte in 2004 mit 52,7 Prozent wiederum die höchste Marge der Segmente.

Geschäft und Rahmenbedingungen

Zukunft der Automobilelektronik

► Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Nachtragsbericht

Risikobericht

Prognosebericht

### Mikromechanik

Der Bereich Mikromechanik umfasst die Tätigkeiten der Tochtergesellschaft SMI. Der SMI-Umsatz wird ausschließlich in US-Dollar erzielt. Nach 10,9 Millionen US-Dollar Umsatz in 2003 steigerte SMI im Jahr 2004 den Umsatz auf 12,0 Millionen US-Dollar, blieb aber deutlich unter dem Planumsatz von 14 Millionen US-Dollar. Der Drittumsatz des Segments Mikromechanik verlor damit in Euro wechselkursbedingt 2,7 Prozent und machte rund sechs Prozent des Konzernumsatzes aus.

Trotz dieses nur geringen Umsatzwachstums konnte SMI die Ertragskraft verbessern. So steigerte sich das Nettoergebnis nach einem Verlust in 2003 auf einen positiven Wert in 2004, obwohl Preisreduktionen gegenüber dem Vorbesitzer MSI zu kompensieren waren. Diese Verbesserung ist im Wesentlichen der fortgeschrittenen Umstellung der Fertigung auf 150mm-Wafer zuzuschreiben. Gegen Jahresende 2004 wurden 70 Prozent der Produkte auf 150mm-Wafer gefertigt, am Jahresanfang waren es nur 10 Prozent.

Fertigungs- und technologiebedingte Verzögerungen beim Hochfahren neuer Produkte verursachten das schwächere Wachstum des Mikromechanik-Bereichs. Das Betriebsergebnis lag bei 0,8 Millionen Euro und entsprach somit einer Marge von 8,6 Prozent im Vergleich zu 3,1 Prozent in 2003.

### Assembly

Der Bereich Assembly umfasst die Tätigkeiten der ELMOS Advanced Packaging. Aufgrund von reduzierten Aktivitäten in der externen Vermarktung der Produkte ging der Außenumsatz in 2004 gegenüber 2003 zurück. So betrug der Drittumsatz in 2004 noch 3,5 Millionen Euro. ELMOS Advanced Packaging fertigte in 2004 rund 57 Prozent aller Gehäuse für ELMOS. Es ist geplant, die gruppeninternen Leistungen an ELMOS weiter zu steigern. Die Margen des Assembly-Segments haben sich in 2004 gegenüber dem Vorjahr aufgrund von internen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und auch wegen durchgesetzter Preiserhöhungen gegenüber den externen Kunden deutlich verbessert. Aufgrund des verhältnismäßig geringer gewordenen Außenumsatzes ist beabsichtigt, die Segmentberichterstattung für Assembly in 2005 einzustellen.

Segmentberichterstattung  
für Assembly  
wird in 2005 eingestellt

## FINANZLAGE

## Kennzahlen der ELMOS-Gruppe nach US-GAAP

in Millionen Euro, soweit nicht anders angegeben	2003	2004	Veränderung
Jahresüberschuss	10,0	16,3	+ 62,8%
Abschreibung	14,6	12,7	- 12,9%
Veränderung Nettoumlaufvermögen	- 5,3	- 1,1	- 78,8%
Übrige Posten	- 12,7	7,0	n.a.
<b>Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>6,5</b>	<b>34,9</b>	n.a.
Investitionen in das Anlagevermögen	- 25,3	- 33,5	+ 32,4%
in Prozent vom Umsatz	21%	23%	
Sonstige Posten	28,8	2,4	- 91,7%
<b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3,4</b>	<b>- 31,2</b>	n.a.
<b>Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 1,2</b>	<b>- 5,9</b>	n.a.
Veränderung der liquiden Mittel	8,8	- 2,2	n.a.
<b>Free Cash Flow (Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit minus Cash Flow aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>10,0</b>	<b>3,7</b>	<b>- 62,9%</b>

Operativer  
Cash Flow deutlich höher  
als im Vorjahr

**Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit**

Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit konnte im Vergleich zu 2003 mehr als verfünffacht werden. So lag dieser für das Gesamtjahr 2004 bei 34,9 Millionen Euro im Gegensatz zu 6,5 Millionen Euro in 2003. Gründe dafür sind zum einen der deutlich höhere Jahresüberschuss und die Verbesserungen im Management des Umlaufvermögens. Auch gab es im Jahr 2004 keine signifikanten Zahlungs-mittelabflüsse für Steuern zurückliegender Jahre, die in 2003 mehr als zehn Millionen Euro ausmachten.

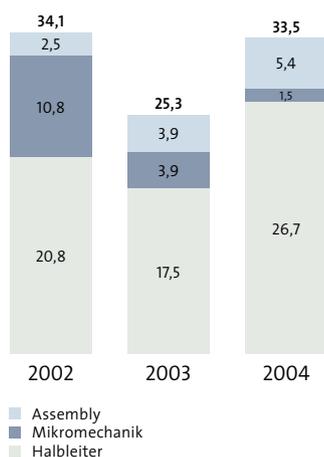
**Cash Flow aus Investitionstätigkeit**

Im zurückliegenden Geschäftsjahr hat ELMOS insgesamt 33,5 Millionen Euro für Investitionen in das Anlagevermögen eingesetzt. Gegenüber 2003 ist das eine Steigerung von 32,4 Prozent. Im Gegensatz zum Vorjahr wurden in 2004 keine Sale-and-Lease-back Transaktionen für technische Anlagen und Maschinen durchgeführt.

Von den Gesamtinvestitionen entfielen auf das Segment Halbleiter 26,7 Millionen Euro oder rund 80 Prozent. Der wesentliche Teil davon wurde für Maschinen und Geräte in der Produktion aufgewendet. Aufgrund hoher Produktionsauslastung und des starken Auftragseingangs im ersten Halbjahr wurden Erweiterungsinvestitionen in Frontend und Backend zum Teil vorgezogen.

Geschäft und Rahmenbedingungen  
 Zukunft der Automobilelektronik  
 ► Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage  
 Nachtragsbericht  
 Risikobericht  
 Prognosebericht

Investitionen nach Segmenten



Assembly  
 Mikromechanik  
 Halbleiter

Finanzierung der  
 Investitionen aus operativem  
 Cash Flow

Rund fünf Millionen Euro entfielen auf immaterielle Wirtschaftsgüter, wie Software für Schaltungsentwicklung und Simulation, Auftragsentwicklungen im Umfeld neuer Technologien sowie den erweiterten Einsatz von SAP-Software in der ELMOS-Gruppe. In Gebäudesubstanz und Außenanlagen wurde rund eine Million Euro investiert, für die Erneuerung von lufttechnischen Anlagen und zum Kapazitätsausbau der Standort-Infrastruktur (zum Beispiel deionisierte Wasserversorgung, Stickstoffherzeugung) wurden rund 1,4 Millionen Euro aufgewendet.

Die Investitionen im Mikromechanik-Bereich belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro und umfassen Maschinen und Ausrüstung für die weitere Umstellung der Fertigung von 100mm auf 150mm und für neue Technologien.

Der Assembly-Bereich hat rund 5,4 Millionen Euro in Maschinen zur Fertigung von Spezialgehäusen im Rahmen von ASIC<sup>plus</sup>-Projekten, in ein Nachbar-Grundstück, in Gebäude und Einbauten sowie in den weiteren Ausbau des 2003 erworbenen Gebäudes in Nijmegen investiert. Im benachbarten Gebäude werden ab 2005 die Produktionsschritte Verpackung und Logistik durchgeführt.

#### Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit

Trotz hoher Investitionstätigkeit in 2004 deckte der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit nicht nur die hierfür notwendigen Mittel, sondern es konnten neben der Zahlung der Dividende in Höhe von 2,5 Millionen Euro zusätzlich auch die langfristigen Verbindlichkeiten um 3,6 Millionen Euro zurückgeführt werden.

Die liquiden Mittel sanken im Berichtsjahr um rund 2,2 Millionen Euro auf 15,3 Millionen Euro. Der Anteil der liquiden Mittel am Gesamtvermögen beträgt 7,0 Prozent.

#### VERMÖGENSLAGE

##### Kennzahlen der ELMOS-Gruppe nach US-GAAP

in Millionen Euro, soweit nicht anders angegeben	31. Dez. 2003	31. Dez. 2004	Veränderung
Liquide Mittel	17,4	15,3	-12,3%
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26,6	27,8	4,6%
Vorräte	22,1	25,1	13,6%
Sonstiges Umlaufvermögen	17,2	9,4	-45,1%
<b>Umlaufvermögen, gesamt</b>	<b>83,3</b>	<b>77,6</b>	<b>-6,8%</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	28,9	34,2	18,3%
Anlagevermögen	80,1	94,1	17,6%
Sonstige Aktiva	13,1	13,8	6,0%
<b>Aktiva, gesamt</b>	<b>205,3</b>	<b>219,8</b>	<b>7,0%</b>

## Kennzahlen der ELMOS-Gruppe nach US-GAAP

in Millionen Euro, soweit nicht anders angegeben	31. Dez. 2003	31. Dez. 2004	Veränderung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7,9	11,0	38,9%
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17,6	17,8	0,6%
Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten	4,0	3,7	- 6,7%
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	9,9	12,7	28,6%
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten, gesamt</b>	<b>39,5</b>	<b>45,2</b>	<b>14,6%</b>
Langfristige Verbindlichkeiten	38,9	36,1	- 7,1%
Sonstige Verbindlichkeiten	2,3	2,2	- 2,9%
Eigenkapital	124,7	136,2	9,3%
<b>Passiva, gesamt</b>	<b>205,3</b>	<b>219,8</b>	<b>7,0%</b>

Das Gesamtvermögen der ELMOS-Gruppe stieg von 205,3 Millionen Euro im Jahr 2003 um 7,0 Prozent auf 219,8 Millionen Euro. Hauptgrund für diesen Anstieg war die Zunahme des Anlagevermögens und dabei insbesondere von technischen Anlagen und Maschinen. Die Aufteilung des Gesamtvermögens nach Segmenten zeigt, dass der Halbleiterbereich sowohl absolut als auch prozentual für den höchsten Anstieg verantwortlich war.

## Kennzahlen der Segmente

in Millionen Euro, soweit nicht anders angegeben	Segment	31. Dez. 2003	31. Dez. 2004	Veränderung
<b>Gesamtvermögen</b>				
	Halbleiter	148,7	160,5	8,0%
	Mikromechanik	24,0	24,5	2,0%
	Assembly	32,6	34,8	6,6%
		<b>2003</b>	<b>2004</b>	
<b>Abschreibungen</b>				
	Halbleiter	11,3	10,0	- 11,8%
	Mikromechanik	0,8	0,7	- 18,6%
	Assembly	2,4	2,0	- 16,2%

**Nettoumlaufvermögen**

Die Vorräte stiegen von 22,1 Millionen Euro zu Beginn des Berichtsjahres auf 25,1 Millionen Euro am 31. Dezember 2004. Der Anteil am Gesamtvermögen blieb konstant bei rund elf Prozent. Die Umschlagshäufigkeit der Vorräte wurde auf 2,8 mal in 2004 gesteigert.

### Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen effizienter gemanagt

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nahmen ebenfalls leicht zu, von 26,6 Millionen Euro auf 27,8 Millionen Euro. Das Forderungsmanagement konnte im Berichtsjahr deutlich verbessert werden, die Forderungen standen im Durchschnitt nur noch rund 71 Tage (Vorjahr: 80 Tage) aus.

Auch die Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten wurden im Berichtsjahr 2004 effizienter gemanagt. So wurden die Rechnungen im Durchschnitt zehn Tage später bezahlt als im Vorjahr. Ein Teil des Anstiegs ist auf Verbindlichkeiten aufgrund von in 2004 getätigten, aber noch nicht gezahlten Investitionen zurückzuführen. Dies lässt die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auf den ersten Blick ungewöhnlich hoch erscheinen. Insgesamt wurden die durch das Nettoumlaufvermögen gebundenen liquiden Mittel von 166 Tagen in 2003 auf 145 Tage reduziert.

### Passiva

Die zinstragenden Verbindlichkeiten wurden in Summe von 60,6 Millionen Euro auf 57,6 Millionen Euro per Jahresende 2004 zurückgeführt. Trotz Rückführung der Bankverbindlichkeiten stieg die Nettoverschuldung leicht von 34,7 Millionen Euro auf 38,7 Millionen Euro. Dies ist im Wesentlichen auf den Rückgang der Wertpapiere des Umlaufvermögens auf 3,6 Millionen Euro zurückzuführen.

### Kennzahlen der ELMOS-Gruppe

	Berechnung	Einheit	2003	2004
<b>Nettoumlaufvermögen</b>	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen + Vorräte – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	Millionen Euro	40,8	41,9
vom Umsatz		Prozent	33,6%	29,2%
<b>Umschlagshäufigkeit der Vorräte</b>	Herstellungskosten / Vorräte	x	2,7x	2,8x
<b>Umschlagshäufigkeit der Forderungen</b>	Umsatz / Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	x	4,6x	5,2x
<b>Umschlagshäufigkeit der Verbindlichkeiten</b>	Herstellungskosten / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	x	7,6x	6,3x
<b>Cash Cycle</b>	Inventartage + Forderungstage – Verbindlichkeitentage	Tage	166	145
<b>Nettoverschuldung</b>	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten + Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten + langfristige Verbindlichkeiten – Liquide Mittel – Wertpapiere des Umlaufvermögens	Millionen Euro	34,7	38,7
<b>Gearing</b>	Nettoverschuldung / Eigenkapital	Prozent	27,8%	28,4%
<b>Eigenkapitalquote</b>	Eigenkapital / Gesamtvermögen	Prozent	60,7%	62,0%

Das Eigenkapital der ELMOS-Gruppe stieg von 124,7 Millionen Euro auf 136,2 Millionen Euro. Aufgrund dieser im Vergleich zum Wachstum des Gesamtvermögens überproportionalen Steigerung von 9,3 Prozent wuchs die Eigenkapitalquote von 60,7 Prozent am Jahresende 2003 auf 62,0 Prozent am 31. Dezember 2004.

## ► Nachtragsbericht

---

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten.

### UMSTELLUNG AUF IFRS

Als kapitalmarktorientiertes Unternehmen ist die ELMOS Semiconductor AG gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 verpflichtet, ihren Konzernabschluss auf IFRS umzustellen. ELMOS wird diese Umstellung vollständig zum 31. Dezember 2005 vornehmen.

Das bedeutet, dass der im Frühjahr 2006 zu veröffentlichende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005 erstmalig die Bilanzierung nach IFRS zeigen wird. Dieser Abschluss wird entsprechend den Vergleichszeitraum zum 31. Dezember 2004 aufführen. Durch den nach IFRS herangezogenen Vergleichszeitraum zum 31. Dezember 2004 wird den Kapitalmarktteilnehmern ein Vergleich zwischen IFRS und US-GAAP ermöglicht. Alle Konzernzwischenabschlüsse und Konzernabschlüsse nach dem 31. Dezember 2005 werden ausschließlich nach IFRS aufgestellt.

## ▶ Risikobericht

### RISIKOMANAGEMENTSYSTEM

Die ELMOS Semiconductor AG hat im Berichtsjahr das in 2002 eingerichtete umfassende Risikomanagementsystem, das die Anforderungen des § 91 (2) AktG erfüllt, Zug um Zug auf die Unternehmen im Konzern angewendet und weiter verfeinert. Das Risikomanagementsystem von ELMOS und seine Anwendung wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Jahresende kritisch auf Konformität mit den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und des Aktiengesetzes geprüft und für geeignet befunden. Es sieht die regelmäßige Erfassung und Bewertung von neuen und bekannten Risiken durch die verantwortlichen Mitarbeiter vor und legt ein geschlossenes Reporting-System fest. Die Unternehmensbereiche der ELMOS-Gruppe berichten auf monatlicher Basis über die finanzielle und operative Entwicklung. Im Jahr 2004 wurde das Risikomanagementreporting auf eine intranetbasierte Eingabe umgestellt. Damit ist eine einfachere und zuverlässige Erhebung der Daten und Verteilung der Information möglich. Durch diese Maßnahmen werden Vorstand und Aufsichtsrat regelmäßig und frühzeitig über die Risikolage informiert und können geeignete Maßnahmen zur Risikominderung beziehungsweise -vermeidung oder -abwehr beschließen. Das Risikomanagementsystem wird auch 2005 kontinuierlich erweitert und entsprechend sich ändernder Rahmenbedingungen verbessert werden.

Es ist die Strategie von ELMOS, Zins- und Währungsrisiken durch geeignete Instrumente, wie entsprechende Derivatprodukte, abzusichern. ELMOS geht dabei von Zeit zu Zeit Devisentermingeschäften zur Absicherung von Transaktionen in Fremdwährungen ein, die auf den Zeitraum beschränkt sind, in dem das Risiko besteht. Diese Kurssicherungsgeschäfte minimieren die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Ertragslage. ELMOS beteiligt sich nicht an Spekulationsgeschäften.

### ABHÄNGIGKEIT VON DER AUTOMOBILINDUSTRIE

Das Kerngeschäft von ELMOS steht in direktem Zusammenhang mit der Nachfrage der Automobilindustrie nach ASICs. Rund 90 Prozent des Umsatzes wird mit ASICs für die Automobilelektronik erwirtschaftet. Diese Nachfrage ist einerseits abhängig von den produzierten Stückzahlen an Fahrzeugen und wird andererseits von dem anhaltenden Trend zu mehr Elektronik im Auto gesteuert. Durch die Zunahme an elektronischer Ausrüstung im Auto steigen die Stückzahlen an verkauften ASICs auch dann, wenn die Zahl der produzierten PKWs stagniert oder abnimmt.

Dabei ist zu beobachten, dass die Automobilindustrie häufig in absatzschwächeren Zeiten die Fahrzeuge mit höherwertiger Ausrüstung zum Komplettpreis anbietet, so dass auch bei stagnierender oder zurückgehender Automobilproduktion die Zahl der

Nachfrage nach ASICs  
 ist relativ robust

verkauften ASICs nicht notwendigerweise sinkt. Die Nachfrage nach ASICs ist damit relativ robust und ist nur bedingt von den Schwankungen der Kfz-Stückzahlen abhängig.

Der Automobilmarkt unterlag in der Vergangenheit als Folge von Zusammenschlüssen von Herstellern, restriktiver Umweltgesetzgebung und anderen Faktoren, beachtlichen Schwankungen. Die ELMOS-Kundenstruktur lässt sicherlich eine gewisse Abhängigkeit von einigen großen Automobilzulieferern erkennen. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der von einem Kunden generierte Umsatz in der Regel nicht durch ein Produkt entsteht, das heißt auch überlappende Lebenszyklen damit verbunden sind. Aufgrund der Bedeutung und der Spezialisierung der ASICs von ELMOS für das Produkt des Automobilzulieferers handelt es sich bei der Beziehung zum Kunden um eine gegenseitige Abhängigkeit. Daher können größere Umsatzvolumina mit einigen Großkunden auf vielversprechende langfristige Kundenbeziehungen mit entsprechenden Umsatzpotenzialen hindeuten. Es kommt nur sehr selten vor, dass ein und derselbe ASIC an zwei Lieferanten gleichzeitig vergeben wird, da die Automobilzulieferer selbst unter erheblichem Kostendruck stehen und die gleichzeitige Entwicklung eines ASICs durch zwei Lieferanten erhebliche Mehrkosten zunächst im Entwicklungsbereich und später wegen der geringeren Stückzahlen für den einzelnen ASIC-Lieferanten im Fertigungsbereich bedeuten.

Engagement von  
Großproduzenten im  
ELMOS-Markt gering

#### WETTBEWERB UND MITARBEITER

Eine Vielzahl von Wettbewerbern im Halbleitermarkt für automobiler Anwendungen bietet ähnliche Produkte wie ELMOS auf vergleichbarer technologischer Grundlage an. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass große Halbleiterhersteller, die bisher noch gar nicht oder nur zu einem geringen Prozentsatz im automobilen Halbleitermarkt tätig sind, in Zukunft versuchen werden, in dieses Marktsegment einzudringen. Dies geschieht insbesondere in Phasen, in denen das klassische Halbleitergeschäft in den Bereichen Speicherchips und Telekommunikation Rückgänge zu verzeichnen hat. Derartige Versuche konnten im Jahr 2004 bei mehreren Wettbewerbern beobachtet werden. Da diese Großproduzenten aus Rentabilitätsgründen sich allerdings auf großvolumige Projekte fokussieren müssen, ist ihr Engagement im Nischenmarkt der kundenspezifischen Schaltungen stets relativ gering. Damit erscheint das Risiko für ELMOS vergleichsweise gering. Allerdings akquiriert ELMOS in letzter Zeit vermehrt großvolumigere Aufträge. Dadurch wird ELMOS in Zukunft mehr in Wettbewerb zu Großproduzenten treten und entsprechenden Preisdruck spüren.

Die sehr entwicklungsintensive Geschäftstätigkeit des Unternehmens führt zu einem stark ausgeprägten und sehr spezifischen Ingenieur-Know-how – jedoch nur teilweise zu Patenten. Somit ergibt sich für ELMOS eine erhöhte Abhängigkeit von

Nicht gedeckte Entwicklungs-  
kosten werden durch  
Serienproduktion amortisiert

bestimmten Mitarbeitern. Das Fluktuationsrisiko reduziert sich bei ELMOS durch die erkennbar hohe Motivation und Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen. Die Mitarbeiter sind beispielsweise über ein Aktienoptionsprogramm am Erfolg der ELMOS beteiligt.

#### ENTWICKLUNG NEUER PRODUKTE UND TECHNOLOGIEN

Bei der kundenspezifischen Entwicklung von Produkten ist zu berücksichtigen, dass bei der Akquisition eines neuen Auftrages die Einmalkosten im Entwicklungsbereich heute in der Regel nicht mehr in vollem Umfang als Vorabzahlung von den Kunden erlangt werden können. Diese vorab nicht gedeckten Entwicklungskosten werden über die späteren Stückzahlen in der Serie amortisiert. Hier besteht das Risiko, dass bei Entwicklungen, die nicht in eine Lieferbeziehung münden, nicht amortisierte Kosten bei der Gesellschaft verbleiben. In der Vergangenheit war die Anzahl der Produkte, die nicht in einer Lieferbeziehung endeten, jedoch sehr gering.

Der Markt für die ELMOS-Produkte ist durch ständige Weiterentwicklung und Verbesserung der Produkte gekennzeichnet. Der ELMOS-Erfolg ist deshalb stark von der Fähigkeit abhängig, neue komplexe Produkte preisgünstig zu entwickeln, sie rechtzeitig im Markt einzuführen und zu erreichen, dass diese Produkte von führenden Zulieferern der Automobilindustrie ausgewählt werden.

Der zukünftige Erfolg von ELMOS ist auch von der Fähigkeit abhängig, neue Entwicklungs- und Produktionstechnologien zu entwickeln. ELMOS entwickelt analoge und digitale Halbleiterstrukturen und -funktionen für ihre selbst entwickelte modulare Hochvolt-CMOS-Prozesstechnologie. Wie die Konkurrenten muss ELMOS ihre Technologie ständig weiterverbessern und neue Prozesstechnologien für die fortschreitende Verkleinerung der Strukturen im Submikronbereich entwickeln. Sollte ELMOS zukünftig nicht in der Lage sein, neue Produkte und Produktverbesserungen zu entwickeln, zu produzieren und abzusetzen, dürfte dies signifikante Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben.

Durch die Fähigkeit von ELMOS, ASICs für alle Arten von elektronischen Geräten im Automobil zu entwickeln und zu fertigen, sind ELMOS-Produkte in fast allen elektronischen Komponenten eines PKW vertreten, so dass das Risiko des Wegfalls eines Auftrages für eine einzelne elektronische Komponente breit gestreut und praktisch nicht vorhanden ist. Zwar könnte ein mehrjähriger Einbruch der Automobilindustrie, der die Automobilunternehmen veranlasst, keine neuen elektronischen Produkte zu entwickeln, die Gesellschaft in ihrer Entwicklung nachhaltig beeinträchtigen. Ein derartiger Einbruch ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht abzusehen, insbesondere weil – wie bereits oben erwähnt – die Automobilindustrie in schlechteren Zeiten eher dazu neigt, die technische Ausstattung zu erhöhen. Außerdem ersetzen kunden-

spezifische ASICs von ELMOS in zunehmendem Maße elektronische Standardbauteile, so dass ELMOS stärker als der Gesamtmarkt wachsen und den Marktanteil vergrößern kann. So können selbst Risiken, die mit dem eventuellen Verlust von Entwicklungsaufträgen für ASICs in der Automobilindustrie verknüpft sind, reduziert werden.

Die derzeitige Fertigungskapazität von ELMOS ist für das geplante Wachstum in 2005 und 2006 ausreichend. Parallel zum Ausbau der Fertigung in Dortmund wurde im Jahr 2004 mit dem Prozesstransfer zum Fraunhofer-Institut in Duisburg begonnen, das ab 2006 als weiterer Fertigungsstandort hinzu kommen wird. Damit erhält ELMOS Zugang zu einer zusätzlichen Fertigungskapazität für maximal 200 Waferstarts pro Tag (200mm-Wafer), die für ein geplantes Umsatzwachstum bis zum Ende dieser Dekade ausreicht.

#### BESCHAFFUNG

Die von ELMOS für die Fertigung benötigten Rohstoffe sind weltweit bei verschiedenen Lieferanten verfügbar und unterliegen keinem Monopol. Branchentypisch ist dabei eine gewisse Abhängigkeit von einzelnen fernöstlichen Partnern im Assembly-Bereich. Hier hat ELMOS mit dem Erwerb der ELMOS Advanced Packaging jedoch die Weichen für eine vertikale Vertiefung der Wertschöpfungskette gestellt. ELMOS Advanced Packaging hat zum Jahresende 2004 etwa 57 Prozent der von ELMOS benötigten Assembly-Dienstleistungen erbracht. Dadurch wird ELMOS zunehmend von den fernöstlichen Partnern beziehungsweise von Dollarschwankungen unabhängiger.

#### PRODUKTHAFTUNG

Die von ELMOS produzierten ASICs werden als Komponenten in komplexe elektronische Systeme integriert. Fehler oder Funktionsmängel der von ELMOS hergestellten ASICs oder der elektronischen Systeme, in die sie integriert sind, können direkt oder indirekt Eigentum, Gesundheit oder Leben Dritter beeinträchtigen. ELMOS ist nicht in der Lage, ihre Haftung gegenüber Abnehmern oder Dritten in ihren Absatzverträgen zu reduzieren oder auszuschließen.

Produkte werden  
mehrfach getestet

ELMOS verfolgt konsequent eine Null-Fehler-Strategie und investiert stetig in die Erkennung und Vermeidung von Fehlerquellen und Fehlern. So werden die einzelnen Halbleiterchips hinsichtlich ihrer Qualität und Funktion im Werk im Regelfall gleich mehrfach bei unterschiedlichen Temperaturen getestet. Obwohl die Gesellschaft die nach TS 16949, VDA 6.1 und QS 9000 zertifizierten Qualitätskontrollsysteme sowie weitreichende Testverfahren vor der Auslieferung ihrer Produkte einsetzt, können

sich Produktfehler möglicherweise erst nach Installation und Gebrauch der Produkte durch den Endverbraucher zeigen.

Wenn solche Produktfehler auftreten, kann dies teure und zeitaufwendige Produktmodifikationen nach sich ziehen und zu Störungen der Kundenbeziehungen sowie zum Verlust von Marktanteilen führen. Ein Qualitätsproblem ganzer Chargen könnte zudem zu Regressansprüchen der Kunden im Millionenbereich führen. Dieses Risiko ist angemessen versichert. All dies könnte jedoch negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft haben.

#### BETEILIGUNGSBEREICH

Durch die hohe Allokation von finanziellen Mitteln in die Tochtergesellschaften besteht die erhöhte Pflicht, mit entsprechenden Controlling-Instrumenten und kontinuierlichen Soll-Ist-Analysen mögliche finanzielle Risiken frühzeitig zu erkennen beziehungsweise zu minimieren. So sind für alle Tochtergesellschaften Geschäftspläne und Budgets erstellt worden, deren Erreichen sicherstellen wird, dass hieraus keine bestandsgefährdenden Risiken resultieren.

#### BETRIEBSUNTERBRECHUNG

Neben den bereits dargestellten und erläuterten Geschäftsrisiken ist nach Einschätzung von ELMOS das einzige betriebliche Risiko, das die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeinträchtigen und den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnte, das Risiko der Zerstörung der Fertigungsanlagen durch Feuer oder andere Katastrophen. Zwar ist das Betriebsunterbrechungsrisiko durch solche Ereignisse angemessen versichert, jedoch bestünde in einem solchen Fall eine erhebliche Gefahr des Verlustes von Schlüsselkunden. Dieses Risiko ist nicht versicherbar.

Fertigungslinien können  
 autark arbeiten

Dieses Risiko ist dadurch bereits reduziert, dass ab 2006 eine weitere Fertigungslinie (200mm-Linie) beim Fraunhofer-Institut in Duisburg von ELMOS betrieben wird. Zu einem späteren Zeitpunkt kann auch am Standort Dortmund in einem separaten Gebäude eine weitere Produktionslinie errichtet werden. Damit verfügt ELMOS über mehrere unabhängige Fertigungslinien, die autark voneinander produzieren können.

Die üblichen versicherbaren Risiken wie Feuer, Feuerbetriebsunterbrechung, Wasser, Sturm, Diebstahl, Haftpflicht, insbesondere Produkthaftpflicht, auch in den USA, sowie die Kosten eines etwaigen Rückrufs sind angemessen versichert. Weitere Risiken, die die Entwicklung des Konzerns wesentlich beeinträchtigen oder den Fortbestand des Konzerns gefährden können, sind derzeit nicht erkennbar.

## ► Prognosebericht

---

Auch zukünftig Nischenanbieter für automobiler kundenspezifische Halbleiter

ELMOS wird sich weiterhin als Nischenanbieter auf kundenspezifische Anwendungen für die Automobilindustrie fokussieren. Dabei sind die ELMOS-Technologie, das ELMOS-Design und die Produktion in der ELMOS eigenen Fertigung feste Säulen dieser Strategie.

Das erfolgreiche automobiler ASIC-Geschäft soll weiterhin ergänzt werden mit der vermehrten Vermarktung von anwendungsspezifischen mechatronischen Modulen, die ASICs, Sensoren und funktionale Gehäuse, gegebenenfalls noch mit patentierten Technologien, vereinen. Weiter sollen anwendungsspezifische Standardprodukte, die in der Regel auf früher entwickelten ASICs basieren und für die eine Nachfrage von mehreren Kunden absehbar ist, das Produktportfolio erweitern.

Es ist zudem Ziel der ELMOS-Gruppe, den Umsatzanteil in sich schneller entwickelnden Märkten neben dem automobilen Markt zu erhöhen, um diese als Innovations-treiber nutzen zu können. Geographisch gesehen strebt ELMOS eine Durchdringung des nordamerikanischen Marktes und mittelfristig eine vermehrte Expansion in den asiatischen Markt an.

Elektronikanteil im Automobil sorgt für weiteres Wachstum unseres Marktes

Für das Jahr 2005 wird allgemein mit einer Stagnation im weltweiten Halbleitermarkt gerechnet. In der Automobilindustrie wird jedoch von keinen größeren Veränderungen in der weltweiten Nachfrage nach Halbleitern ausgegangen. Die Zulassungszahlen für Neufahrzeuge werden keine Überraschungen bringen und im Wesentlichen an die Vorjahreszahlen anschließen. Aufgrund des kontinuierlich steigenden Elektronikanteils je Fahrzeug wird der Markt für automobiler Halbleiter weiter steigen. Für die automobilen Halbleiterchips wird ein etwa acht- bis neunprozentiges Wachstum bis 2010 erwartet.

Die gut gefüllte Produkt-Pipeline aus den Design-Wins der vergangenen Jahre und der – trotz der im zweiten Halbjahr 2004 gesunkenen Book-to-bill-Rate – zufriedenstellende Auftragseingang für 2005 unterstreichen dies. Mit der größeren Liefermenge ist eine höhere Auslastung der Fertigungskapazitäten in Dortmund verbunden, was zu einer weiteren Verbesserung der Ertragssituation führen wird.

Im Bereich Mikromechanik steht für SMI in 2005 die Fortsetzung der Umstellung der laufenden Produktion auf 150mm-Wafer an. Dadurch erwartet ELMOS eine weitere Verbesserung der Bruttomarge vor allem im Foundry-Geschäft für Dritte. Besondere Bedeutung haben die geplanten Serienanläufe zahlreicher neuer Produkte. Gemeinsam mit der Halbleiterfertigung in Dortmund werden mehrere wichtige ASIC<sup>plus</sup>-Projekte mit namhaften europäischen Kunden betrieben, die im Jahr 2005 entscheidende Meilensteine nehmen. Bei SMI sind keine großen Investitionen in Gebäude oder Maschinen im Jahr 2005 vorgesehen.

Die Investitionen im Jahr 2005 werden sich vor allem auf die geschilderten Maßnahmen zum Aufbau der Frontend-Kapazitäten in Duisburg und Dortmund sowie der Backend-Erweiterung in Dortmund beziehen. Wie bereits oben berichtet, wurde hierfür ein mittelfristiger Investitionsplan für die nächsten Jahre aufgestellt. Dieser Rahmenplan der ELMOS-Gruppe sieht in den kommenden Jahren Investitionen in Höhe von jeweils rund 30 Millionen Euro vor. Es ist das Ziel, dass der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit auch in Zukunft die Investitionen deckt und somit keine Notwendigkeit der externen Finanzierung besteht.

Insgesamt strebt die ELMOS-Gruppe für das Jahr 2005 ein Umsatzwachstum von mehr als 15 Prozent an. Die Bruttomarge und das Verhältnis von Betriebsergebnis zu Umsatz sollen wiederum die Zielwerte von 50 beziehungsweise 20 Prozent erreichen.

Dortmund, im Februar 2005

Der Vorstand



Knut Hinrichs



Dr. Klaus Weyer



Dr. Peter Thoma



Reinhard Senf



## KONZERNABSCHLUSS

Jahresabschluss

► 72

Bilanz

► 72

Gewinn- und  
Verlustrechnung

► 74

Kapitalfluss-  
rechnung

► 75

Entwicklung des  
konsolidierten  
Eigenkapitals

► 76

Erläuterungen zu den  
Konzernabschlüssen

► 77

Bestätigungsvermerk  
des Abschlussprüfers

► 102

## KONZERNABSCHLUSS

## ► Jahresabschluss

## Konzernbilanz nach US-GAAP

	31.12.2004 Euro	31.12.2003 Euro
<b>Aktiva</b>		
<b>Umlaufvermögen</b>		
Liquide Mittel	15.286.595	17.426.927
Wertpapiere des Umlaufvermögens (Erläuterung 2)	3.629.904	8.438.742
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen nach Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen von 156.500 Euro in 2004, 353.269 Euro in 2003	27.777.902	26.566.875
Vorräte (Erläuterung 3)	25.147.734	22.132.468
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögensgegenstände	5.803.386	8.757.505
	<b>77.645.521</b>	<b>83.322.517</b>
<b>Latente Steuern (Erläuterung 7)</b>	<b>13.274.744</b>	<b>12.709.374</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Geschäfts- oder Firmenwert (Erläuterungen 2   15)	8.314.399	7.622.344
Software (Erläuterung 2)	35.138.106	28.715.741
Abzüglich kumulierter Abschreibungen	- 9.280.575	- 7.445.770
	<b>34.171.930</b>	<b>28.892.315</b>
<b>Beteiligungen (Erläuterung 4)</b>	<b>559.828</b>	<b>342.739</b>
<b>Anlagevermögen</b>		
Grundstücke	7.202.876	6.565.486
Gebäude und Einbauten	63.040.386	60.185.797
Technische Anlagen und Maschinen	107.992.133	96.317.333
Anlagen im Bau	14.253.989	6.219.503
Abzüglich kumulierter Abschreibungen	- 98.360.743	- 89.226.962
	<b>94.128.641</b>	<b>80.061.157</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>219.780.664</b>	<b>205.328.102</b>

Siehe Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen

- Jahresabschluss
- Konzernanhang
- Bestätigungsvermerk

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2004</b>	<b>31.12.2003</b>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.750.354	17.638.171
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.039.224	7.945.390
Rückstellungen für Löhne und Gehälter, Sozialleistungen und Steuern	4.015.427	3.758.365
Sonstige Rückstellungen	4.597.720	4.255.810
Steuerrückstellungen	4.072.637	1.853.268
Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (Erläuterung 5)	3.749.038	4.017.395
	<b>45.224.400</b>	<b>39.468.399</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten abzüglich des Anteils mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr (Erläuterung 5)</b>	<b>36.127.507</b>	<b>38.898.265</b>
<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.608.986</b>	<b>2.104.340</b>
<b>Minderheitsanteile</b>	<b>608.040</b>	<b>178.496</b>
<b>Eigenkapital</b>		
Grundkapital	19.300.000	19.300.000
Kapitalrücklage	84.918.244	84.716.644
Kumulierte erfolgsneutrale Veränderungen des Eigenkapitals (Erläuterung 11)	– 11.081.400	– 8.613.429
Bilanzgewinn	43.074.887	29.275.387
	<b>136.211.731</b>	<b>124.678.602</b>
<b>Passiva gesamt</b>	<b>219.780.664</b>	<b>205.328.102</b>

*Siehe Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen*

## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung nach US-GAAP

	2004 Euro	2003 Euro
<b>Umsatzerlöse, netto (Erläuterung 12)</b>	<b>143.308.750</b>	<b>121.395.405</b>
Herstellungskosten der zur Erzielung der Umsatzerlöse erbrachten Leistungen	69.754.456	59.991.098
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>73.554.294</b>	<b>61.404.307</b>
Forschungs- und Entwicklungskosten	24.429.713	20.374.131
Marketing- und Vertriebskosten	6.954.423	6.642.202
Allgemeine Verwaltungskosten	12.619.265	12.809.220
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>29.550.893</b>	<b>21.578.754</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Erträge)	3.442.848	3.812.961
Wechselkursverluste (-erträge), netto	41.059	134.089
Sonstige (Erträge) / Aufwendungen, netto	791.645	356.152
<b>Ergebnis vor Ertragssteuern, Nettoanteil am Verlust der nicht konsolidierten Tochtergesellschaften und Minderheitsanteilen</b>	<b>25.275.341</b>	<b>17.275.552</b>
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erläuterung 7)</b>		
Steueraufwendungen	9.628.627	6.307.541
Latente Steuern (Erträge)	- 923.808	592.536
	<b>8.704.819</b>	<b>6.900.077</b>
<b>Jahresüberschuss vor Nettoanteil am Ergebnis nicht konsolidierter Tochtergesellschaften und Minderheitsanteilen</b>	<b>16.570.521</b>	<b>10.375.475</b>
(Gewinne) / Verluste aus der Bewertung at equity	- 57.233	247.090
Minderheitsanteile bei konsolidierten Tochtergesellschaften	319.254	112.763
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>16.308.500</b>	<b>10.015.622</b>
<b>Unverwässertes Ergebnis je Aktie (Erläuterungen 2   9   10)</b>	<b>0,85</b>	<b>0,52</b>
Voll verwässertes Ergebnis je Aktie	0,84	0,52

Siehe Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen

- Jahresabschluss
- Konzernanhang
- Bestätigungsvermerk

## Konzern-Kapitalflussrechnung nach US-GAAP

	2004 Euro	2003 Euro
<b>Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>		
Jahresüberschuss	16.308.500	10.015.622
Abschreibungen abzüglich Zuschreibungen	12.694.938	14.571.630
Nicht liquiditätswirksamer Aufwand	1.455.679	592.537
Minderheitsanteile	319.254	112.763
Eigenkapitalentwicklung bei nicht konsolidierten Tochtergesellschaften	– 57.233	247.090
Aufwand aus Aktienoptionsprogramm	201.600	100.800
Veränderungen im Netto-Umlaufvermögen:		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	– 1.211.027	– 3.779.074
Vorräte	– 3.015.266	1.948.233
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögensgegenstände	3.037.627	– 2.875.869
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.093.834	– 3.516.759
Sonstige Rückstellungen	409.291	– 781.134
Steuerrückstellungen	1.618.345	– 10.091.636
	<b>34.855.542</b>	<b>6.544.203</b>
<b>Cash Flow aus der Investitionstätigkeit</b>		
Investitionen in das Anlagevermögen	– 33.549.920	– 25.341.827
Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	706.629	29.983.506
Erwerb / Abgang von Wertpapieren des Umlaufvermögens	1.199.958	– 1.088.507
Erwerb / Abgang von Beteiligungen	– 240.289	– 137.432
Erworbene liquide Mittel	720.851	0
	<b>– 31.162.771</b>	<b>3.415.740</b>
<b>Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>		
Gezahlte Dividenden	– 2.509.000	0
Veränderung durch Minderheitsgesellschafter	187.202	0
Gewinnausschüttung durch konsolidierte Tochtergesellschaft an Minderheitsgesellschafter	– 170.000	– 75.000
Aufnahme langfristiger Verbindlichkeiten	91.292	6.605.921
Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	– 3.625.761	– 3.213.545
Aufnahme / Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	112.183	– 4.518.657
	<b>– 5.914.084</b>	<b>– 1.201.281</b>
<b>Abnahme / Zunahme der liquiden Mittel</b>	<b>– 2.221.313</b>	<b>8.758.662</b>
Effekt aus Wechselkursänderungen der liquiden Mittel	80.981	– 370.563
Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres	17.426.927	9.038.828
<b>Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>15.286.595</b>	<b>17.426.927</b>

Siehe Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen

## Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals nach US-GAAP

	Aktien	Gezeichnetes Kapital Euro	Kapital- rücklage Euro	Kumulierte erfolgsneutrale Veränderungen des Eigenkapitals Euro	Bilanz- gewinn Euro	Gesamt Euro
<b>Stand 31. Dezember 2002</b>	<b>19.300.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>84.615.844</b>	<b>- 10.734.523</b>	<b>19.259.765</b>	<b>112.441.086</b>
Jahresüberschuss					10.015.622	10.015.622
Aufwand aus Aktienoptionen			100.800			100.800
Veränderungen bei nicht realisierten Gewinnen aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (nach Steuern)				3.203.498		3.203.498
Fremdwährungsanpassungen				- 1.082.404		- 1.082.404
<b>Stand 31. Dezember 2003</b>	<b>19.300.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>84.716.644</b>	<b>- 8.613.429</b>	<b>29.275.387</b>	<b>124.678.602</b>
Jahresüberschuss					16.308.500	16.308.500
Dividendenausschüttung					- 2.509.000	- 2.509.000
Aufwand aus Aktienoptionen			201.600			201.600
Veränderungen bei nicht realisierten Gewinnen aus Wertpapieren des Umlaufvermögens (nach Steuern)				- 985.515		- 985.515
Fremdwährungsanpassungen				- 1.482.456		- 1.482.456
<b>Stand 31. Dezember 2004</b>	<b>19.300.000</b>	<b>19.300.000</b>	<b>84.918.244</b>	<b>- 11.081.400</b>	<b>43.074.887</b>	<b>136.211.731</b>

Siehe Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen

## ► Erläuterungen zu den Konzernabschlüssen

---

### 1. GESELLSCHAFTSRECHTLICHE GRUNDLAGEN

Die ELMOS Semiconductor Aktiengesellschaft („die Gesellschaft“ oder „ELMOS“) entwickelt, produziert und vertreibt Application Specific Integrated Circuits (ASICs). Die Gesellschaft hat Vertriebsgesellschaften in Frankreich, den Vereinigten Staaten von Amerika und den Niederlanden und kooperiert in der Entwicklung und Herstellung von ASIC-Chips mit anderen deutschen Unternehmen.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

### 2. WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

#### Erstellung der Konzernabschlüsse

Die vorliegenden Konzernabschlüsse wurden in Übereinstimmung mit US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen (US-GAAP) erstellt. In Übereinstimmung mit den laut Handelsgesetzbuch (HGB) vorgeschriebenen, allgemein anerkannten deutschen Rechnungslegungsgrundsätzen führt die Gesellschaft ihre Bücher in Euro. Deutsche Rechnungslegungsgrundsätze unterscheiden sich in einigen Aspekten von US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen. Die Gesellschaft hat alle Anpassungen, die zur Darstellung der Konzernabschlüsse nach US-GAAP erforderlich waren, durchgeführt.

Die Aufstellung von Konzernabschlüssen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Rechnungslegung erfordert Schätzungen und Annahmen durch die Geschäftsführung der Gesellschaft, die die Ausweise in den Konzernabschlüssen sowie die dazugehörigen Erläuterungen beeinflussen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den vorgenommenen Schätzungen und Annahmen abweichen.

In 2004 sind vom Financial Accounting Standards Board (FASB) neue Rechnungslegungsstandards veröffentlicht worden, die Einfluss auf die folgenden Konzernabschlüsse haben können:

Das FASB hat im Dezember 2004 SFAS 123 „Share-Based Payment“ in revidierter Fassung veröffentlicht. Damit wird das FASB Statement No. 123, „Accounting for Stock-Based Compensation“ ersetzt, APB Opinion No. 25, „Accounting for Stock Issued to Employees“ abgeschafft und das FASB Statement No. 95, „Statement of Cash Flows“ angepasst.

Der Ansatz des revidierten Statements 123 (R) entspricht im Grundsatz dem im ersetzten Statement 123 beschriebenen Ansatz. Dennoch wird nun für alle aktienbasierte Vergütungen inklusive stock options zukünftig die Erfassung zum Marktwert (fair value) vorgeschrieben.

Die Gesellschaft erwartet aus der Anwendung einen signifikanten Einfluss auf die Finanzposition und Ertragslage des Geschäftsjahres 2005. Hinsichtlich der Höhe des Effektes wird an dieser Stelle auf das „als-ob-Ergebnis“ in Erläuterung 9 verwiesen.

#### **Konsolidierung**

Alle Gesellschaften, an denen ELMOS eine Mehrheitsbeteiligung hält, wurden in den Konzernabschluss einbezogen. Alle wesentlichen Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Transaktionen zwischen den konsolidierten Gesellschaften wurden im Konzernabschluss eliminiert. Beteiligungen von mehr als 20 Prozent, aber nicht mehr als 50 Prozent, wurden, falls wesentlich, unter Anwendung der Equity-Methode erfasst.

Im Januar 2003, hat das U.S. Financial Accounting Standards Board die Interpretation Nr. 46, "Consolidation of Variable Interest Entities an interpretation of ARB No. 51" (FIN 46) veröffentlicht. FIN 46 stellt die Anwendung des Accounting Research Bulletin (ARB) Nr. 51, "Consolidated Financial Statements", hinsichtlich derjenigen ein-zubeziehenden Gesellschaften klar, deren Eigenkapitalgeber keine Kontrolle gemäß dem control-Konzept ausüben. Es erfordert die Konsolidierung von Gesellschaften, deren überwiegender Teil der erwarteten Verluste und Gewinne von dem berichtenden Konzern aufgrund gesellschaftsrechtlicher oder anderer vertraglicher Vereinbarungen beziehungsweise finanzieller Interessen übernommen werden.

Die Anwendung dieser Interpretation führt zur Konsolidierungspflicht für folgende Gesellschaften, die im Bereich der Forschung beziehungsweise Entwicklung tätig sind:

#### *DMOS GmbH, Dresden*

Die Gesellschaft hat mit der DMOS GmbH, Dresden (DMOS) mit Wirkung zum 1. November 2002 eine Vereinbarung über Forschungs- und Entwicklungsleistungen zu bestimmten Projekten geschlossen. Die Vereinbarung sieht neben Vorauszahlungen in Form von besicherten Darlehen zum Kauf von Sachanlagevermögen auch gleichmäßige monatliche Raten über die Dauer von 36 Monaten zur Finanzierung der Geschäftstätigkeit und Abgeltung der Entwicklungsleistungen der DMOS vor. Die Vereinbarung enthält ebenfalls Spezifizierungen zu den Dienstleistungen und dem Abnahmeprozedere der Entwicklungsergebnisse durch die Gesellschaft. DMOS erbringt seit 2003 überwiegend Leistungen für die Gesellschaft als sogenannter „primary beneficiary“.

Die Gesellschaft ist wirtschaftlicher und rechtlicher Eigentümer der Ergebnisse aus der gemeinsamen Projektstätigkeit. Zudem wird der Gesellschaft eine unbefristete Kaufoption zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der DMOS gewährt, die erstmalig ab Oktober 2005 ausgeübt werden kann.

Die Gesellschaft hält die von den Anteilseignern zur Verfügung gestellten Mittel für ausreichend, um den Geschäftszweck der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit erfüllen zu können. Die Gesellschaft trägt über die in der genannten Vereinbarung zugesagten Mittel in Höhe von maximal 370 Tausend Euro pro Quartal keine weiteren Risiken aus Verlusten der DMOS.

Die Stimmrechtsverteilung bei DMOS entspricht den Beteiligungsquoten, ebenso wie die Verteilung von Gewinnen und Verlusten. Weitere Finanzierungsvereinbarungen zwischen DMOS und dem Anteilseigner oder Banken bestehen nicht.

Aufgrund von Wesentlichkeitsüberlegungen wurde DMOS nicht in den Konsolidierungskreis aufgenommen. Die geleisteten monatlichen Zahlungen sind in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Entwicklungsaufwand ausgewiesen worden.

#### *MECHALESS Systems GmbH, Karlsruhe*

Mit Wirkung zum 30. September 2003 hat die Gesellschaft 49 Prozent der Anteile an der MECHALESS Systems GmbH, Karlsruhe (MECHALESS) als sogenannter „primary beneficiary“ erworben. Zudem sind seit 2004 zwei Prozent der Anteile an MECHALESS der ELMOS als wirtschaftlichem Eigentümer zuzuordnen. Die MECHALESS ist auf dem Gebiet der Applikationsentwicklung für Sensoren tätig. Neben der Beteiligung hat die Gesellschaft eine Entwicklungs- und Vertriebsvereinbarung mit der MECHALESS getroffen, auf deren Basis die MECHALESS einen fest vereinbarten Betrag pro Quartal für deren Entwicklungstätigkeit erhält. Die Höhe des quartalsweise zu zahlenden Betrages wird bis 2007 auf Null reduziert und durch eine Umsatzprovision für in Serie gegangene Produkte substituiert.

Die Gesellschaft ist wirtschaftlicher Eigentümer sowohl der verwendeten Basistechnologie als auch der Ergebnisse aus der von ELMOS finanzierten Entwicklungs- und Applikationstätigkeit.

Die Gesellschaft hält die von den Anteilseignern zur Verfügung gestellten Mittel für ausreichend, um den Geschäftszweck der Entwicklungs- und Applikationstätigkeit erfüllen zu können. Weitere Mittelzusagen der anderen Anteilseigner bestehen nicht. Auch haben diese keine Rückgriffsmöglichkeiten auf die Gesellschaft. Die Gesellschaft trägt über die in der Vereinbarung zugesagten Mittel in Höhe von maximal 400 Tausend Euro pro Quartal keine weiteren Risiken aus Verlusten der MECHALESS.

Die Stimmrechtsverteilung bei MECHALESS entspricht den Beteiligungsquoten, ebenso wie die Verteilung von Gewinnen und Verlusten. Die MECHALESS wurde zum 1. Januar 2004 erstmalig in den Konsolidierungskreis aufgenommen. Aus der Kaufpreisallokation im Rahmen der erstmaligen Einbeziehung resultierten keine wesentlichen Unterschiedsbeträge. Das Jahresergebnis der MECHALESS betrug 94 Tausend Euro in 2004 und das einbezogene Nettovermögen zum 31. Dezember 2004 174 Tausend Euro.

#### Liquide Mittel

Die Gesellschaft behandelt alle Kapitalanlagen mit hoher Fungibilität mit einer Fälligkeit von bis zu drei Monaten zum Zeitpunkt des Erwerbs als Barvermögen.

#### Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens setzen sich im Wesentlichen aus Anteilspapieren zusammen. Wertpapiere des Umlaufvermögens werden zum Marktwert angesetzt, das heißt zu dem Wert, der zum Bilanzstichtag auf dem Markt erzielbar war. Grundsätzlich investiert die Gesellschaft nur in hochwertige Wertpapiere des Umlaufvermögens. Alle Wertpapiere des Umlaufvermögens der Gesellschaft entsprechen der Definition „available-for-sale“ (zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere) gemäß Statement of Financial Accounting Standards („SFAS“) Nr. 115, „Accounting for Certain Investments in Debt and Equity Securities“ (Bilanzierung bestimmter Investitionen in schuld- und eigentumsrechtliche Wertpapiere).

#### Wertpapiere des Umlaufvermögens

	Anschaffungskosten Euro	Marktwert Euro
Anteilspapiere – 31. Dezember 2003	20.260.320	8.438.742
Anteilspapiere – 31. Dezember 2004	19.060.318	3.629.904

SFAS Nr. 115 stellt klar, dass ein Unternehmen für die einzelnen Anteilspapiere, die als zur Veräußerung verfügbar („available-for-sale“) eingestuft werden, abwägen soll, ob eine Wertminderung des Marktwertes unterhalb der fortgeführten Anschaffungskosten nicht nur temporär ist.

Soweit die Wertminderung des Marktwertes als nicht nur temporär beurteilt wird, ist die Summe der Wertberichtigung erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung zu vereinnahmen. Bislang wurde auf den Marktwert der Anteilspapiere erfolgsneutral im „accumulated other comprehensive income“ als Teil des Eigenkapitals abgeschrieben.

Die im Portfolio liegenden Anteilspapiere haben im abgelaufenen Geschäftsjahr bis März 2004 eine konstant steigende Wertentwicklung aufgewiesen. Darauf folgend ergab sich bis zum Bilanzstichtag ein wiederholter Rückgang der Marktwerte. Da die Wertpapiere zum 31. Dezember 2004 weiterhin signifikant unter den Anschaffungskosten bilanziert sind und diese Wertminderung am Bilanzstichtag deutlich über ein Jahr besteht, sieht SFAS 115 vor, dass eine Qualifizierung als nur temporäre Wertminderung nur möglich ist, wenn sonstige Faktoren, die sich im Umfeld des Emittenten und dessen fundamentalen Finanzdaten widerspiegeln, eine solche Qualifizierung rechtfertigen.

Die Gesellschaft hat alle verfügbaren Hinweise dahingehend berücksichtigt, ob die Wertminderung des Marktwertes der bilanzierten Anteilspapiere nur temporär ist oder nicht, insbesondere

- die finanzielle Lage und die kurzfristigen Aussichten des Emittenten, insbesondere die aktuellen Cash Flow Daten und die geplante Ergebnisentwicklung,
- die Absicht und Möglichkeit der Gesellschaft, die Investition für eine Zeitperiode zu halten, die ausreicht, eine vollständige Erholung des Marktwertes zu ermöglichen,
- die Bewertungen und Einschätzungen von Analysten und Branchenexperten,
- die Wertentwicklung der Anteilspapiere nach dem Bilanzstichtag und
- die vergangene Wertentwicklung der Anteilspapiere in 2003 und 2004 und der Vergleich mit der Wertentwicklung vergleichbarer Wertpapier-titel und Indizes.

Auf Basis der durchgeführten Einschätzung zum 31. Dezember 2004 kommt die Unternehmensleitung zu dem Ergebnis, dass die Wertminderung des Marktwertes im Wesentlichen nur temporär ist. In Höhe von drei Millionen Euro wird die Wertminderung als nicht-temporär eingeschätzt und somit in der angegebenen Höhe erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

#### **Marktwert von Finanzierungsinstrumenten**

Der Buchwert von Finanzierungsinstrumenten wie Forderungen und Verbindlichkeiten entspricht aufgrund der kurzfristigen Fälligkeiten dieser Finanzierungsinstrumente im Wesentlichen dem Marktwert.

Der Buchwert von Verbindlichkeiten gegenüber Banken entspricht im Wesentlichen dem Marktwert, basierend auf den für dieselben oder vergleichbare Begebungen angesetzten Marktpreisen, sowie auf den der Gesellschaft aktuell angebotenen Zinssätzen. Die Gesellschaft beobachtet die Wertentwicklung der Verbindlichkeiten mit festen und variablen Zinssätzen sowie der lang- und kurzfristigen Verbindlichkeiten. In diesem Zusammenhang erfolgt eine Überprüfung der Geschäfts- und sonstigen Finanzrisiken.

Zur Absicherung gegen Zinssatzschwankungen aus kurzfristig revolvingenden Verbindlichkeiten mit variablen Zinssätzen, hat die Gesellschaft eine Zinsswapsvereinbarung über einen Basisbetrag von 20.000.000 Euro abgeschlossen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und endet in 2008. Der Zinsswap wurde im Konzernabschluss nicht als Hedging Instrument gemäß SFAS No. 133, „Accounting for Derivative Instruments and Hedging Activities“ behandelt. Die Marktwertveränderungen des Zinsswaps, die in 2004 nicht signifikant waren, werden sofort erfolgswirksam erfasst und unter Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der Marktwert des Zinsswaps, der auf Basis von offiziellen Preisangeboten ermittelt wurde, beträgt zum 31. Dezember 2004 – 186.051 Euro.

#### **Kreditrisiken**

Die Gesellschaft bewertet laufend die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden und verlangt in der Regel keine Sicherheiten. Die Gesellschaft hat Wertberichtigungen auf mögliche Forderungsausfälle vorgenommen. Derartige Forderungsausfälle entsprachen den Schätzungen und Annahmen des Vorstandes und bewegen sich im geschäftsüblichen Umfang.

#### **Umgliederungen**

Verschiedene Vorjahresbeträge wurden zur Anpassung an die Darstellung des laufenden Geschäftsjahres sowie zum Zwecke diverser Korrekturen umgegliedert.

#### **Vorräte**

Vorräte werden unter Beachtung des Niederstwertprinzips zu durchschnittlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.

#### **Anlagevermögen**

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten angesetzt. Die Gegenstände des Anlagevermögens werden unter Anwendung der linearen Methode über ihre jeweilige voraussichtliche Nutzungsdauer abgeschrieben:

Gebäude	25 Jahre
Einbauten	10 Jahre
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 bis 12 Jahre
Software	3 Jahre

Mit Wirkung vom 1. Januar 2004 überarbeitete die Gesellschaft ihre Schätzung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer bestimmter Maschinen (im Wesentlichen Tester). In Vorjahren wurden diese Maschinen über acht bis zehn Jahren abgeschrieben. Die Nutzungsdauern wurden in Anbetracht der Tatsache, dass die Tester in der Vergangenheit deutlich länger als zehn Jahre genutzt wurden, jetzt auf zwölf Jahre verlängert. Die Änderungen wurden vorgenommen, um den Zeitraum, in dem die Vermögenswerte in Benutzung bleiben, besser darzustellen. Die Änderung hat den Effekt, dass der Abschreibungsaufwand verringert und der Jahresüberschuss nach Steuern um rund 605.828 Euro (0,03 Euro je Aktie) erhöht wurde.

#### **Fremdwährungsumrechnung und -transaktionen**

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten der ausländischen Tochtergesellschaften werden zum Stichtagskurs in Euro umgerechnet. Fremdwährungsgewinne und -verluste aus der Umrechnung werden nicht im Jahresüberschuss erfasst, sondern als separater Posten erfolgsneutral im Eigenkapital ausgewiesen. Erlös- und Aufwandspositionen werden zu den durchschnittlichen Fremdwährungskursen während des zugrunde liegenden Zeitraums umgerechnet.

Die Gesellschaft geht von Zeit zu Zeit Devisentermingeschäfte zur Absicherung von Transaktionen in Fremdwährungen ein, die auf den Zeitraum beschränkt sind, in dem das Risiko besteht. Diese Kursicherungsgeschäfte minimieren die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Ertragslage der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist nicht an Spekulationsgeschäften beteiligt.

Die Devisentermingeschäfte stellen kein Risiko für die Ertragslage der Gesellschaft dar, da die Gewinne und Verluste aus diesen Verträgen in der Regel die Gewinne und Verluste aus den gesicherten Vermögensgegenständen und Verbindlichkeiten ausgleichen. Zum 31. Dezember 2004 bestanden keine Devisentermingeschäfte.

**Umsatzrealisierung**

Die Umsatzrealisierung erfolgt bei Versendung der Produkte an den Kunden beziehungsweise bei Gefahrenübergang auf den Kunden. Im Rahmen von Konsignationsvereinbarungen mit Kunden erfolgt die Umsatzrealisierung erst bei Entnahme der Waren durch den Kunden.

**Gewährleistung**

Rückstellungen für Gewährleistung werden ab dem Verkaufszeitpunkt auf Grundlage des Verhältnisses der Garantiekosten zu den Umsatzerlösen in der Vergangenheit gebildet.

**Forschung und Entwicklung**

Die Kosten, die mit Forschungs- und Entwicklungsprojekten für neue Produkte verbunden sind, sowie bedeutende Produktverbesserungen werden entsprechend ihres Anfalls in den Aufwand gebucht und sind in den Kosten für Forschung und Entwicklung enthalten. Forschungs- und Entwicklungskosten in Höhe von 4.203 Tausend Euro wurden von Kunden in 2004 erstattet (4.233 Tausend Euro in 2003).

**Immaterielle Vermögensgegenstände (Software)**

Die anfallenden Kosten für die Produktion und Entwicklung von Computer-Software sowie von Software-Applikationen, welche in andere Produkte eingebettet werden, die verkauft oder anderweitig vermarktet werden – in erster Linie Software, die in Halbleiter eingebettet ist – werden aktiviert, nachdem die technologische Durchführbarkeit beziehungsweise Realisierbarkeit hergestellt ist und die Forschung und Entwicklung hinsichtlich des Produkts, in welchem die Software enthalten ist, beendet ist. Die Aktivierung findet nur für Projekte statt, die im Kundenauftrag erfolgen. Die Kosten werden ab Produktionsstart auf einer linearen Grundlage über die geschätzte Nutzungsdauer, überwiegend über sieben Jahre, amortisiert.

In 2004 wurden Aufwendungen im Zusammenhang mit Software-Entwicklungen in Höhe von 1.790.979 Euro (Vorjahr 3.557.000 Euro) aktiviert. Die Abschreibungen auf aktivierte Software-Entwicklung betragen in 2004 929.256 Euro (Vorjahr 477.127 Euro). Der Buchwert der aktivierten Software-Entwicklungen beträgt zum 31. Dezember 2004 5.508.481 Euro (31.12.2003: 4.646.758 Euro).

Aufwendungen für die Anmeldung von Patenten und den Erwerb von Design- und Prozesstechnologie werden aktiviert. Aufwendungen werden unter Verwendung der linearen Methode über die jeweils kürzere geschätzte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von Technologien, die Schutzfrist bei Patenten oder die Vertragsdauer, aber maximal über 18 Jahre abgeschrieben. Bis zum 31. Dezember 2004 beliefen sich die aktivierten Buchwerte für als Gegenstände des Anlagevermögens erworbene zugekaufte Prozesstechnologie auf circa 9.242.689 Euro, zum 31. Dezember 2003 beliefen sich diese auf 9.653.935 Euro.

### Geschäfts- oder Firmenwert

Der Geschäfts- oder Firmenwert stellt den Überhang des Kaufpreises akquirierter Unternehmen über den Verkehrswert der erworbenen Vermögenswerte und Schulden dar und wird nicht regelmäßig abgeschrieben, sondern jährlich, soweit sich entsprechende Anhaltspunkte ergeben auch häufiger, auf die Notwendigkeit einer außerplanmäßigen Abschreibung hin überprüft. Der Geschäfts- oder Firmenwert der Gesellschaft resultiert in Höhe von 7.622.344 Euro aus der Akquisition der Silicon Microstructures, Inc.

Im Geschäftsjahr 2004 wurden die restlichen Minderheitenanteile an der ELMOS NA und der eurasem B.V. von der Muttergesellschaft erworben. Daraus resultierte eine Erhöhung des Geschäfts- oder Firmenwerts in Höhe von 692.055 Euro.

### Fördermittel

Die Gesellschaft erhält Fördermittel der öffentlichen Hand, die zur Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten sowie den Erwerb von Grundbesitz und Anlagegegenständen verwendet werden. Fördermittel werden bis zum Investitionszeitpunkt als sonstige Verbindlichkeiten erfasst. Für Forschungs- und Entwicklungsprojekte verwendete Fördermittel werden als sonstige Erträge erfasst (491.468 Euro in 2004 und 565.947 Euro in 2003), während Fördermittel für Investitionen in das Sachanlagevermögen als Minderung der Anschaffungskosten erfasst werden.

### Mitarbeiterbeteiligung

Die Gesellschaft setzt den sich aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen ergebenden Aufwand unter Anwendung der Intrinsic-Value-Methode gemäß Accounting Principles Board Opinion Nr. 25, „Accounting for Stock Issued to Employees“ (Bilanzierung von Mitarbeiteraktien, ABP Nr. 25) an. Gemäß APB Nr. 25 wird kein Aufwand angesetzt, wenn der Ausübungspreis der Aktienoptionen den geschätzten beizulegenden Wert der zugrunde liegenden Aktien am Tag der Gewährung erreicht oder überschreitet.

### Pensionsverpflichtungen

Für Mitglieder des Vorstandes bestehen rückgedeckte Direktzusagen (Leistungsprimat), die gemäß SFAS 87 unter den Rückstellungen ausgewiesen werden. Die „projected benefit obligation“ und die „accumulated benefit obligation“ betragen zum 31. Dezember 2004 2.212.928 Euro (31.12.2003: 1.536.650 Euro). Noch nicht erfasste „prior service costs“ werden mit 475.752 Euro (2003: 539.898 Euro) beziffert. Die „additional minimum liability“ beträgt zum Stichtag 434.014 Euro. Der Rechnungszins beträgt fünf Prozent p.a. und die erwarteten Rentenanpassungen 1,5 Prozent p.a. Der in der Gewinn- und Verlustrechnung gebuchte Dienstzeitaufwand belief sich auf 83.804 Euro (2003: 93.263 Euro), der Zinsaufwand auf 76.833 Euro (2003: 86.732 Euro). Nachzuverrechnender Dienstzeitaufwand (prior service costs) ist in Höhe von

64.146 Euro in 2004 und 2003 gebucht worden. Zum 31. Dezember 2004 bestehen versicherungsmathematische Gewinne in Höhe von insgesamt 41.738 Euro, die sämtlich nicht realisiert wurden.

Das Planvermögen in Form von Rückdeckungsversicherungen wird mit den Pensionsverpflichtungen saldiert ausgewiesen und hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr wie folgt entwickelt: Zum 31. Dezember 2003 betrug das Planvermögen in Form von Rückdeckungsversicherungen 627.133 Euro, zum 31. Dezember 2004 797.881 Euro. Die Beiträge betragen in 2004 175.269 Euro. Versicherungsmathematische Verluste (nicht realisiert) betragen in 2004 4.521 Euro.

Es existieren zudem zwei beitragsorientierte Pensionspläne für Vorstandsmitglieder, für die in 2004 Beiträge in Höhe von 104.153 Euro gezahlt wurden.

#### Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Aktive beziehungsweise passive latente Steuern basieren auf zeitlichen Unterschieden zwischen handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Jahresabschlüssen. Sie werden auf Grundlage der Steuersätze und -vorschriften ermittelt, die auf Basis des gegenwärtigen Gesetzesstandes voraussichtlich zum Zeitpunkt der Aufhebung der Unterschiede gelten werden. Die Auswirkung geänderter Steuersätze auf die Bildung latenter Steuern wird in dem Geschäftsjahr erfasst, in dem die geänderten Sätze in Kraft treten.

#### Ergebnis je Stammaktie

Das unverwässerte Ergebnis je Stammaktie wird auf Grundlage der durchschnittlichen Anzahl der sich im jeweiligen Geschäftsjahr im Umlauf befindlichen Stammaktien berechnet. Das verwässerte Ergebnis je Stammaktie wird auf Grundlage der durchschnittlichen Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Stammaktien zuzüglich aller Aktienoptionen mit verwässerndem Charakter berechnet.

### 3. VORRÄTE

Die Vorräte setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2004 Euro	31.12.2003 Euro
Rohstoffe	6.958.301	6.491.767
Unfertige Erzeugnisse	11.136.905	11.335.590
Fertige Erzeugnisse und Waren	7.052.528	4.305.111
	<b>25.147.734</b>	<b>22.132.468</b>

#### 4. BETEILIGUNGEN

Die Gesellschaft ist an den folgenden Unternehmen beteiligt:

	31.12.2004 Euro	31.12.2003 Euro
MECHALESS Systems GmbH (MECHALESS) (51%ige Beteiligung zum 31. Dezember 2004)	0	78.432
attoSENSOR GmbH, Penzberg (attoSENSOR) (30%ige Beteiligung zum 31. Dezember 2004 und 31. Dezember 2003)	57.234	1
Micro Systems on Silicon (MOS) Limited, Pretoria, Südafrika (51%ige Beteiligung zum 31. Dezember 2004)	376.441	163.941
Sonstige	126.153	100.365
	<b>559.828</b>	<b>342.739</b>

##### attoSENSOR GmbH

Am 22. Mai 2001 hat die Gesellschaft eine zehnprozentige Beteiligung beziehungsweise einen Anteil von 7.669 Euro am gezeichneten Kapital der attoSENSOR GmbH, einem Entwickler und Hersteller von Sensortechnologie mit Sitz in Penzberg (Bayern), erworben. Der Gesamtkaufpreis für die Beteiligung an dieser Gesellschaft betrug 169.039 Euro. Darüber hinaus hat die Gesellschaft der attoSENSOR GmbH ein partiarisches Darlehen in Höhe von 766.938 Euro gewährt und hat dieses Darlehen zum 31. Januar 2002 um 613.550 Euro erhöht. Das Darlehen ist zinsfrei, aber der Gesellschaft stehen jährlich zwei Prozent des Gewinns der attoSENSOR GmbH zu, während sie an möglichen Verlusten nicht beteiligt ist. Das Darlehen wurde in 2004 getilgt. Daraus resultierte ein Gewinn in 2004 in Höhe von 890 Tausend Euro.

Am 8. Januar 2002 hat die Gesellschaft weitere 20 Prozent beziehungsweise einen Anteil von 15.338 Euro am gezeichneten Kapital zu einem Kaufpreis von 307.051 Euro erworben. In 2004 hat die Gesellschaft Gewinne aus der Beteiligung, die gemäß APB 18 und SFAS 94 at equity bewertet wird, in Höhe von 57.233 Euro (Verluste 2003: 247.090 Euro) verbucht.

##### Micro Systems on Silicon (MOS) Limited

Die MOS-Ltd. befindet sich derzeit noch in der Aufbauphase, ohne dass signifikantes operatives Geschäft getätigt wird. Aus diesem Grund hat die Gesellschaft bislang von einer Einbeziehung in den Konsolidierungskreis – trotz Vorliegen von Kontrolle – abgesehen.

## 5. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN UND LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN

Zum 31. Dezember 2004 standen der Gesellschaft verschiedene kurzfristige Kreditrahmen in Höhe von circa 37.340.605 Euro zur Verfügung. Per 31. Dezember 2004 hat die Gesellschaft diese Kreditfazilitäten in Höhe von 17.616.377 Euro mit einem durchschnittlichen Zinssatz von 3,64 Prozent in Anspruch genommen.

Die langfristigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

			31.12.2004 Euro	31.12.2003 Euro
<b>Deutsche Bank AG</b> , Dortmund, Darlehen EGKS	Jahreszinssatz: Zahlung: Fälligkeit:	3,75% Monatlich März 2005	555.552	1.666.664
<b>Deutsche Kreditbank AG</b> , Darlehen 6528970	Jahreszinssatz: Zahlung: Zinsen: Fälligkeit:	4,80% Monatlich Euro 0,00 Dezember 2004	0	65.000
<b>Deutsche Kreditbank AG</b> , Darlehen 6501274	Jahreszinssatz: Zahlung: Zinsen: Fälligkeit:	4,30% Monatlich Euro 6.889 Dezember 2004	0	58.454
<b>Nissan Bank</b> , Darlehen	Jahreszinssatz: Zahlung: Zinsen: Fälligkeit:	0% Monatlich Euro 0 Oktober 2006	17.124	0
<b>BMW Bank GmbH</b> , Darlehen 3107129822	Jahreszinssatz: Zahlung: Zinsen: Fälligkeit:	5,99% Monatlich Euro 1.417 März 2006	41.693	0
<b>Sparkasse Frankfurt</b> , Darlehen 88051570	Jahreszinssatz: Zahlung: Zinsen: Fälligkeit:	5,65% Monatlich Euro 47.297 Dezember 2008	733.459	776.061
<b>Finanzierungsleasing</b>			38.528.717	40.349.481
<b>Gesamt</b>			<b>39.876.545</b>	<b>42.915.660</b>
Abzüglich des Anteils mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			3.749.038	4.017.395
			<b>36.127.507</b>	<b>38.898.265</b>

Diverse darlehensfinanzierte Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens der Gesellschaft sind an verschiedene Kreditinstitute sicherungsübereignet.

Am 22. Dezember 1997 hat die Gesellschaft ihr Geschäftsgebäude (einschließlich Grundstück und Einbauten) für einen Gesamtkaufpreis von 23.008.135 Euro veräußert. Parallel zu dieser Veräußerung hat die Gesellschaft die Einbauten für einen Zeitraum von neun Jahren sowie das Grundstück und das Gebäude für einen Zeitraum von 22,5 Jahren angemietet. Im Rahmen dieses Mietvertrags ist die Gesellschaft zu jährlichen Gesamtmietzahlungen in Höhe von 1.942.772 Euro (1.121.180 Euro für Einbauten sowie 821.592 Euro für Grundstück und Gebäude) bis 2006 und in Höhe von 1.917.207 Euro (für Grundstück und Gebäude) bis 2020 verpflichtet. Da die Gesellschaft ab dem Jahr 2018 die Möglichkeit hat, das Gebäude zurück zu erwerben, wurde diese Transaktion als Finanzierungstransaktion und nicht als Veräußerung erfasst, so dass das Gebäude und die Einbauten weiterhin in den vorliegenden Konzernabschlüssen erfasst werden. Der Finanzierungsbetrag ist unter der Position Finanzierungsleasing in den langfristigen Verbindlichkeiten erfasst.

Am 7. Juli 2000 hat die Gesellschaft eine Gebäudeerweiterung (einschließlich Einbauten) zu einen Gesamtkaufpreis von 6.287.853 Euro veräußert. Parallel zu dieser Veräußerung hat die Gesellschaft die Einbauten für einen Zeitraum von 7,5 Jahren sowie das Gebäude für einen Zeitraum von 22,5 Jahren angemietet. Im Rahmen dieses Mietvertrags ist die Gesellschaft zu jährlichen Gesamtmietzahlungen in Höhe von 1.074.788 Euro bis 2007 und in Höhe von 60.872 Euro bis 2022 (für Gebäude) verpflichtet. Da die Gesellschaft ab dem Jahr 2020 die Möglichkeit hat, das Gebäude zurück zu erwerben, wurde diese Transaktion als Finanzierungstransaktion und nicht als Veräußerung erfasst, so dass das Gebäude und die Einbauten weiterhin in den vorliegenden Konzernabschlüssen erfasst werden. Der Finanzierungsbetrag ist unter der Position Finanzierungsleasing in den langfristigen Verbindlichkeiten erfasst.

Am 8. November 2001 hat die Gesellschaft ein weiteres Geschäftsgebäude und das dazugehörige Parkhaus (einschließlich Grundstück und Einbauten) zu einem Gesamtkaufpreis von 11.643.000 Euro veräußert. Parallel zu dieser Veräußerung hat die Gesellschaft die Einbauten sowie das Grundstück, die Gebäude und das Parkhaus für einen Zeitraum von 20 Jahren angemietet. Im Rahmen dieses Mietvertrags ist die Gesellschaft zu jährlichen, degressiv fallenden Gesamtmietzahlungen, beginnend mit einer Höhe von 1.016.125 Euro bis 2021 verpflichtet. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2003 erfolgte die Fertigstellung der Aufstockung des Verwaltungsgebäudes. Die Gesamtinvestitionskosten betragen 3.419.000 Euro. Die zu zahlenden

Leasingraten betragen 279.000 Euro p.a. bis 2021. Da die Gesellschaft ab dem Jahr 2021 die Möglichkeit hat, die Vermögenswerte (Gebäude, Parkhaus und Aufstockung) zurück zu erwerben, wurde diese Transaktion als Finanzierungstransaktion und nicht als Veräußerung erfasst, so dass das Gebäude und die Einbauten weiterhin in den vorliegenden Konzernabschlüssen erfasst werden. Der Finanzierungsbetrag ist unter der Position Finanzierungsleasing in den langfristigen Verbindlichkeiten erfasst.

Zinsaufwendungen für Verbindlichkeiten gegenüber Banken und langfristige Verbindlichkeiten betragen 3.851.008 Euro in 2004 und 3.829.431 Euro in 2003.

Zum 31. Dezember 2004 waren die Fälligkeiten für langfristige Verbindlichkeiten einschließlich Finanzierungsleasing wie folgt:

Fälligkeit	Euro
2005	3.749.038
2006	3.298.227
2007	2.779.174
2008	1.693.640
2009	1.631.291
Folgejahre	26.725.175
	<b>39.876.545</b>

## 6. MIET- UND LEASINGVERTRÄGE

Die Gesellschaft hat unkündbare Miet- und Leasingverträge für Fahrzeuge und Geschäftsausstattung abgeschlossen. Die Gesamtaufwendungen hierfür betragen 12.216.375 Euro in 2004 und 5.937.454 Euro in 2003. Zukünftige Mindestzahlungen aus unkündbaren Verträgen mit ursprünglichen Laufzeiten oder Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr sind zum 31. Dezember 2004 wie folgt:

### Miet- und Leasingzahlungen ohne Finanzierungsleasing

Fälligkeit	Euro
2005	13.021.953
2006	11.507.204
2007	1.575.681
2008	375.106
2009	290.517
Folgejahre	1.633.327
	<b>28.403.788</b>

## 7. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag setzen sich in Deutschland aus Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag zusammen. Die Gesellschaft hat Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 5.246.841 Euro in 2004 und in 2003 in Höhe von 10.355.900 Euro gezahlt.

Die Aufwendungen (Erträge) aus Steuern vom Einkommen und vom Ertrag setzen sich wie folgt zusammen:

	2004 Euro	2003 Euro
<b>Laufende Steueraufwendungen</b>		
Deutschland	9.051.705	5.561.662
Ausland	576.922	745.879
	<b>9.628.627</b>	<b>6.307.541</b>
<b>Latente Steuern</b>		
Deutschland	167.949	1.125.004
Ausland	- 1.091.757	- 532.468
	<b>- 923.808</b>	<b>592.536</b>
	<b>8.704.819</b>	<b>6.900.077</b>

Latente Steuern spiegeln die steuerlichen Auswirkungen aus zeitlichen Unterschieden zwischen den Buchwerten der Aktiva und Passiva in den handelsrechtlichen Abschlüssen einerseits und den in den steuerlichen Abschlüssen verwendeten Werten andererseits wider. Wesentliche Bestandteile der aktiven und passiven latenten Steuern der Gesellschaft sind im Folgenden dargestellt:

	2004 Euro	2003 Euro
<b>Aktive latente Steuern</b>		
Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.817.000	372.042
Finanzierungsleasing	2.714.885	2.659.306
Verlustvortrag	12.492.863	13.269.072
Sonstige	250.495	0
	<b>17.275.243</b>	<b>16.300.420</b>
<b>Passive latente Steuern</b>		
Anlagevermögen	1.151.186	1.465.552
Entwicklungskosten für Software	2.849.313	2.118.006
Sonstige	0	7.488
	<b>4.000.499</b>	<b>3.591.046</b>
<b>Aktive latente Steuern, netto</b>	<b>13.274.744</b>	<b>12.709.374</b>

Die Unterschiede zwischen dem gesetzlichen Nominalsteuersatz und den von der Gesellschaft tatsächlich zu zahlenden Steuern vom Einkommen und vom Ertrag stellen sich wie folgt dar:

	2004 Prozent	2003 Prozent
Gesetzlicher Nominalsteuersatz	39,90	41,40
Steuerlich nicht abzugsfähige Abschreibungen auf Beteiligungen	0,00	0,60
Nicht abzugsfähige Aufwendungen	0,40	0,40
Dividenden auf Beteiligungen an Kapitalgesellschaften	-3,90	-0,50
Unterschiedsbetrag aus ausländischen Steuersätzen	-1,60	-1,61
Sonstige	0,00	0,50
<b>Effektiver Steuersatz</b>	<b>34,80</b>	<b>40,79</b>

## 8. GRUNDKAPITAL

Das Grundkapital der Gesellschaft besteht zum 31. Dezember 2004 und zum 31. Dezember 2003 aus 19.300.000 Aktien (ausschließlich Stammaktien).

## 9. AKTIENOPTIENSPROGRAMM

Die Gesellschaft hat ein Aktienoptionsprogramm für Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und Mitarbeiter. Ziel dieses Programms ist es, den Erfolg des Unternehmens dadurch zu sichern, dass die Mitarbeiter Aktien der Gesellschaft erwerben können. Im Rahmen des Programms ist die Gesellschaft zur Gewährung von 1.000.000 neuen Stückaktien berechtigt, von denen im Geschäftsjahr 1999 bereits 116.525 im Rahmen einer ersten Tranche gewährt wurden.

Der Ausübungspreis entspricht 120 Prozent des durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft an den zehn Handelstagen vor dem Vorstandsbeschluss über die Ausgabe und die Festlegung der Einzelheiten der jeweiligen Tranche. Die Optionen können nur ausgeübt werden, wenn der Schlusskurs der Aktien der Gesellschaft den Ausübungspreis erreicht oder ihn übersteigt. Die Optionen können bei ununterbrochener Betriebszugehörigkeit drei Jahre beziehungsweise zwei Jahre (dritte und vierte Tranche) nach ihrer Gewährung ausgeübt werden und erlöschen nach sechs beziehungsweise fünf (dritte und vierte Tranche) Jahren.

Zum 31. Dezember 2004 waren 100.022 (31.12.2003: 102.222) ausübhbare Optionen zu einem Ausübungspreis von 34,89 Euro aus einer ersten Ausgabebtranche im Umlauf. Aus einer zweiten Ausgabebtranche waren 127.575 (2003: 129.775) ausübhbare Optionen zu einem Ausübungspreis von 35,14 Euro im Umlauf. Aus der im Dezember 2002 gewährten dritten Ausgabebtranche zum Ausgabepreis von 7,87 Euro waren zum Stichtag noch 279.891 Optionen (31.12.2003: 286.160) im Umlauf, die noch nicht ausübbar waren. Die vierte Ausgabebtranche wurde im Dezember 2003 zum Ausgabepreis von 11,59 Euro gewährt. Zum Stichtag waren aus dieser Tranche noch 295.722 Optionen im Umlauf, die ebenfalls noch nicht ausübbar waren.

Im Geschäftsjahr 2004 sind 2.200 (2003: 1.003) Optionen aus der ersten Tranche, aus der zweiten Tranche ebenfalls 2.200 und aus der dritten Tranche 6.269 Optionen verfallen. Es wurden weder in 2004 noch in 2003 Optionen ausgeübt.

Die Bilanzierung für das Aktienoptionsprogramm erfolgt gemäß Accounting Principles Board Opinion Nr. 25 (APB Nr. 25). Gemäß APB Nr. 25 wurde für die ersten beiden Tranchen kein Aufwand für das Aktienoptionsprogramm in den Konzern-Gewinn- und Verlustrechnungen angesetzt. Für die dritte und vierte Tranche ergab sich ein Aufwand in Höhe 201.600 Euro in 2004, der in die Kapitalrücklage eingestellt wurde.

Das „als-ob-Ergebnis“, das unter der Annahme erstellt wurde, dass die Bilanzierung auf Grundlage des beizulegenden Werts gemäß Statement of Financial Accounting Standards Nr. 123 „Accounting for Stock-Based Compensation“ (Bilanzierung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen) erfolgt, stellt sich wie folgt dar:

#### Als-ob-Ergebnis

	2004 Euro	2003 Euro
Jahresüberschuss*	15.610.101	9.345.052
<b>Jahresüberschuss* je Stammaktie</b>		
Unverwässert	0,81	0,48
Voll verwässert	0,80	0,48

\*Unter Berücksichtigung SFAS 123

Der durchschnittliche beizulegende Wert der Aktienoptionen betrug 14,23 Euro für die erste und zweite Tranche, 4,40 Euro für die dritte Tranche und 5,07 Euro für die vierte Tranche. Der beizulegende Wert am Tag der Gewährung wurde unter Anwendung der Black-Scholes-Methode zur Optionspreisberechnung auf Grundlage der folgenden Annahmen ermittelt:

#### Annahmen zur Ermittlung des beizulegenden Werts

	Tranche 1+2	Tranche 3	Tranche 4
Dividendenertrag	1,4%	2,0%	2,0%
Erwartete Volatilität	61,7	59,1	59,1
Risikoloser Zinssatz zum Gewährungszeitpunkt	6%	5,5%	5,5%
Erwartete Laufzeit in Jahren	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre

Da die Gewährung weiterer Aktienoptionen in Folgejahren zu erwarten ist, lassen die oben genannten Als-ob-Werte keine Rückschlüsse auf die zukünftigen Beträge zu.

#### 10. ERGEBNIS JE STAMMAKTIE

Das verwässerte und unverwässerte Ergebnis je Stammaktie wurde wie folgt ermittelt:

##### Abstimmung der Aktien

	2004	2003
Durchschnittliche Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Stammaktien	19.300.000	19.300.000
Aktienoptionen mit verwässerndem Charakter*	132.619	12.569
<b>Durchschnittliche Anzahl der sich im Umlauf befindlichen Stammaktien einschließlich Verwässerungseffekt</b>	<b>19.432.619</b>	<b>19.312.569</b>

\* berechnet nach der treasury stock Methode gemäß SFAS 128

#### 11. KUMULIERTE ERFOLGSNEUTRALE VERÄNDERUNGEN DES EIGENKAPITALS

Die Position setzt sich aus erfolgsneutralen Nettoveränderungen (einschließlich Nettoerlösen) des Eigenkapitals zusammen, die nicht aus Transaktionen und Geschäftsvorfällen mit Gesellschaftern resultieren. Bei ELMOS setzen sich die erfolgsneutralen Veränderungen des Eigenkapitals im Wesentlichen aus Fremdwährungsanpassungen sowie nicht realisierten Gewinnen beziehungsweise Verlusten aus den zur Veräußerung stehenden Wertpapieren des Umlaufvermögens zusammen.

Die kumulierten erfolgsneutralen Veränderungen des Eigenkapitals stellen sich wie folgt dar:

	2004 Euro	2003 Euro
Fremdwährungsanpassungen	– 2.989.936	– 1.507.480
Nicht realisierte Gewinne aus zur Veräußerung stehenden Wertpapieren des Umlaufvermögens nach Steuern	– 8.091.464	– 7.105.949
<b>Erfolgsneutrale Veränderungen des Eigenkapitals</b>	<b>– 11.081.400</b>	<b>– 8.613.429</b>

## 12. SEGMENTINFORMATIONEN UND GEOGRAPHISCHE DATEN

Die Gesellschaft teilt ihre Aktivitäten in drei Bereiche ein. Das Halbleitergeschäft wird über die verschiedenen Länderniederlassungen in Deutschland, Frankreich und USA abgewickelt. Umsatzerlöse im Mikromechanik-Sensorbereich erwirtschaftet die Tochtergesellschaft SMI in den USA. Schließlich werden Drittumsatzerlöse im Assembly-Bereich bei eurasem erzielt.

	Halbleiter Tausend Euro	Mikromechanik Tausend Euro	Assembly Tausend Euro	Gesamt Tausend Euro
<b>Umsatzerlöse, netto</b>	<b>130.709</b>	<b>9.054</b>	<b>3.546</b>	<b>143.309</b>
Herstellungskosten	61.847	5.399	2.509	69.755
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>	<b>68.862</b>	<b>3.655</b>	<b>1.037</b>	<b>73.554</b>
Betriebsergebnis	27.080	782	1.689	29.551
Umsatzerlöse mit anderen Segmenten	—	598	11.028	11.626
Gesamtvermögen	160.513	24.501	34.767	219.781
Investitionen in das Anlagevermögen	26.653	1.459	5.438	33.550
Abschreibungen	10.002	688	2.005	12.695

Der Gesamtumsatz mit anderen als den verbundenen Unternehmen entwickelte sich – unterteilt in geographische Regionen – in den Geschäftsjahren 2004 und 2003 wie folgt:

	2004 Tausend Euro	2003 Tausend Euro
Deutschland	76.864	67.290
EU-Länder	36.736	29.389
USA	19.355	17.921
Sonstige	10.354	6.795
<b>Gesamt</b>	<b>143.309</b>	<b>121.395</b>

Zum 31. Dezember 2004 belief sich das bei den Tochtergesellschaften in den Niederlanden erfasste Vermögen auf 36.961 Tausend Euro, das bei den Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika erfasste Vermögen auf 28.655 Tausend Euro und das bei den Tochtergesellschaften in anderen EU-Ländern erfasste Vermögen auf 10.243 Tausend Euro. Das Vermögen betrug in Deutschland 143.922 Tausend Euro.

### 13. MITARBEITER

Im Geschäftsjahr 2004 betrug die durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter im Konzern 928 (2003: 874).

### 14. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Am 29. Juni 2001 veröffentlichte das U.S. Financial Accounting Standards Board die Statements Nr. 141, „Business Combinations“ und Nr. 142 „Goodwill and Other Intangible Assets“. Statement Nr. 141 änderte die Kriterien zur Unterscheidung immaterieller Vermögensgegenstände vom Geschäfts- oder Firmenwert. Gemäß Statement Nr. 142, werden der Geschäfts- oder Firmenwert sowie immaterielle Vermögensgegenstände mit einer unbestimmten Nutzungsdauer nicht mehr planmäßig abgeschrieben, sondern jährlich, beziehungsweise beim Vorliegen von Hinweisen für eine entsprechende Notwendigkeit häufiger, auf eine außerplanmäßige Abschreibung hin überprüft.

Die Gesellschaft wendete diese Verlautbarung während des am 31. Dezember 2004 endenden Geschäftsjahres an. Die Anwendung der Verlautbarung führte dazu, dass keine planmäßigen Abschreibungen auf den Geschäfts- und Firmenwert vorgenommen wurden. Darüber hinaus wurde in 2004 eine Prüfung bezüglich der Notwendigkeit außerplanmäßiger Abschreibungen vorgenommen, die keinen entsprechenden Wertberichtigungsbedarf ergab. Die Gesellschaft weist per 31. Dezember 2004 beziehungsweise per 31. Dezember 2003 einen Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 8.314.399 Euro beziehungsweise 7.622.344 Euro aus.

## 15. AKQUISITIONEN

### **European Semiconductor Assembly (eurasem) B.V.**

Am 8. Januar 2001 hat die Gesellschaft einen Anteil von 95,84 Prozent beziehungsweise 8.658.365 Aktien der European Semiconductor Assembly (eurasem) B.V., einer Assemblierungsfirma für Halbleiter mit Sitz in Nijmegen, Niederlande, erworben. eurasem hat in 2003 beziehungsweise 2004 die restlichen verbliebenen Anteile von 2,66 Prozent beziehungsweise 1,5 Prozent, die sich noch im Streubesitz befanden, zurückerworben und auf die Gesellschaft übertragen. Der Gesamtkaufpreis für 100 Prozent des Anteils betrug 12.000.000 niederländische Gulden (5,45 Millionen Euro). Das Finanzergebnis und die Bilanz von eurasem wurden in die Konzernabschlüsse der Gesellschaft zum 31. Dezember 2001 aufgenommen. Die Gesellschaft hat die wirtschaftlichen Aktivitäten von eurasem für das gesamte Geschäftsjahr in ihre Gewinn- und Verlustrechnung übernommen. Aus dieser Akquisition ergab sich ein Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 137 Tausend Euro, der aus der Übernahme der restlichen Minderheitenanteile in 2004 resultierte.

## 16. BEZÜGE DER LEITUNGSORGANE

## Bezüge des Vorstands und des Aufsichtsrates für 2004

	Fixe Bezüge Euro	Variable Bezüge Euro	Aktien- optionen Stück
Vorstand	897.000	435.000	60.000
Aufsichtsrat	89.000*	128.000	0

\* inkl. Spesen und Auslagen

Am 31. Dezember 2004 besaßen folgende Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat Aktien von ELMOS:

**Vorstand**

Reinhard Senf	1.948 Aktien
Dr. Peter Thoma	7.200 Aktien
Dr. Klaus Weyer	10.000 Aktien

**Aufsichtsrat**

Dr. Burkhard Dreher	1.900 Aktien
Herbert Sporea	2.265 Aktien

Folgende meldepflichtige Wertpapiergeschäfte fanden in 2004 statt:

- ▶ Dr. Klaus Weyer  
Verkauf von 5.040 Aktien zu 13,81 Euro am 28. September 2004 und von 1.166 Aktien zu 13,84 Euro am 29. September 2004
- ▶ Elke Zimmer (Ehefrau von Prof. Dr. Günter Zimmer)  
Kauf von 1.407 Aktien zu 13,07 Euro und von 593 Aktien zu 13,08 Euro am 12. November 2004
- ▶ Dr. Peter Thoma  
Kauf von 1.000 Aktien zu 12,96 Euro am 30. November 2004

## 17. ERKLÄRUNG GEMÄSS § 161 AKTG ZUM CORPORATE-GOVERNANCE-KODEX

Die ELMOS Semiconductor AG hat für 2004 die nach § 161 AktG vorgeschriebene Erklärung abgegeben und den Aktionären zugänglich gemacht. Vorstand und Aufsichtsrat der ELMOS Semiconductor AG erklären gemäß § 161 AktG:

„Die ELMOS Semiconductor AG entspricht den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ (kurz: DCKG) in der Fassung vom 21. Mai 2003 mit folgenden Ausnahmen:

- ▶ Die derzeit gültige D&O-Versicherung für Aufsichtsrat und Vorstand sieht keinen Selbstbehalt für die Organmitglieder vor (DCKG Nr. 3.8). Vor dem Hintergrund der unklaren Rechtslage hinsichtlich der persönlichen Haftung eines einzelnen Organmitglieds wird eine Anpassung der Versicherung zur Zeit nicht vorgenommen.
- ▶ Für bereits ausgegebene Aktienoptionen ist keine Begrenzung („Cap“) bei der Vergütung des Vorstands für Aktienoptionen bei außerordentlichen, nicht vorhersehbaren Entwicklungen möglich (DCGK Nr. 4.2.3). Der Aufsichtsrat wird aber ab dem Januar 2004 Aktienoptionen an Vorstandsmitglieder nur noch mit einem Cap ausgeben.
- ▶ Obgleich die Vergütung der Vorstandsmitglieder sowohl im Internet wie auch im Geschäftsbericht aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung (Aktienoptionen) ausgewiesen werden, erfolgen diese Angaben summiert und nicht individualisiert (DCGK 4.2.4).
- ▶ Abweichend von den Empfehlungen sieht die Geschäftsordnung des Aufsichtsrates der ELMOS Semiconductor AG die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschüssen und eines Prüfungsausschusses erst ab einer Anzahl von mehr als sechs Aufsichtsratsmitgliedern vor (DCGK Nr. 5.3.1 und 5.3.2).
- ▶ Auch die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben einer festen eine erfolgsorientierte Vergütung. Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird, aufgliedert nach ihren Bestandteilen, sowohl im Internet wie auch im Geschäftsbericht aufgeführt, jedoch nicht individualisiert. Die von der ELMOS Semiconductor AG an die Mitglieder des Aufsichtsrates gezahlten Vergütungen für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere für Beratungs- und Vermittlungsleistungen, werden nicht individualisiert im Anhang zum Konzernabschluss angegeben (DCGK Nr. 5.4.5).“

Dortmund, im Februar 2005

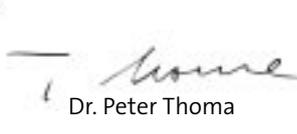
Der Vorstand



Knüt Hinrichs



Dr. Klaus Weyer



Dr. Peter Thoma



Reinhard Senf

## ENTWICKLUNG DES KONZERNANLAGEVERMÖGENS

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN					31. Dez. 2004
	1. Jan. 2004	Fremd- währungs- anpassung	Zugänge*	Umbuchungen	Abgänge	
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
Geschäfts- oder Firmenwert	7.757.079	0	692.055	0	0	8.449.134
Software	21.500.510	- 96.399	3.789.092	4.909.553	- 126.347	29.976.409
Software (Anlagen im Bau)	7.215.231	0	2.456.019	- 4.509.553	0	5.161.697
	<b>36.472.820</b>	<b>- 96.399</b>	<b>6.937.166</b>	<b>400.000</b>	<b>- 126.347</b>	<b>43.587.240</b>
<b>Sachanlagen</b>						
<b>1. Grund und Boden</b>	<b>66.751.283</b>	<b>- 640.924</b>	<b>2.982.605</b>	<b>1.217.778</b>	<b>- 67.480</b>	<b>70.243.262</b>
Grundstücke	6.565.486	- 131.131	768.521	0	0	7.202.876
Gebäude und Einbauten	60.185.797	- 509.793	2.214.084	1.217.778	- 67.480	63.040.386
<b>2. Technische Anlagen und Maschinen</b>	<b>96.317.333</b>	<b>- 317.687</b>	<b>9.899.762</b>	<b>3.825.018</b>	<b>- 1.732.293</b>	<b>107.992.133</b>
Technische Anlagen und Maschinen	96.317.333	- 317.687	9.899.762	3.825.018	- 1.732.293	107.992.133
<b>3. Anlagen im Bau</b>	<b>6.219.503</b>	<b>0</b>	<b>13.997.213</b>	<b>- 5.442.796</b>	<b>- 519.931</b>	<b>14.253.989</b>
Anlagen im Bau	6.219.503	0	13.997.213	- 5.442.796	- 519.931	14.253.989
	<b>169.288.119</b>	<b>- 958.611</b>	<b>26.879.580</b>	<b>- 400.000</b>	<b>- 2.319.704</b>	<b>192.489.384</b>
<b>Summe</b>	<b>205.760.939</b>	<b>- 1.055.010</b>	<b>33.816.746</b>	<b>0</b>	<b>- 2.446.051</b>	<b>236.076.624</b>

\* Davon Veränderungen im Konsolidierungskreis von 266.826 Euro

\*\* Davon Veränderungen im Konsolidierungskreis von 121.821 Euro

Jahresabschluss  
 ► Konzernanhang  
 Bestätigungsvermerk

## KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN

1. Jan. 2004	Fremd- währungs- anpassung	Zugänge**	Zuschreibung	Umbuchungen	Abgänge	31. Dez. 2004	Buchwerte 31. Dez. 2004
134.735	0	0	0	0	0	134.735	8.314.399
7.445.770	-15.195	1.919.359	0	0	-69.359	9.280.575	20.695.834
0	0	0	0	0	0	0	5.161.697
7.580.505	-15.195	1.919.359	0	0	-69.359	9.415.310	34.171.930
21.309.639	-10.548	3.626.234	-615.495	6.198	0	24.316.028	45.927.234
612.702	0	0	0	0	0	612.702	6.590.174
20.696.937	-10.548	3.626.234	-615.495	6.198	0	23.703.326	39.337.060
67.917.323	-83.008	7.886.661	0	-6.198	-1.670.063	74.044.715	33.947.418
67.917.323	-83.008	7.886.661	0	-6.198	-1.670.063	74.044.715	33.947.418
0	0	0	0	0	0	0	14.253.989
0	0	0	0	0	0	0	14.253.989
89.226.962	-93.556	11.512.895	-615.495	0	-1.670.063	98.360.743	94.128.641
96.807.467	-108.751	13.432.254	-615.495	0	-1.739.422	107.776.053	128.300.571

## ► Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

---

Zu dem Konzernabschluss und dem Konzernlagebericht haben wir folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den von der ELMOS Semiconductor AG, Dortmund, aufgestellten Konzernabschluss, bestehend aus Konzernbilanz, Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung, Konzern-Kapitalflussrechnung und Konzernanhang, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 geprüft. Aufstellung und Inhalt des Konzernabschlusses liegen in der Verantwortung des Vorstands der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung zu beurteilen, ob der Konzernabschluss den United States-Generally Accepted Accounting Principles (US-GAAP) entspricht.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach den deutschen Prüfungsvorschriften und unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob der Konzernabschluss frei von wesentlichen Fehlaussagen ist. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Wertansätze und Angaben im Konzernabschluss auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung beinhaltet die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Konzernabschluss in Übereinstimmung mit den US-GAAP ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns sowie der Zahlungsströme des Geschäftsjahres.

Unsere Prüfung, die sich auch auf den vom Vorstand für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 aufgestellten Konzernlagebericht erstreckt hat, hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach unserer Überzeugung gibt der Konzernlagebericht zusammen mit den übrigen Angaben des Konzernabschlusses insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Konzerns und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Außerdem bestätigen wir, dass der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004 die Voraussetzungen für eine Befreiung der Gesellschaft von der Aufstellung eines Konzernabschlusses und Konzernlageberichts nach deutschem Recht erfüllen.“

Dortmund, 11. Februar 2005

Ernst & Young AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Brorhilker  
Wirtschaftsprüfer

Muzzu  
Wirtschaftsprüfer

## KONZERNSTRUKTUR

## ► Organe des Unternehmens

## VORSTAND

**Knut S. Hinrichs, Vorsitzender**

Geboren 1944 | Geschäftsführer seit 1987 |  
Mitglied des Vorstands seit 1999 | Vorsitz  
seit 2001 | bestellt bis 2009

## Mandate:

- Mitglied im Bezirksbeirat der  
Deutsche Bank AG, Essen
- Mitglied im MST Projektbeirat  
Dortmund

† verstorben am 1. März 2005

**Dr. rer. nat. Klaus G. Weyer**

Geboren 1948 | Mitbegründer des Unter-  
nehmens | Geschäftsführer seit 1984 |  
Mitglied des Vorstands seit 1999 | bestellt  
bis 2009

## Mandate:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Paragon AG
- Mitglied im IHK Industrieausschuss und  
der IHK Vollversammlung
- Beiratsmitglied Mikroelektronik-  
Verbund FhG

**Dr. rer. nat. Peter Thoma**

Geboren 1945 | Mitglied des Vorstands seit  
2000 | bestellt bis 2005

## Mandate:

- Mitglied im Technischen Beirat von  
Behr GmbH & Co. KG
- Mitglied im Beirat von Kromberg &  
Schubert GmbH & Co. KG

**Reinhard Senf**

Geboren 1951 | Mitglied des Vorstands seit  
2001 | bestellt bis 2006

## AUFSICHTSRAT

### **Prof. Dr. Günter Zimmer, Vorsitzender**

Institutsleiter FhG | Duisburg

#### Mandate:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Wacker Siltronic AG
- Mitglied im Aufsichtsrat der active photonics AG

### **Dr. Burkhard Dreher**

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats | Dipl.-Volkswirt | Dortmund

#### Mandate:

- Mitglied im Aufsichtsrat der Deutsche Steinkohle AG (bis 24. Mai 2004)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Siepe AG (bis 16. November 2004)
- Mitglied im Aufsichtsrat der EKO Stahl GmbH (ab 22. Juni 2004)
- Mitglied im Aufsichtsrat der Harpen AG

### **Dr. Wolfgang Heinke**

Diplom-Physiker | Reutlingen

### **Dr. Roland Mecklinger**

Diplom-Ingenieur | Steinfeld-Hausen

### **Dr. Karl-Thomas Neumann**

Diplom-Ingenieur | Meine

#### Mandate:

- Mitglied im Aufsichtsrat der SupplyOn AG

### **Herbert Sporea**

Kaufmann | Altwittenbek

#### Mandate:

- Mitglied im Aufsichtsrat der TOP Business AG (bis 31. Juli 2004)
- Mitglied im Beirat der MECHALESS Systems GmbH

## ► Ausgewählte Beteiligungen

### Wesentliche Konzernunternehmen und Beteiligungen

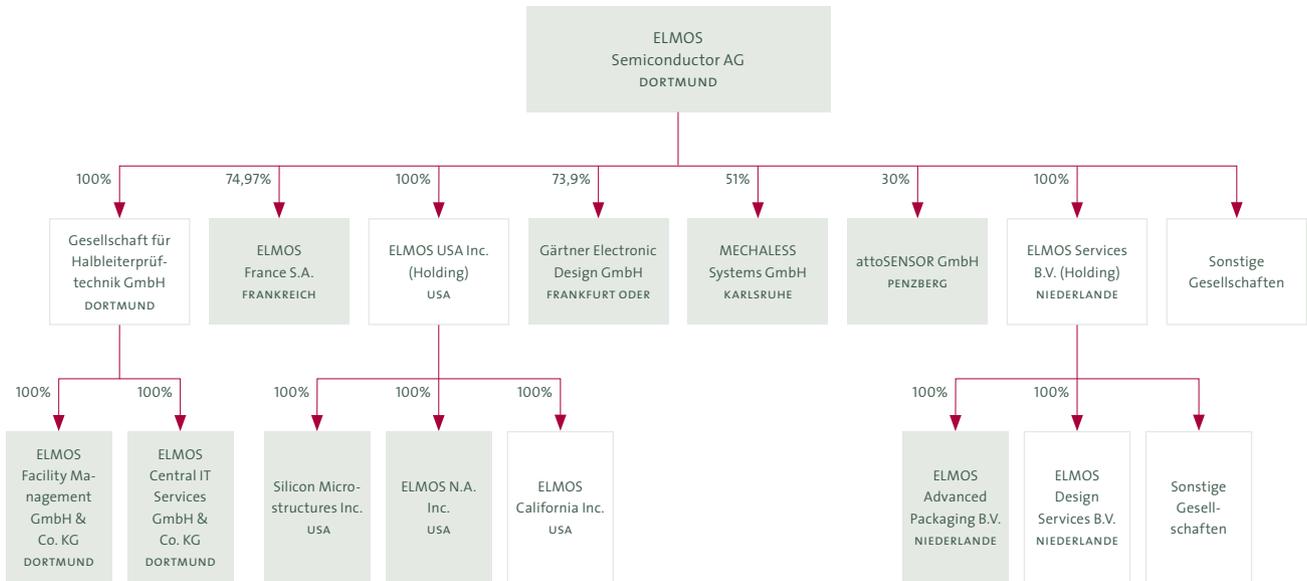
Inland	Ort	Beteiligung Prozent	Währung	Eigenkapital Tausend	Ergebnis Tausend
Advanced Appliances Chips GmbH**	Riedstadt	33,33	Euro	—	—
attoSENSOR GmbH	Penzberg	30,00	Euro	97,6	1.287,1
ELMOS Central IT Services GmbH & Co. KG	Dortmund	100,00*	Euro	173,0	54,8*
ELMOS Facility Management GmbH & Co. KG	Dortmund	100,00*	Euro	92,2	91,1*
ELMOS Semiconductor Süd GmbH	Unterschleißheim	100,00*	Euro	187,5	17,9
Epigone Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG	Mainz	100,00	Euro	16,7	2,5
Exedra Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietungs KG	Mainz	94,00	Euro	0,8	– 5,6
GED Gärtner Electronic Design GmbH	Frankfurt / Oder	73,90	Euro	345,2	56,3
Gesellschaft für Halbleiterprüftechnik mbH**	Dortmund	100,00	Euro	—	—
MECHALESS Systems GmbH	Karlsruhe	51,00	Euro	343,1	240,9

Ausland	Ort / Land	Beteiligung Prozent	Währung	Eigenkapital Tausend	Ergebnis Tausend
ELMOS Advanced Packaging B.V.	Nijmegen / Niederlande	100,00*	Euro	17,8	– 0,2
ELMOS California, Inc.	Milpitas / Kalifornien / USA	100,00*	USD	133,9	63,0
ELMOS Design Services B.V.	Nijmegen / Niederlande	100,00*	Euro	– 425,4	– 461,0
ELMOS France S.A.	Nanterre / France	74,97	Euro	2.182,5	1.082,1
ELMOS N.A., Inc.	Farmington Hills / Michigan / USA	100,00*	USD	– 3.586,5	– 940,2
ELMOS Services B.V.	Nijmegen / Niederlande	100,00	Euro	73.137,6	27.977,4
ELMOS Quality Services B.V.	Nijmegen / Niederlande	100,00*	Euro	4.553,1	14.872,6
ELMOS USA, Inc.**	Farmington Hills / Michigan / USA	100,00	USD	—	—
European Semiconductor Assembly (eurasem) B.V.	Nijmegen / Niederlande	100,00*	Euro	31.548,0	20.050,9
Micro Systems on Silicon (MOS) Limited**	Pretoria / Südafrika	51,00*	Rand	—	—
Silicon Microstructures, Inc. (SMI)	Milpitas / Kalifornien / USA	100,00*	USD	4.212,3	93,5

\* Es handelt sich um mittelbaren Anteilsbesitz der ELMOS Semiconductor AG \*\* Daten des Geschäftsjahrs 2003

- Organe des Unternehmens
- Ausgewählte Beteiligungen
- Organisationsstruktur

## ► Organisationsstruktur



## GLOSSAR

### ANALOG

Die Darstellung einer physikalischen Größe heißt analog, wenn sie kontinuierlich durch eine andere Größe erfolgt.

### ASSEMBLY

Bezeichnet die Weiterverarbeitung der Wafer zu einem verpackten Chip.

### ASIC

Ein Application Specific Integrated Circuit (anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis) ist individuell für eine spezifische Anwendung entwickelter Schaltkreis im Gegensatz zu Standardbauelementen, die nicht kundenspezifisch konfiguriert sind, zum Beispiel Spannungsregler, Speicher, Prozessoren.

### ASSP

Ein ASSP (application specific standard product) ist ein anwendungsspezifischer integrierter Schaltkreis, der individuell für eine spezifische Anwendung entwickelt wurde und nun an mehrere Kunden als Standardprodukt vermarktet wird.

### BACKEND-FERTIGUNG

Die Backend-Fertigung ist der Teil des Halbleiterherstellungsprozesses, der durchgeführt wird, nachdem der Wafer den Reinraum verlassen hat. Zu diesem Vorgang gehören die Überprüfung der Chips auf dem Wafer, Burn-in, Verpackung (Tape) und der funktionale Test der assemblierten Bausteine.

### BCD

BCD (Bipolar CMOS DMOS) verknüpft die Basiselemente der Bipolar, CMOS und DMOS (double-diffused MOS) Prozesstechnologien zu einer komplexen und universellen Halbleitertechnologie.

### BURN-IN

Eine Methode zur künstlichen Alterung von elektronischen Schaltungen und Bauelementen, um Frühausfälle zu entdecken.

### BUS

Ein gemeinsam genutztes Kommunikationssystem, welches den Austausch von elektronischen oder optischen Informationen erlaubt.

### CAN

Der CAN-BUS (Controller Area Network) ist ein ereignisgesteuertes Kommunikationssystem mit einer Übertragungsrate bis zu 1Mbit/s. Es ist das derzeit am meisten eingesetzte Fahrzeugnetzwerk.

### CHIP

Ein elektronischer Schaltkreis, der in Halbleitermaterial realisierte elektrische Funktionen beinhaltet.

### CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor (komplementäre Metall-Oxid-Halbleiter) ist die Basistechnologie zur Herstellung von Mikrochips mit hohem Integrationsgrad und geringem Energieverbrauch.

### DC-DC (GLEICHSTROM ZU GLEICHSTROM)

Eine Baugruppe, ein Gerät oder eine Einrichtung zur Umwandlung elektrischer Ströme und Spannungen von einem Eingangsniveau in ein Ausgangsniveau.

### DSC

Die Dynamic Stability Control (dynamische Stabilitätskontrolle) korrigiert entstehende Schleuderbewegungen eines Fahrzeugs, zum Beispiel auf rutschiger Fahrbahn.

#### DIGITAL

Digitale Signale werden aus stufenförmigen, quantisierten, diskreten Einzelschritten, z.B. binär (Nullen und Einsen) zusammengesetzt.

#### DRAM

Dynamic Random Access Memory (Dynamischer, im Zugriff frei wählbarer Speicher) ist der am häufigsten eingesetzte Speichertyp in Computern. DRAM-Bausteine verlieren ihren Dateninhalt, wenn der Strom abgeschaltet wird.

#### DREHRATEN-SENSOR

Drehrate-Sensoren sind mechanisch oder mikromechanisch aufgebaute Sensoren, die unter Analyse der Corioliskraft Dreh- und Schlingerbewegungen erkennen können, beispielsweise von Kraftfahrzeugen oder Flugzeugen.

#### ELEKTRONISCHER SCHALTSTREIFEN

Ein Zusammenschluss verschiedener elektrischer Komponenten, die eine bestimmte Funktion in einem elektrischen System übernehmen.

#### FRONTEND-FERTIGUNG

Herstellen der elektronischen Schaltungen auf Silizium-Wafern mittels physikalischer und chemischer Bearbeitungsverfahren unter Reinraumbedingungen.

#### ESP

Elektronisches Stabilitätsprogramm, siehe DSC.

#### FLASH

Flash-Speicher lassen sich frei adressierbar beschreiben wie RAM-Speicher. Allerdings verliert der Flash-Speicher bei Stromabschaltung nicht die Informationen.

#### FLEXRAY

FlexRay ist der zukünftige Vernetzungsstandard für Applikationen mit hohen Anforderungen. Es unterstützt aktive und passive Sicherheitssysteme sowie synchrone und asynchrone Datenübertragung mit Geschwindigkeiten bis zu 10Mbit/s.

#### FOUNDRY

Eine Halbleiterfertigung, deren primäres Geschäftsziel die Herstellung und der Verkauf von prozessierten Silizium-Wafern ist.

#### GPS

Das Global Positioning System ist ein Satelliten-gestütztes System zur Bestimmung von terrestrischen Positionen. Die Auswertung der Laufzeitdifferenzen mindestens dreier unabhängiger Funksignale kann zur Positionsbestimmung genutzt werden.

#### GYRO

Abkürzung für Gyroscope, siehe Drehrate-Sensor.

#### HALBLEITER

Ein Festkörpermateriale (z. B. aus Silizium oder Germanium), das physikalisch modifiziert seine elektrischen Eigenschaften ändern kann. Durch gezieltes Dotieren des Materials, in der Regel mit Bor oder Phosphor, kann man die elektronischen Eigenschaften verändern.

#### HALIOS®

HALIOS® (High Ambient Light Independent Optical System) kennzeichnet sich aus durch die Erfassung von dreidimensionalen Bewegungen. Optische Fremdeinflüsse, wie z.B. starker Lichteinfall, beeinflussen die Leistung nicht. Die elektronische Kompensierung von Fremdlichteinflüssen ist die technisch ausschlaggebende Funktion.

#### INTEGRIERTE SCHALTUNG, IC

Eine elektronische Schaltung, die aus verschiedenen, miniaturisierten elektronischen Bauelementen besteht (z. B. Widerstände, Kondensatoren, Transistoren etc.), welche in einem Halbleitermaterial integriert wurden.

#### INTERFACE

Bestimmt die Schnittstelle zwischen verschiedenen Systemen und kontrolliert die Verbindung, die Aktionen und den Transfer von Informationen zwischen den Teilsystemen.

#### JEDEC

Joint Electron Devices Engineering Council ist das Standardisierungsgremium für elektronische Gehäusebauformen.

#### LAYOUT

Beschreibt mit einfachen geometrischen Formen die zur Herstellung von integrierten Schaltungen benötigten Informationen aus der Schaltungsentwicklung.

#### LCD

Liquid Crystal Display (Flüssigkristallanzeige) ist eine stromsparende Anzeige von Informationen, z.B. beim Mobiltelefon.

#### LED

Eine Light Emitting Diode (Leuchtdiode) ist eine Halbleiter-Diode, die aufgrund eines elektrischen Stroms Licht aussendet.

#### LIN

Der LIN-BUS (Local Interconnect Network) ist ein Kommunikationsnetzwerk im Fahrzeugen. Es verbindet insbesondere Komfortapplikationen mit einer Bandbreite bis zu 20Kbit/s.

#### LOGIK

Eine Ansammlung von Transistoren und anderen Bauelementen in einem Schaltkreis, die Boolesche Logikoperationen darstellen, wie z.B. UND, ODER, NICHT, WENN usw.

#### MEMS

Mikro-Elektronische-Mechanische Systeme.

#### MIKROMETER

Ein  $\mu\text{m}$  ist der einmillionste Teil eines Meters.

#### MIKROPROZESSOR/MIKROKONTROLLER

Eine integrierte, komplexe elektronische Einheit, die ein elektronisches System kontrolliert und betreibt. Mikroprozessoren sind die zentralen Gehirne eines elektronischen Systems, wie z.B. dem Computer.

#### MIXED-SIGNAL

Eine Kombination von analogen und digitalen Signalen, die gleichzeitig auf ein und demselben Chip generiert, kontrolliert oder modifiziert werden.

#### MOS

Metal-Oxide-Semiconductor (Metall-Oxid-Halbleiter) beschreibt den Aufbau des zentralen Kontrollelements für den Feldeffekt in einer speziellen Klasse von Halbleitertransistoren.

#### MOST-PROTOKOLL

Das MOST-Protokoll ist ein Vernetzungsstandard für Produkte, die eine hohe Daten-Bandbreite benötigen. Insbesondere verbindet der Standard Infotainment- und Telematik-Applikationen.

**OEM**

Original Equipment Manufacturer (Erstausrüster oder Zulieferer) ist ein Hersteller, der (Teil-) Systeme an einen Wiederverkäufer vertreibt. In der Automobilindustrie bezeichnet OEM die Fahrzeughersteller.

**PPM**

parts per million (eins aus einer Million)

**REINRAUM**

Ein abgeschlossener Gebäudebereich, in dem die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur und die Verunreinigungen durch Staubpartikel sehr genau eingehalten und kontrolliert werden.

**SENSOR**

Eine elektrische Baugruppe, die eine reale physikalische Größe, z.B. Bewegung, Hitze oder Licht misst oder erkennt und anschließend in ein analoges oder digitales elektrisches Signal umwandelt.

**SILIZIUM, SI**

Das am häufigsten benutzte Halbleitermaterial, welches für etwa 95 Prozent aller hergestellten Chips eingesetzt wird.

**SMART-POWER**

Symbolisiert den intelligenten Einsatz höherer Spannungen und Ströme in einer elektrischen Schaltung. Bei Smart-Power können Spannungen bis zu einigen 100V sowie die Ströme bis zu einigen 10A auf dem Chip realisiert werden.

**SOI**

Silicon-on-Insulator (Silizium auf Isolator) ist ein spezielles Ausgangsmaterial für die Halbleiterherstellung, welches eine perfekte vertikale Isolierung mittels nichtleitender Zwischenschichten aufweist.

**SYSTEM ON CHIP**

Fortschritte in der Halbleiterfertigungstechnologie und Entwicklungsmethodik machen es heute möglich, ASICs mit mehreren Millionen Transistoren zu fertigen. Die Idee von System on Chip ist, möglichst viele komplexe Funktionen in einen Chip zu integrieren.

**TPMS**

Ein Tire Pressure Monitoring System (Reifendrucksensoren) überwacht den Luftdruck im Autoreifen und weist den Fahrer auf zu geringen Luftdruck hin.

**TRANSISTOR**

Ein Transistor, auch Transfer Resistor (gesteuerter Übergangswiderstand), ist das Grundbauelement der Halbleiterschaltungstechnik für die Verstärkung beziehungsweise zum Schalten von elektronischen Signalen.

**UMTS**

Das Universal Mobile Telecommunications System (Universale Telekommunikationssysteme) ermöglicht Fotos, Straßenkarten und Filme problemlos auf mobile Geräte zu übertragen.

**WAFER**

Das Ausgangsmaterial in der Chipherstellung. Es handelt sich dabei um eine etwa 0,3 bis 1mm dicke Scheibe, die aus einem Siliziumeinkristall gesägt und anschließend poliert worden ist. Typische Durchmesser betragen 150 (6"), 200 (8") und 300 (12") mm.

## IMPRESSUM

### Herausgeber

ELMOS Semiconductor AG

### Konzeption und Gestaltung

ELMOS Semiconductor AG

Diana Kasperek

Mathias Kukla

Janina Wiegmann

### Illustration

digi mice GmbH, Neu-Isenburg

### Fotografie

ELMOS Semiconductor AG

Rainer Bültert, Köln

### Druck

Lonnemann GmbH, Selm

Dieser Bericht der ELMOS Semiconductor AG liegt in deutscher und englischer Sprache vor. Beide Fassungen stehen auch im Internet unter [www.elmos.de](http://www.elmos.de) zum Download bereit.

Weitere Exemplare sowie zusätzliches Informationsmaterial schicken wir Ihnen auf Anfrage gerne kostenlos zu.

## **FINANZKALENDER**

### **Bilanzpressekonferenz**

16. März 2005

ELMOS Dortmund

### **Analystenkonferenz**

16. März 2005

DVFA-Zentrum, Frankfurt

### **Hauptversammlung**

26. April 2005

Goldsaal des Kongresszentrums  
Westfalenhallen, Dortmund

### **Zwischenbericht**

Januar bis März 2005

4. Mai 2005

### **Zwischenbericht**

zum ersten Halbjahr 2005

3. August 2005

### **Analystenkonferenz**

voraussichtlich September 2005

ELMOS Dortmund

### **Zwischenbericht**

Januar bis September 2005

3. November 2005

## **KONTAKT**

### **ELMOS Semiconductor AG**

Heinrich-Hertz-Straße 1

44227 Dortmund

Deutschland

[www.elmos.de](http://www.elmos.de)

### **Investor Relations**

Janina Wiegmann, CFA

Telefon +49 (0) 231-75 49-287

Telefax +49 (0) 231-75 49-548

[invest@elmos.de](mailto:invest@elmos.de)

